

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-74741

(P2002-74741A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

G 1 1 B 7/24

5 2 2

G 1 1 B 7/24

5 2 2 A 2 H 1 1 1

5 0 1

5 0 1 Z 5 D 0 2 9

5 1 1

5 1 1

5 3 3

5 3 3 H

5 3 3 L

審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 36 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-177162(P2001-177162)

(71)出願人 000005968

(22)出願日 平成13年6月12日(2001.6.12)

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(31)優先権主張番号 特願2000-180701(P2000-180701)

(72)発明者 大野 孝志

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

(32)優先日 平成12年6月16日(2000.6.16)

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(72)発明者 清野 賢二郎

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 100068065

弁理士 長谷川 一 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光学的情報記録用媒体

(57)【要約】

【課題】 繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性等が改善された光学的情報記録媒体を提供すること。

【解決手段】 A g を主成分とする半透明層、誘電体を含有する第1保護層、 Sb_xTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$) を主成分とする合金からなる相変化型記録層、誘電体を含有する第2保護層、及び金属反射層をこの順に有する光学的情報記録用媒体であって、該第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなり、該半透明層側から光を入射した際に、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときの媒体の反射率よりも高い光学的情報記録用媒体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Agを主成分とする半透明層、誘電体を含有する第1保護層、 Sb_xTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$)を主成分とする合金からなる相変化型記録層、誘電体を含有する第2保護層、及び金属反射層をこの順に有する光学的情報記録用媒体であって、

該第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなり、

該半透明層側から光を入射した際に、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときの媒体の反射率よりも高いことを特徴とする光学的情報記録用媒体。

【請求項2】 記録層が $(Sb_xTe_{1-x})_{1-y}Ge_y$ ($0.7 < x \leq 0.9$, $0 < y \leq 0.1$)を主成分とする合金からなる、請求項1に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項3】 Agを主成分とする半透明層、誘電体を含有する第1保護層、相変化型記録層、誘電体を含有する第2保護層、及び金属反射層をこの順に有する光学的情報記録用媒体であって、

該記録層においては、結晶化が、非晶質部又は熔融部と、結晶部との境界からの結晶成長を主体として進行し、

該第1保護層が硫黄を含む場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなり、

該半透明層側から光を入射した際に、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときの媒体の反射率よりも高いことを特徴とする光学的情報記録用媒体。

【請求項4】 該記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率を R_a (%)、該記録層が結晶状態のときの媒体の反射率を R_c (%)とすると、 $R_a - R_c \geq 15$

(%)である請求項1乃至3のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項5】 該半透明層の膜厚が1 nm以上40 nm以下である請求項1乃至4のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項6】 該第2保護層の膜厚が30 nm以上50 nm以下であり、第1保護層が第2保護層より薄い請求項1乃至5のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項7】 該金属反射層がAgを主成分とする請求項1乃至6のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項8】 該第2保護層が硫黄を含む場合には、該金属反射層と該第2保護層のあいだに拡散防止層を有してなる請求項7に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項9】 波長350 nm以上450 nm以下の光で記録再生を行うための媒体であって、

第1保護層及び第2保護層は該波長で実質的に透明で、かつ該波長での屈折率が2.0以上2.4以下であり、

半透明層の膜厚が5 nm以上30 nm以下、第1保護層の膜厚が1 nm以上40 nm以下、記録層の膜厚が5 nm以上20 nm以下、第2保護層の膜厚が30 nm以上50 nm以下、金属反射層の膜厚が40 nm以上100 nm以下である請求項7又は8に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項10】 該半透明層のAg含有量が90原子%以上である請求項1乃至9のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項11】 該半透明層の体積抵抗率が $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以上 $100 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以下である請求項10に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項12】 該金属反射層のAg含有量が90原子%以上である請求項7乃至11のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項13】 該金属反射層の体積抵抗率が $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以上 $100 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以下である請求項12に記載の光学的情報記録用媒体。

【請求項14】 該半透明層の第1保護層とは反対側に厚さ $10 \mu\text{m}$ 以上 $200 \mu\text{m}$ 以下の透明被覆層を設け、該金属反射層の第2保護層とは反対側に基板を設けてなる、請求項1乃至13のいずれかに記載の光学的情報記録用媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、書換可能な高記録密度の光学的情報記録用媒体に関する。特に、記録信号ジッタ、記録パワーマージン、繰り返し記録による特性劣化、保存安定性等に優れた相変化型記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】最近、CD-RWなどの書き換え可能でコンパクトディスク互換の媒体が既に普及し、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMなどの書き換え可能でDVD互換の媒体が上市されつつある。これら相変化型光ディスクは可搬性、耐候性、耐衝撃性等に優れた安価な大容量記録媒体である。このような相変化型光記録媒体は、結晶状態の可逆的変化に伴う反射率変化を利用して記録消去が行われる。一般には、結晶状態を未記録・消去状態とし、ここに非晶質（アモルファス）のマークを形成し記録する。通常、記録層を加熱し結晶化温度付近に一定時間保つことで結晶化し、記録層を融点より高い温度まで加熱し急冷して非晶質化する。加熱温度が異なることから分かるように、一般的には結晶相のほうがより安定である。

【0003】記録層の材料としてはカルコゲン系合金が多く用いられる。例えばGeSbTe系、InSbTe系、GeSnTe系、AgInSbTe系合金が挙げられる。これら合金はオーバーライト可能な材料でもある。特に、 Sb_2Te_3 とGeTeとからなる疑似2元系

合金（以下、疑似2元系合金と称する）、または $Sb_{70}Te_{30}$ 共晶組成近傍を主成分とする合金が知られている。両者は、結晶・非晶質（アモルファス）いずれの状態も安定で、かつ、両状態間の比較的高速の相転移が可能な記録材料である。また繰返しオーバーライトをおこなった時に偏析が生じにくいといった長所もあり、相変化型光ディスクの記録層として実用化されている。なお、オーバーライト（ダイレクトオーバーライト）とは、一旦記録済みの媒体に再度記録をする際に、記録前に消去を行うことなくそのまま重ね書きする手法、いわば消去しながら記録する手法である。相変化型媒体では記録は通常オーバーライトによって行われるので、オーバーライトを単に記録と称することもある。

【0004】前述の $Sb_{70}Te_{30}$ 共晶組成近傍を主成分とする合金の中でも、特に $Sb_{70}Te_{30}$ 共晶組成より Sb を過剰に含む合金（以下、単に共晶系合金と呼ぶ）が近年注目されている。この合金を用いた記録層は非晶質マークの端部（マーク端、マークエッジ）の形状がなめらかなのでジッタが小さく抑えられ、かつ、結晶成長速度が極めて早いので高速オーバーライトが可能という特徴を持つ。ところで相変化型記録媒体は一般に、記録前より記録後の反射率が低い媒体、いわゆるhigh-to-low媒体である。通常は、結晶状態を未記録・消去状態とし非晶質状態を記録状態とするので、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときよりも低いことを意味する。high-to-low媒体は通常、第1保護層、記録層、第2保護層、反射層からなる層構成を有する。

【0005】一方、これとは逆に記録前より記録後の反射率が高い媒体、いわゆるlow-to-high媒体も知られている。すなわち記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときよりも高い。low-to-high媒体においては、金属を主成分とする半透明層、誘電体を有する第1保護層、記録層、誘電体を有する第2保護層、金属反射層をこの順に有する層構成が知られている。一般に、このような層構成からなるlow-to-high媒体は、high-to-low媒体よりもクロスイレーズを低減できると言われている。疑似2元系合金記録層を用いる媒体では、更に、low-to-high媒体の有用性が知られている。例えば疑似2元系合金の代表例である $Ge_2Sb_2Te_5$ 近傍の合金を記録層として用いた場合に、非晶質部と結晶部の光吸収率の違いから生じる消去ムラが解消され、高速オーバーライトが可能になるとされている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところが、共晶系合金記録層を用いる媒体では、前述のような層構成からなるlow-to-high媒体の有用性ははっきりしていなかった。low-to-high媒体としたことでクロスイレーズ低減に有効であったというデータは得られていないし、共晶系合金記録層はもともと高速オーバーライトが可能なので、こ

の点でのlow-to-high媒体としたことによる寄与も明確でない。それどころか、low-to-high媒体とすることで逆に保存安定性や繰返し記録特性が著しく低下する現象が観察されていた。high-to-low媒体も繰返し記録特性はある程度低下するが、low-to-high媒体は更に特性の低下が大きいのである。即ち共晶系合金記録層を用いた場合には、従来の一般的なlow-to-high媒体の層構成では優れた特性が得られていなかった。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、共晶系合金記録層を用いたlow-to-high媒体の問題点について鋭意検討した結果、層構成及び各層の材料を特定の組合せにすることによって初めて、優れた特性の媒体が得られることが分かった。そして本媒体が通常のhigh-to-low媒体よりも繰返し記録特性や記録パワーマージンに優れた媒体であることを見出し本発明を完成した。本発明の要旨は、 Ag を主成分とする半透明層、誘電体を含有する第1保護層、 Sb_xTe_{1-x} （ $0.7 < x \leq 0.9$ ）を主成分とする合金からなる相変化型記録層、誘電体を含有する第2保護層、及び金属反射層をこの順に有する光学的情報記録用媒体であって、該第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなり、該半透明層側から光を入射した際に、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときの媒体の反射率よりも高いことを特徴とする光学的情報記録用媒体に存する。

【0008】本発明の別の要旨は、 Ag を主成分とする半透明層、誘電体を含有する第1保護層、相変化型記録層、誘電体を含有する第2保護層、及び金属反射層をこの順に有する光学的情報記録用媒体であって、該記録層においては、結晶化が、非晶質部又は溶融部と、結晶部との境界からの結晶成長を主体として進行し、該第1保護層が硫黄を含む場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなり、該半透明層側から光を入射した際に、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときの媒体の反射率よりも高いことを特徴とする光学的情報記録用媒体に存する。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明する。まず本発明の媒体の層構成は、 Ag を主成分とする半透明層、誘電体を含有する第1保護層、 Sb_xTe_{1-x} （ $0.7 < x \leq 0.9$ ）を主成分とする合金からなる相変化型記録層、誘電体を含有する第2保護層、及び金属反射層をこの順に有する光学的情報記録用媒体であって、該第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなる。そして、半透明層側から光を入射して記録再生を行う媒体であり、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率が、記録層が結晶状態のときの媒体の反射率

よりも高い、low-to-high媒体である。ここで言う反射率は、記録再生に用いる光の波長での反射率である。

【0010】本発明に係る媒体の層構成の例を図1及び図2に示す。図1は、基板6上に金属反射層5、第2保護層4、相変化型記録層3、第1保護層2、Agを主成分とする半透明層1、カバー層（透明被覆層）7をこの順に設け、カバー層側から記録再生光を入射する場合である。カバー層（透明被覆層）7は、紫外線硬化型樹脂や、誘電体、プラスチック等からなる。図2は、基板8上にAgを主成分とする半透明層1、第1保護層2、相変化型記録層3、第2保護層4、金属反射層5、保護コート層9をこの順に設け、基板側から記録再生光を入射する場合である。保護コート層9は紫外線硬化型樹脂や、誘電体、プラスチック等からなる。以下では図1の場合を膜面入射タイプ、図2の場合を基板面入射タイプと称する。

【0011】図3は変形例である。第1保護層2が硫黄を含む誘電体を含有する場合には、Agを主成分とする半透明層1と第1保護層2のあいだに拡散防止層11を設ける。図4は図1の層構成のさらなる変形例である。金属反射層5がAgを主成分とし、第1保護層2及び第2保護層4が硫黄を含む誘電体を含有する場合には、半透明層1と第1保護層2のあいだに拡散防止層11を、第2保護層4と金属反射層5のあいだに拡散防止層12を設けてなる。

【0012】low-to-high媒体の基本的層構成は、金属を主成分とする半透明層、誘電体を有する第1保護層、記録層、誘電体を有する第2保護層、金属反射層からなる。これに対して本発明では記録層が Sb_xTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$)を主成分とする合金からなり、半透明層がAgを主成分とすることを特徴とする。更に、第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には該半透明層と該第1保護層のあいだに拡散防止層を有してなることを特徴とする。

【0013】 Sb_xTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$)を主成分とする合金とは、 $Sb-Te$ 2元合金相図において、共晶点である $Sb_{70}Te_{30}$ より過剰のSbを含有する $SbTe$ 共晶系組成を主成分とする合金である。主成分とするとは、具体的には Sb_xTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$)を80原子%以上含むことである。以下、これを単に共晶系合金と称する。これにより、共晶系合金記録層を用いたlow-to-high媒体で初めて、繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性等を改善することができる。そしてこの媒体は従来の他の媒体よりも、ジッタ、記録パワーマージン、繰り返し記録特性、保存安定性等の優れた光学的情報記録用媒体である。

【0014】前述の通りオーバーライトは消去しながら記録する手法であり、結晶化と非晶質化を同時に行う。通常、結晶化のほうが速度が遅いため、結晶化を促進することがオーバーライトを高速で行うことにつながる。

本発明者らの研究によれば非晶質マークの消去、すなわち結晶化は（１）非晶質領域内の結晶核生成と、（２）非晶質部又は溶融部（光照射により昇温し溶融した部分）と、結晶部との境界を起点とする結晶成長、の2つのプロセスによって進行する。そして疑似2元系合金記録層では結晶化がプロセス（１）を主体として進行するのに対し、共晶系合金記録層においてはプロセス（２）を主体として進行する。

【0015】従って、疑似2元系合金記録層を高速オーバーライト可能にするには結晶核生成を促進すればよい。これに対して共晶系合金記録層では結晶核生成を促進しても効果が小さく、結晶成長速度を増加させるのが有効である。しかし結晶成長速度を増加させると一方で非晶質化しにくくなるので、非晶質マークの形成能を落とさないためには層構成を工夫して記録層の冷却速度を大きくし、急冷されやすくする必要がある。従って本発明の媒体では、高結晶化速度による消去と、良好な非晶質マークの形成を両立するために、特に、高熱伝導率の半透明層を組み合わせ放熱効果を促進し、冷却速度を確保することが必要である。そこで本発明の媒体ではAgを主成分とする半透明層を用いる。これにより高い放熱性が得られるので、本媒体は良好な非晶質マークが形成されないといった問題が無く、高結晶化速度による消去と良好な非晶質マークの形成を両立できる。

【0016】また、Agを主成分とする半透明層は高い光学特性を備え、結晶状態と非晶質状態の反射率差を大きくできるので、高いコントラストと大きな信号振幅も得ることができる。一般にAu、Al、Cuなども高反射率金属として知られているが、Agは放熱性と光学特性に特に優れている。特に波長650nm以下の短波長において顕著に優れる。これは、Agが短波長光の吸収が少なく熱伝導率が高いことに起因すると考えられる。なお、Agを主成分とするとはAgを80原子%以上含むことを言う。更に、金属反射層をAgを主成分とすると、より高い放熱性と高い反射率が得られるので好ましい。

【0017】ところで、第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する保護層（以下、単に含硫黄保護層と称する）である場合には、半透明層と第1保護層のあいだに拡散防止層を設ける必要がある。含硫黄保護層とAgを主成分とする半透明層が直接接していると、保護層に含まれる硫黄が半透明層に拡散しAgと反応し、半透明層の機能を損なってしまうため、両層のあいだに拡散防止層を設けてこれを防ぐ必要がある。拡散防止層の材料には、半透明層を形成するAgに対し拡散しにくいこと、つまりAgと化合物や固溶体を形成しないことが要求される。かつ、保護層に含まれる硫黄との反応性が低いとその硫化物が化学的に安定であることも要求される。なお、第1保護層が硫黄を含まない場合には拡散防止層を設ける必要はなく、半透明層と第1保護層とを直接接触

させてもよい。また、金属反射層がAgを主成分とし第2保護層が含硫黄保護層である場合にも、同じ理由で金属反射層と第2保護層のあいだに拡散防止層を設ける必要がある。

【0018】以上の層構成をとることにより、共晶系合金記録層を用いたlow-to-high媒体で初めて、繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性等に優れた媒体を得ることができる。そして本媒体は、従来のhigh-to-low媒体と比較してオーバーライト耐久性が飛躍的に改善されている。換言すれば、共晶系合金記録層が非晶質状態からの結晶化が非晶質部又は熔融部と結晶部との境界からの結晶成長を主体として進行する記録層であるが故にこのような層構成とする必要がある。従って共晶系合金以外の記録層であっても同様の結晶化過程をとる記録層であれば、これと同じ層構成にすることで上記特性改善が行える。すなわち上記層構成をとることにより、非晶質状態からの結晶化が非晶質部又は熔融部と結晶部との境界からの結晶成長を主体として進行する記録層を用いたlow-to-high媒体において、繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性等に優れた媒体を得ることができる。

【0019】本発明の媒体は、通常の2値記録方式に用いても優れているが、本発明者らが特開2001-84591で提唱しているような、反射率の多段階変化を利用した多値記録方式に用いるとオーバーライト耐久性が著しく改善される。繰り返しオーバーライトによる劣化は反射率の変化として現れてくるが、多値記録方式では反射率の変化がただちに各反射率レベルの検出エラーを引き起こすので、より安定なオーバーライト特性が求められる。本発明記録媒体を使用すればその要求に耐えるのである。

【0020】以下に、本発明についてより詳しく説明する。

[1] 記録層

本発明においては、 Sb_xTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$) を主成分とする合金からなる相変化型記録層、すなわち共晶系合金記録層である。 x が0.7以下であると、 $Sb_{70}Te_{30}$ 共晶点より過剰のSbを含まないので、結晶化速度が遅すぎる。また x が0.9より大きいと、室温近傍での結晶化速度が速くなりすぎ、非晶質マークが不安定になり媒体の保存安定性が悪くなってしまう。好ましくは、 $(Sb_xTe_{1-x})_{1-y}Ge_y$ ($0.7 < x \leq 0.9$, $0 < y \leq 0.1$) を主成分とする合金とする。Geを添加することにより、結晶核の生成が抑えられ非晶質マークの保存安定性が向上する。元来SbTe共晶系記録層は結晶化過程において結晶核生成よりも結晶成長が支配的であると言われている(G. F. Zhou, H. J. Borg, J. C. N. Rijpers, M. H. R. Lankhorst, and J. J. L. Horikx, Proceedings of SPIE, 4090(2000) 108)。ここにGeを添加すると更に結晶核生成が抑制

されると推定される。結晶核は結晶化過程の比較的低温で生成されやすく、非晶質マークの保存安定性を損なうので、これを抑制することで保存安定性を改善できると考えられる。またGeを添加すると、共晶系でありながら繰り返しオーバーライトによって偏析が生じにくいといった利点もある。

【0021】上記組成にさらに他の元素を一種以上添加しても良い。ただし他の特性を損なわないよう、添加量は10原子%以下とする。好ましくは1~5%である。特に好ましい添加元素はInやGaである。これにより非晶質マークの結晶との境界部の形状が非常になめらかになり、マーク端のジッタを低くでき、ノイズも低減される。また、Si, Sn, Pb, Au, Pd, Pt, Zn, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Co, Mo, Mn, Bi, O, N, S, Se、希土類から選ばれる少なくとも一種を添加してもよい。例えば、光学特性を微調整したり、経時安定性を多少改善したりすることができる。

【0022】記録層の膜厚は、十分な光学的コントラストを得、また結晶化速度を速くし短時間での記録消去を達成するためには5nm以上とするのが好ましい。但し、クラックを生じにくく、かつ十分な光学的コントラストを得るためには、記録層膜厚は100nm以下とするのが好ましい。より好ましくは30nm以下とする。これにより熱容量を小さくし記録感度を上げることができる。また、相変化に伴う体積変化を小さくし、記録層自身や上下の保護層に対して、繰り返しオーバーライトによる繰り返し体積変化の影響を小さくすることもできる。ひいては、不可逆な微視的変形の蓄積が抑えられノイズが低減され、繰り返しオーバーライト耐久性が向上する。特に、波長350~450nmのような青紫色レーザー光を記録再生に用いる場合は、記録層厚みは5nm以上20nm以下とするのが好ましい。

【0023】 [2] 記録層の結晶化過程

共晶系記録層では、結晶化が、非晶質部又は熔融部（光照射により昇温し熔融した部分）と、結晶部との境界を起点とする結晶成長によって主に進行する。従って共晶系記録層は、従来広く用いられている擬似2元号合金系記録層($GeSb_2Te_4$, $Ge_2Sb_2Te_5$ 等)に比べて結晶核生成による粗大グレインの発生がなく、ジッタが低くなるという利点がある。また、マーク周辺からの結晶成長を主体として結晶化が進むので、非晶質マークのサイズ（面積）が大きいときは結晶化（消去）に時間がかかるが、サイズが小さくなるにつれて結晶化（消去）に要する時間が短くなるという利点がある。記録の高密度化のためにマークサイズが小さくなるにつれ、共晶系記録層の有用性が増す傾向にあり、例えばマークサイズ（マーク幅）が0.4μm程度以下である。これは記録再生光の波長が650nm程度より短波長で、集束用対物レンズの開口数NAが0.6程度より大きい場合

に相当する。

【0024】以下に記録層の結晶化過程について詳しく説明する。共晶系合金記録層では、非晶質マークの結晶化（再結晶化）が、非晶質マークの周辺結晶部からの結晶成長によって主に進行する。すなわち再結晶化の際に、非晶質マーク内部には殆ど結晶核が発生せず、周辺の結晶部との境界点が結晶成長の核となり結晶成長していると考えられる。擬似2元系合金記録層が非晶質マーク内にランダム生成する結晶核の発生過程と、この結晶核の成長過程の2段階によって再結晶化が進行するのとは大きく異なっている。再結晶化過程は、例えば、非晶質マークに対して比較的低い消去パワー P_e のレーザ光を一樣に（直流的に）照射して結晶化を不完全に進めた記録層を、透過電子顕微鏡で観察することで確認される。擬似2元系合金記録層は、温度が高くなる非晶質マーク中央部から結晶化しているのに対して、共晶系合金記録層では非晶質マーク周辺部から結晶成長しているのが観察される。

【0025】なお、共晶系合金記録層では非晶質部と結晶部の境界だけでなく、熔融部と結晶部の境界からも結晶成長する。つまり、熔融部は、一旦非晶質部を形成してから結晶化する場合もあるが、それだけでなく、熔融再凝固時の冷却速度が遅く非晶質として固体化するのに必要な臨界冷却速度に達しない場合は、熔融領域全体が（非晶質を経ずに）ほぼ瞬時に結晶化してしまう。そこで、記録層に記録パワー P_w のレーザ光を直流的に照射したときに、反射率が未記録・消去状態の反射率（すなわち結晶状態の反射率）とほぼ等しくなるような媒体であれば、上記結晶化過程をとる記録層を備えると判断できる。具体的には、記録パワー照射後の反射率が未記録・消去状態の反射率を100%としてその±30%以内（70～130%）であればよい。なお、初期化条件によって結晶化状態が異なる場合があるので、媒体に初期化操作を行って結晶化したのち、10回程度オーバーライトを行った後の結晶部を「未記録・消去状態」と見なし、この反射率を100%とするのが良い。ここで、反射率は媒体の反射率である。

【0026】逆にこのような結晶化過程を経ない記録層であれば、熔融領域全体が再結晶化することはないので、記録パワー照射後の反射率は消去状態の反射率とは異なる。通常、相変化型記録層は成膜直後は非晶質であるため、全面を結晶化させて未記録状態とする初期化操作が必要である。本媒体の、熔融再結晶化法により初期化を行うとノイズを低減でき望ましい。オーバーライトによる消去領域の結晶状態（消去状態）と熔融再結晶化による結晶状態はほぼ同じだが、熔融を伴わない初期化で得られた結晶状態は熔融再結晶化による結晶状態とは異なり、反射率も異なるからである。熔融再結晶化は記録層に集束光ビームを直流的に照射することにより行う。

【0027】次に、熔融状態からの再結晶化のメカニズムについて、実験により更に詳細に説明する。未記録状態の記録トラックに、記録再生用レーザ光をトラッキングしながら走査し、記録層を熔融するに足る記録パワー P_w を直流的に印加したのち、ある時点でレーザ光を遮断した。図5の下段はそのときの P_w の制御信号である。遮断後は再生パワー P_r が直流的に印加されている。このトラックを再生パワー P_r のレーザ光で再生したところ、図5の上段のような再生信号が得られた。この再生信号は反射率に比例する値である。再生信号強度は、 P_w 遮断時bのみ反射率が一時的に低下し、それ以外のa、cではほぼ一定である。この媒体をTEMで観察したところ、反射率低下部bにおいて非晶質マークが形成されており、その前後a、cは結晶状態であることが確認できた。aとcにおける結晶状態はほぼ同じで区別できなかった。すなわち、 P_w を直流的に照射している限りは熔融部は再結晶化して未記録部と同じ結晶になり、 P_w を遮断した直近の熔融領域だけが非晶質化することを示している。

【0028】これは、 P_w を直流的に照射した場合には、後続部からの余熱効果により記録層の冷却速度が抑制され、非晶質形成に必要な臨界冷却速度が得られないのに対して、 P_w をほぼゼロレベルまで遮断することで、後続部からの余熱を遮断し、非晶質形成に十分な冷却速度が得られるためである。記録パワー P_w を変化させて同様に実験すると、 P_w が記録層を熔融するに足るパワーである場合には、図5のbと同じく P_w の遮断によって反射率の局所低下が観察された。そして反射率低下部には非晶質マークが形成されていた。逆に言えば、このように P_w を遮断したときその付近で反射率低下が観察されれば、記録パワー P_w の印加によって記録層が熔融し非晶質マークが形成されたことが分かる。

【0029】共晶系記録層では、結晶化（再結晶化）が、非晶質部や熔融部の周辺結晶部からの結晶成長によって主に進行する。このような記録層は結晶化速度が速く再結晶化しやすいので、熔融再結晶化後の反射率が未記録状態の反射率とほぼ等しくなる。勿論、ビーム形状やビームの走査速度によって全く同じにはならないこともある。具体的には図5のaにおける反射率を100%としたとき、cにおける反射率がその±30%以内であればよい。従来、再結晶化が著しい材料は記録に適さないと考えられていた。なぜなら、長いマークを形成するために P_w をある時間以上照射すると、熔融領域のほとんどは再結晶化してしまい、 P_w 遮断直後の一部だけが非晶質化するからである。しかし本発明者らは、高密度のマーク長変調記録においては、上記結晶化過程をとる記録層が却って良いジッタを示すことを見出した。特に分割記録パルス方式を併用すると有効である。

【0030】[3] 分割パルス記録方式
分割パルス記録方式とは、長い非晶質マークを形成する

ときに、高パワーのレーザパルスと低パワーのレーザパルスを交互に組み合わせて照射するものである。以下、高パワーのレーザパルスを記録パルスと称し、このとき印加されるパワーを記録パワー P_w とする。また低パワーのレーザパルスをオフパルスと称し、このとき印加されるパワーをバイアスパワー P_b とする。照射バイアスパワー P_b は固相での再結晶化をおこさない程度に十分低い。

【0031】これにより、記録パルスにより加熱された領域をオフパルスの間に相対的に急冷することができ、非晶質が形成されやすい。パルスの立上がり／立下がりを速くしたり、記録に用いるレーザ光源を安価なものとするためには、小さい記録パワー P_w で記録できるのが好ましいが、小さいパワーで記録可能であるということは再生光で劣化しやすいことにつながる。このため、媒体は記録パワー P_w が8～25mWになるように設計するのが好ましい。より好ましくは8～20mWであり、特に好ましくは8～17mWである。なお、バイアスパワー P_b は記録パワー P_w の0.5倍以下($P_b/P_w \leq 0.5$)が好ましく、より好ましくは0.3倍以下($P_b/P_w \leq 0.3$)である。トラッキング性能等を考慮すると、バイアスパワー P_b は再生時に照射する再生光のパワー P_r の値に近い値が好ましい。再生パワー

$$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_{m-1} T, \beta_{m-1} T, \alpha_m T, \beta_m T \quad \dots (1)$$

(但し、 $\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \dots + \alpha_{m-1} + \beta_{m-1} + \alpha_m + \beta_m = n - j$ 、 j は0以上の実数、 m は1以上の整数であり、 j 、 m は媒体及び記録条件の組合せにより決められる値である。)

上記式において、 $\alpha_i T$ ($1 \leq i \leq m$)なる時間に記録パルスを照射し、 $\beta_i T$ ($1 \leq i \leq m$)なる時間にはオフパルスを照射して記録する。そしてマークとマークの間の領域(結晶相)においては、消去パワー P_e を有する光を照射する。これによってオーバーライト記録が行える。

【0034】図6に分割パルス記録方式の一例を示す。

(a)は記録信号、(b)はその記録信号に対応して非晶質、結晶を形成するためのレーザ波形である。図6において先頭パルスの立ち上がり、最終オフパルスの立ち上がり等は必ずしも元の記録信号の開始位置・終了位置と一致する必要はない。また、合計パルス幅($n - j$)を前後のマーク長やマーク間長に応じて微調整してもよい。更に、先頭の記録パルス α_1 だけを後続パルスより長めにし、また、先頭及び最後端のオフパルス幅 β_1 、 β_m のみを他のオフパルスと別に設定するのが、長マークと短マークの特性バランスを取るために最も有効である。先頭記録パルス α_1 は余熱効果がないから昇温のためにやや長時間を要するからである。あるいは先頭記録パルス α_1 のみ、記録パワーを高めに設定することも有効である。

P_r は通常0.5～1.0mWである。冷却速度を速めたい場合には、バイアスパワー P_b を小さくするのがよく、0としてもよい。即ち光を照射しなくてもよい。

【0032】結晶形成時には、記録層に消去パワー P_e のレーザ光を照射するのが好ましい。消去パワー P_e は、オーバーライトの際に結晶を消去できるよう記録層を加熱できる大きさであれば特に制限はないが、通常、バイアスパワー P_b より大きく記録パワー P_w より小さい。例えば $0.2 \leq P_e/P_w < 1.0$ とする。消去パワー P_e の大きさは、記録パワー P_w の照射により溶融した部分の再結晶化領域にも関係する。消去パワー P_e が連続照射されると、記録層は結晶化温度付近まで加熱されるとともに、加熱された領域を相対的に徐冷することができ、結晶を形成できる。以上を組み合わせることで、非晶質と結晶を形成し分けることができ、オーバーライト記録を行うことができる。

【0033】非晶質を形成する際に記録パルスとオフパルスを交互に照射する具体例を以下に示す。長さ nT (T は基準クロック周期、 n は自然数)のマーク(非晶質)を形成する際には、時間 nT を下記式(1)のように分割する。

【数1】

【0035】 β_m のみをマーク長 nT に応じて変化させることで良好なマークを形成できる場合もある。例えば、EFM変調やEFM+変調において11Tマーク、14Tマーク等の長いマークになるほど熱が溜まり易いので、 β_m を長くして冷却時間を長めにするのが良い。逆に3T等の短いマークの場合は β_m を短くするのがよい。 β_m を0とすることもあり得る。 β_m の調整幅は0.5T程度が好ましい。さらに、パルスの切り替えをクロック周期に同期させるとパルス制御が簡単になる。

【0036】[4]高放熱性層構成

本発明の共晶系合金記録層を用いる媒体においては、疑似二元系合金記録層よりもさらに冷却効率を高めることが不可欠である。以下、共晶系合金記録層において、高放熱性の層構成を用いる必要性について説明する。本発明の記録層は Sb/Tc 比が70/30より高い共晶系合金であり、線速度10m/s以上での高速消去が可能な点で優れるが、非常に再結晶化しやすいため、逆に良好な非晶質マークの形成が困難な傾向もある。線速度が速くなるにつれて消去パワー P_e が一領域に照射される時間が短くなるため、記録層が融点近傍の高温に保たれる時間が極めて短くなるので結晶成長が不十分になってしまう。このような短時間での消去を確実にするためには、記録層の融点近傍の結晶成長速度を著しく高めねばならない。

【0037】それには母体となる $SbTe$ 合金の Sb 量

を増やして $\text{Sb}_{70}\text{Te}_{30}$ より過剰の Sb 量を多くするの
が有効である(M.Horie, N.Nobukuni, K.Kiyono, and
T.Ohno., Proceedings of SPIE, 4090(2000), 135)。
しかし、 Sb 添加量を増やすことは非晶質マークの周辺
結晶部からの再結晶化を促進するとともに、熔融再凝固
時の結晶成長速度をも速くする。非晶質マーク周辺から
の再結晶化速度をある程度以上速くすると、非晶質マー
クを記録するために熔融した領域が再凝固するときに溶
融領域周辺部からの再結晶化が進行し、非晶質化するこ
となく再結晶化してしまうのである。この傾向は特に線
速度 $5\sim 6\text{ m/s}$ 以上でオーバーライトするときに顕著
となる。これを防ぐには、記録層の冷却速度を極めて速
くしなければならない。

【0038】これに対して擬似2元系合金記録層では、
結晶核生成が重要で結晶成長速度はむしろ遅い。多数の
結晶核を生成することで、結晶成長が比較的遅くても非
晶質領域全面を結晶粒で埋め尽くすことにより結晶化を
達成している。そして、結晶核生成を促進することで高
速消去を達成している。結晶核生成は通常、結晶成長に
比べて融点よりかなり低い温度で最大となる。従って、
融点近傍に至る昇温過程では、比較的低温で結晶核生成
したのち融点近傍で結晶成長という順序で再結晶化が効
率よく進む。一方、熔融状態から融点以下に温度が下
がる過程では、比較的低温で結晶核生成が起きても結晶成
長が進みにくいので、記録層の冷却速度が比較的小さく
ても良好な非晶質マークが形成できるのである。

【0039】[5] 金属反射層

従って、本発明では、高結晶化速度による消去と良好な
非晶質マークの形成を両立するために、高熱伝導率の反
射層を組み合わせ放熱効果を促進し記録層の冷却速度
を確保する必要がある。金属反射層は、十分な反射率を
得るために膜厚 40 nm 以上とすることが好ましい。但し、
膜応力を低減するため、及び成膜時間を短くし製造
時間を短縮しコストを削減するためには膜厚 400 nm
以下とするのが好ましい。より好ましくは 200 nm 以
下とする。一般に、放熱性を高めるには膜厚を厚くする
ほうがよいが、厚いほど膜応力が高くクラックが入りや
すい。

【0040】膜面入射タイプの媒体(例えば図1)で
は、膜厚をより薄くするのが好ましい。このタイプで
は、最初に成膜される反射層の平坦性によって後から成
膜されるすべての層の平坦性が支配され、反射層の平坦
性が悪いと記録再生光が散乱されてノイズとなりやす
い。反射膜の平坦性は膜厚が厚くなればなるほど悪くな
るので、通常は反射層の膜厚を 100 nm 以下とすること
が好ましい。反射層の平坦性は、例えば、原子間力顕
微鏡(Atomic Force Microscopy, AFM)でその表面
の凹凸を測定したときの粗さ(ラフネス)が 1 nm 未満
であることが好ましい。ラフネスとは、表面の凹凸のプ
ロファイルから平均高さを求め、該平均高さを水準面と

して、各点の水準面に対する高低差の標準偏差をとった
値をいう。

【0041】金属反射層に用いる材料は、記録再生光の
吸収率が小さい材料が好ましく、また放熱層としての役
割も重要であることから熱伝導度が大きいことが好まし
い。従って反射層としては Ag 、 Al 、 Au 、 Cu 等の
高反射率の金属またはそれらを主成分とする合金を使用
するのが好ましい。これら金属は不純物が混ざると熱伝
導度が低下し光の吸収が大きくなる欠点を有するが、一
方添加元素により安定性や膜表面平坦性が改善されるこ
ともあり、 Ag 、 Al 、 Au 、 Cu に 10 原子%以下の
不純物元素を含んだ合金反射層としてもよい。不純物元
素としては、 Cr 、 Mo 、 Mg 、 Zr 、 V 、 Nb 、 Hf 、 Ag 、 In 、 Ga 、 Zn 、 Sn 、 Si 、 Cu 、 Au 、 Al 、 Pd 、 Pt 、 Pb 、 Cr 、 Co 、 Ti 、希土
類元素、 O 、 N 等が挙げられる。より好ましくはこれら
元素濃度が 5 原子%以下とする。

【0042】 Ag は Au 、 Cu 、 Al と比較して短波長
の光を吸収しにくいので、波長 650 nm 以下の短波長
レーザを使用する場合には Ag が特に好ましい。 Ag は
熱伝導度が大きく、或る程度の膜厚があれば反射率が
大きくなるため光学的な干渉効果を利用した信号振幅の増
加と十分な放熱効果が期待できる。さらに Ag はスパッ
タリングターゲットとしての値段が比較的安く、放電が
安定で成膜速度が速く、空気中で安定であるため生産
性、経済性の点で好ましく、これらの点でも Al 、 Au 、 Cu 等よりも優れる。従って反射層には Ag を主成
分とする金属又は合金を使用するのが有利である。

【0043】ところで、反射層の熱伝導率は、ヴィーデ
マン・フランツ(Wiedemann-Franz)の法則から、その
体積抵抗率におおむね反比例すると考えられる。かつ、
反射層による放熱効果は膜厚に比例するので、面積抵抗
率に反比例する。従って、抵抗率を測定することによっ
て熱伝導率や放熱効果が評価できる。一般に、薄膜の熱
伝導率の測定は困難であるが、抵抗率は測定が比較的容
易である。十分な放熱効果を得るためには反射層の面積
抵抗率は $0.5\ \Omega/\square$ 以下とするのが好ましい。より好
ましくは $0.4\ \Omega/\square$ 以下とする。ただし、反射層の放
熱性が高すぎると記録感度が悪化してしまうので、 $0.2\ \Omega/\square$ 以上とするのが好ましい。薄い膜厚で上記面積
抵抗率を達成するためには、反射層の体積抵抗率は $100\text{ n}\Omega\cdot\text{m}$ 以下とするのが好ましい。反射層の体積抵抗
率は小さいほど良いが、事実上 $20\text{ n}\Omega\cdot\text{m}$ 以上に限ら
れる。膜厚が 100 nm 程度の薄膜状態では、体積抵抗
率がバルク状態の 10 倍程度に大きくなってしまいうため
である。

【0044】[6] 半透明層

本発明では、半透明層が Ag または Ag を主成分とする
合金からなることを一つの特徴とする。これにより記録
層の熱を反射層と半透明層の両方に逃がすことができる

ので更に高い放熱性を実現できる。また、Agを主成分とする半透明層は短波長光の吸収が少なく、かつ保護層（通常、屈折率1.5～2.5）との屈折率差が大きく、結晶状態と非晶質状態の反射率差を大きくできるので、low-to-high媒体において高いコントラストと大きな信号振幅が得られる。更に記録感度も改善できる。

【0045】なお、膜が「半透明」であるとは、通常、光の透過率が10%以上である状態を示すが、本発明では、20%以上が好ましく、特に好ましくは30%以上である。透過率の上限は100%である。透過率は、使用する波長の光に対する複素屈折率と膜厚から計算で求めることができる。好ましくは、記録層が非晶質状態のときの媒体の反射率を R_a （%）、該記録層が結晶状態のときの媒体の反射率を R_c （%）とすると、 $R_a - R_c \geq 15$ （%）である。これを満たすことは、low-to-high媒体で高いコントラスト、大きい信号振幅を得ることを意味する。

【0046】共晶系合金記録層は、短波長光に対しては $R_a - R_c$ を大きくしにくいという特性があるので、特に波長450nm以下では半透明層を用いる有用性は高い。なお、 R_c 、 R_a は光学計算によりおおまかに求めることができる。ただし実際には非晶質マークが結晶状態のバックグラウンド中に形成されており、結晶部からの反射の影響が除けないので、 R_a 実測値は R_a 計算値より約5ポイント低めになる。 R_c は計算値と実測値がほぼ一致する。本発明においては、 $R_a - R_c \geq 15\%$ を好ましいとしているが、これは実測値によるものである。よって、計算値で比較すれば $R_a - R_c \geq 20\%$ に相当する。また、フォーカスサーボやトラッキングサーボに支障を及ぼさずに高記録感度を達成するには、 $0\% < R_c \leq 15\%$ とするのが好ましい。これらサーボを安定的に維持するには、 $5\% \leq R_c$ とするのがより好ましい。

【0047】半透明層の膜厚は光学的な条件と熱的条件により決まる。Agを主成分とする半透明層の場合、半透明であるためには膜厚50nm以下が好ましい。また高コントラスト、高信号振幅を得てlow-to-high媒体にするためには40nm以下が好ましい。但し半透明層としての機能を果たす上では膜厚1nm以上とするのがよい。使用するレーザー光の波長によっても最適膜厚は変化する。例えばレーザー光の波長が350～450nmの場合は膜厚5～30nmが好ましい。30nmを超えると R_c の第1保護層膜厚依存性が急峻になり、膜厚による R_c の制御がしにくくなるためである。 R_c を5～15%の範囲にするためにも、30nm以下が好ましい。また5nmより薄くすると、 $R_a - R_c$ のコントラストが小さくなる傾向があるためである。更に、高い放熱性を得るためには膜厚10nm以上が好ましい。

【0048】本発明において半透明層は、AgまたはAgを主成分とする合金からなる。Agは不純物が混ざる

と熱伝導度が低下し光の吸収が大きくなるが、一方添加元素により安定性や膜表面平坦性が改善されることもあり、10原子%以下の不純物元素を含んだ合金としてもよい。不純物元素としては、Cr、Mo、Mg、Zr、V、Nb、Hf、Ag、In、Ga、Zn、Sn、Si、Cu、Au、Al、Pd、Pt、Pb、Cr、Co、Ti、希土類元素、O、N等が挙げられる。より好ましくはこれら元素濃度が5原子%以下とする。なお、半透明層としては、屈折率の異なる誘電体層を積み重ねた誘電体多層膜（誘電体ミラー）も知られている。しかし、誘電体多層膜は環境条件により膜剥離を生じやすいし、金属のような放熱性改善効果も得られない。

【0049】十分な放熱効果を得るためには半透明層の面積抵抗率は $0.5 \Omega/\square$ 以下とするのが好ましい。より好ましくは $0.4 \Omega/\square$ 以下とする。ただし、半透明層の放熱性が高すぎると記録感度が悪化してしまうので、 $0.2 \Omega/\square$ 以上とするのが好ましい。薄い膜厚で上記面積抵抗率を達成するためには、半透明層の体積抵抗率は $100 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以下とするのが好ましい。半透明層の体積抵抗率は小さいほど良いが、事実上 $20 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ 以上に限られる。膜厚が100nm程度の薄膜状態では、体積抵抗率がバルク状態の10倍程度に大きくなってしまうためである。以上のように、本発明における共晶系記録層とAgを主成分とする半透明層の組合せによってlow-to-high媒体を構成することで、放熱性と結晶状態の光エネルギー吸収率を高くすることができ、高記録感度、高コントラスト、高信号振幅を達成できる。

【0050】[7] 保護層

本発明において、記録層はその上下を保護層で被覆されている。半透明層に対向するものを第1保護層、反射層に対向するものを第2保護層と称する。従って本発明の媒体では、記録再生用レーザー光が基板側から入射される場合は、基本的に基板、半透明層、第1保護層、記録層、第2保護層、反射層からなり、必要に応じ保護コート層がその上に設けられる（図2）。一方、記録再生用レーザー光が膜面から入射される場合は、これとは逆の層構成となり、基板、反射層、第2保護層、記録層、第1保護層、半透明層、必要に応じ透明被覆層（カバー層）からなる（図1）。また、場合により基板の両側にこれら各層を構成しても、膜面（保護コート層）を内側にし、両側に各層を有する媒体としても良い。

【0051】保護層の材料は、屈折率、熱伝導率、化学的安定性、機械的強度、密着性等に留意して決定される。一般的には透明性が高く高融点である誘電体含有する。具体的には、金属や半導体の酸化物、硫化物、窒化物やCa、Mg、Li等のフッ化物を用いることができる。これらの酸化物、硫化物、窒化物、フッ化物は必ずしも化学量論的組成をとる必要はなく、屈折率等の制御のために組成を制御したり、混合して用いることも有効である。より具体的にはZnSや希土類硫化物と酸化

物、窒化物、炭化物等の耐熱性化合物の混合物が挙げられる。これらの保護層の膜密度はバルク状態の80%以上であることが機械的強度の面から望ましい。

【0052】保護層としては硫黄を含む誘電体を用いることが多い。例えば、ZnSを80mol%、SiO₂を20mol%程度の割合で混合した混合物保護層が広く用いられている。記録層の主成分であるSbやTeとの密着性に優れ、繰り返しオーバーライトや長期間の保存時における剥離による欠陥成長を抑制できるためである。具体的には、硫化亜鉛、硫化タンタル、希土類（Y、La、Ce、Nd等）硫化物のような硫化物、あるいは、Y₂O₂Sのような酸硫化物を、単独或いは混合物として20mol%以上90mol%以下含むものが好ましい。混合物の残部は、融点又は分解温度が1000℃以上の耐熱性化合物であることが好ましい。融点又は分解温度が1000℃以上の耐熱性化合物としては、Mg、Ca、Sr、Y、La、Ce、Ho、Er、Yb、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Zn、Al、Si、Ge、Pb等の酸化物、窒化物、炭化物やCa、Mg、Li等のフッ化物が挙げられる。最も好ましくは、これら耐熱性誘電体とZnSとの混合物、耐熱性誘電体とY₂O₂SとZnOとの混合物を用いる。勿論、硫黄を含まない誘電体のみからなる保護層も使用可能である。特に、第1保護層の熱伝導率は第2保護層より高めにするのが好ましい。第1保護層の近傍にはAgを含む半透明層があるものの、半透明層は反射層ほど厚くできないので、放熱性を補うために第1保護層の熱伝導率を高めるのが好ましい。このため第1保護層に硫黄を含まない酸化物や窒化物などの熱伝導率の高い材料を用いることが好ましい。

【0053】保護層は、記録再生光に対して実質的に透明で、屈折率が2.0～2.4であるような高屈折率であることが、光学的な干渉効果を最大にするために好ましい。なお、実質的に透明であるとは、複素屈折率の虚部の絶対値が、0.1以下であることを言う。好ましくは0.05以下である。記録層および保護層の膜厚は、上記機械的強度、信頼性の面からの制限の他に、多層構成に伴う干渉効果も考慮して、レーザ光の吸収効率が良く、記録信号の振幅すなわち記録状態と未記録状態のコントラストが大きくなるように選ばれる。保護層の膜厚は記録層の変形を防止するために1nm以上が好ましい。一方、保護層を構成する誘電体自体の内部応力や接している膜との弾性特性の差を小さくし、クラックが発生しにくくするためには、膜厚を500nm以下とするのが好ましい。

【0054】一般に、保護層を構成する材料は成膜レートが小さく成膜時間が長い。成膜時間を短くし製造時間を短縮しコストを削減するためには、保護層膜厚を200nm以下に抑えるのが好ましい。また、あまり厚いと基板に形成された溝の形状と記録層表面での溝形状が大

きく変わってしまうので、この点でも200nm以下が好ましい。より好ましくは150nm以下である。特に、第1保護層（半透明層と記録層のあいだの保護層）は、熱による基板や透明被覆層の変形を抑制する必要があるため、仮に半透明層が無いとすれば通常は50nm以上必要である。しかしながら、本発明では半透明層があることで、半透明層に接する基板やカバー層が受ける熱ダメージが軽減されるので、第1保護層の膜厚は1nm以上あればよい。そして、半透明層の放熱性を十分に生かすために、膜厚100nm以下と薄くするのが好ましい。さらに、約400nm程度の波長で高コントラストを得るためには40nm以下が好ましい。これにより熱伝導率の低い保護層内に熱が蓄積されるのを防ぐ。

【0055】一方、第2保護層（金属反射層と記録層のあいだの保護層）は、記録層の変形抑制のためには膜厚10nm以上が好ましい。一般に、繰り返しオーバーライトによって第2保護層内部には微視的な塑性変形が蓄積され、ひいては再生光を散乱させノイズを増加させる。これを抑制するためには保護層膜厚を60nm以下とするのが好ましい。更に、干渉効果を用いてlow-to-high媒体とするためには、約400nm程度の波長では第2保護層を30～50nm程度と厚めにするのが好ましい。そして、このように第2保護層を厚めにする場合には、金属反射層を特に熱伝導率の高いものにする。以上を総合すると、例えば波長350nm以上450nm以下の光で記録再生を行うための媒体であれば、半透明層の膜厚が5nm以上30nm以下、第1保護層の膜厚が1nm以上40nm以下、記録層の膜厚が5nm以上20nm以下、第2保護層の膜厚が30nm以上50nm以下、金属反射層の膜厚が40nm以上100nm以下とするのが好ましい。なお、第1保護層及び第2保護層は記録再生波長では実質的に透明で、かつ屈折率が2.0以上2.4以下であることを前提とする。

【0056】〔8〕拡散防止層

本発明では、第1保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には、半透明層と第1保護層の間に拡散防止層を設けることを特徴とする。また、金属反射層がAgを主成分とし、かつ第2保護層が硫黄を含む誘電体を含有する場合には、反射層と第2保護層の間に拡散防止層を設ける必要がある。含硫黄保護層とAgを主成分とする半透明層が直接接していると、保護層に含まれる硫黄が半透明層に拡散しAgと反応し、半透明層の機能を損なってしまうため、両層のあいだに拡散防止層を設けてこれを防ぐ必要がある。後述の実施例にあるように、Ag半透明層、硫黄を含む第1保護層、記録層、硫黄を含む第2保護層、Ag反射層を順に設けた層構成では、繰り返し記録後の特性等は良くない。

【0057】拡散防止層の材料には、半透明層を形成するAgに対し拡散しにくいこと、つまりAgと化合物や固溶体を形成しないことが要求される。かつ、保護層に

含まれる硫黄との反応性が低いとその硫化物が化学的に安定であることも要求される。拡散防止層は、半透明層または反射層内に拡散しにくい、半透明層または反射層との密着性が良い、硫黄を含む保護層との密着性が良い、硫黄原子を拡散させにくい等の条件を満たす材料が用いられる。例えば、金属又は合金、各種化合物、またはこれらの混合物から上記条件に合う材料を適宜選択して用いることができる。

【0058】金属又は合金としては、シリコン、ニッケル、タンタル、コバルト、クロム、タングステン及びバナジウムが好ましく用いられる。中でもタンタル及びニッケルは薄膜の内部応力による剥離等の問題を生ぜず安定性が良いので好ましく、特に好ましいのはタンタルである。一方、化合物としては、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、半導体酸化物、半導体窒化物、半導体炭化物、非晶質カーボン等から選ばれる。安定な化合物で融点が1000℃以上の耐熱性化合物であることが好ましい。具体的には、酸化ケイ素、窒化ケイ素、炭化ケイ素、酸化タンタル、酸化セリウム、酸化ランタン、酸化イットリウム、酸化アルミニウム、酸化銀等が挙げられる。非晶質カーボンとしては、透明度の高い非晶質の水素化カーボンが挙げられる。中でも酸化ケイ素及び酸化タンタルは拡散防止層を形成すると同時に誘電体保護層としての役割を果たすこともできる点で好ましく、特に好ましいのは酸化ケイ素である。

【0059】なお、拡散防止層としては、記録再生光の波長での吸収率が小さいものが望ましい。特に、半透明層と第1保護層との間に設ける場合には、光学的に透過率が高いことが好ましいので、実質的に吸収のない透明誘電体であることが望ましい。反射層と第2保護層との間に設ける場合には、多少の光吸収性があってもよく、金属や合金も好適に使用できる。拡散防止層は、半透明層または反射層の光学物性と熱的物性を活かすために、できるだけ薄く設けるのが好ましい。具体的には10nm以下が好ましく、5nm以下がより好ましい。ただし、薄すぎると十分な拡散防止効果が得られにくくなる場合もあるので、十分な保存安定性を得るには0.5nm以上が好ましく、1nm以上がより好ましい。透明誘電体はアモルファスであるため金属のように膜表面平坦性等が結晶粒に影響されることがなく、薄く均一な膜が作製できるので、透明誘電体からなる拡散防止層は比較的薄い膜でも使用可能である。

【0060】なお、半透明層と第1保護層を続けて設けたとき、或いは第2保護層と反射層を続けて設けたとき、半透明層が成膜雰囲気中の酸素等と反応したり、保護層に吸着した酸素等と反射層が反応したりして、一部金属酸化物の不動態からなる層が界面に形成される場合があり、実質的に拡散防止層のような役割を果たすことがある。しかしながら、このような層の拡散防止効果は大きくないので、十分な保存安定性を得るには積極的に

拡散防止層を設けることが好ましい。以上の記録層、保護層、反射層、半透明層、拡散防止層はスパッタリング法などによって形成される。これらの層は各層のスパッタリングターゲットを同一真空チャンバー内に設置したインライン装置で膜形成を行うことが各層間の酸化や汚染を防ぐ点で望ましい。また、生産性の面からも優れている。

【0061】さて、本発明の媒体は、記録パワーを変化させたときのジッタの最低値や記録パワーマージンにおいても、第1保護層、記録層、第2保護層、拡散防止層、反射層からなる公知のhigh-to-low媒体に比べて改善されている。改善理由は必ずしも明らかではないが、以下のような可能性が互に影響し合い効果を奏しているものと推測される。即ち、相変化型光記録媒体の繰り返し記録特性の悪化は、記録層が記録の繰り返しにより移動してしまうことが主な原因であると考えられている。本発明の基板面入射タイプの媒体は、半透明層の上に第1保護層、記録層が設けられるが、半透明層の表面が適度に荒れているため、その後に設けられる記録層が記録の繰り返しで移動しにくい状況になっていることが考えられる。また、通常のhigh-to-low媒体と比較して記録時の熱分布が記録層の移動を小さくするような状況となっていることも推測される。さらには、通常のhigh-to-low媒体の繰り返し記録による特性劣化の主な原因が基板の熱変形等であり、本発明のAgを主成分とする半透明層を含む層構成とすることにより基板に対するダメージが小さくなるということも予測される。

【0062】[9] 他の層構成部分

以下、本発明の光学的情報記録用媒体を構成する他の層構成部分について説明する。本発明の光学的情報記録用媒体において、基板は半透明層或いは反射層のいずれかに近接して設けられる。基板としては、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリオレフィンなどの樹脂、あるいはガラス等を用いることができる。基板側から記録再生光を入射する場合は、基板は記録再生光に対して透明とする必要がある。これらの中で、ポリカーボネートは実績もあり安価で経済性にも優れているので好ましい。基板の厚さは、通常0.05～5mm、好ましくは0.1～2mmである。基板面入射タイプの媒体であれば、金属反射層の第2保護層とは反対側に保護コート層が設けられてなる。保護コート層は例えば紫外線硬化型樹脂や、誘電体、プラスチック等からなる。保護コート層の膜厚は、通常1μm以上200μm以下である。

【0063】膜面入射タイプの媒体であれば、半透明層の第1保護層とは反対側に透明被覆層（カバー層）が設けられてなる。透明被覆層は例えば紫外線硬化型樹脂や、誘電体、プラスチック等からなる。透明被覆層は記録層等をヘッドから保護するために膜厚10μm以上が好ましい。但し、あまり厚いと光ヘッドと記録層の距離が長くなり高密度記録が行いにくくなるため、膜厚20

0 μm 以下が好ましい。一般に、基板面入射タイプの媒体よりも、膜面入射タイプの媒体のほうが光ヘッドと記録層の距離を近づけることができ、高密度記録に適している。なお、本発明の媒体は以上の層構成に限定されるものではなく、必要に応じ各層のあいだに他の層を介したり、各層を複数の膜で構成するようにしてもよい。本発明においては、以上のような層構成をとることにより、共晶系合金記録層を用いたlow-to-high媒体で初めて、繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性等を改善することができる。或いはまた、非晶質状態からの結晶化が非晶質部又は溶融部と結晶部との境界からの結晶成長を主体として進行する記録層を用いたlow-to-high媒体において、繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性等に優れた媒体を得ることができる。そしてこの媒体は従来知られている媒体よりも、ジッタ、記録パワーマージン、繰り返し記録特性、保存安定性等の優れた光学的情報記録用媒体である。

【0064】

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、これら実施例に制限されるものではない。以下においてAg半透明層、Ag反射層と呼ぶ場合はほぼ純粋なAgからなり、その薄膜状態での体積抵抗率は約 $30\Omega\cdot\text{nm}$ である。Ag合金半透明層、Ag合金反射層と呼ぶ場合は $\text{Ag}_{98}\text{Cu}_1\text{Au}_1$ 合金（原子%）であり、その薄膜状態の体積抵抗率は約 $35\Omega\cdot\text{nm}$ である。面積抵抗率は体積抵抗率を膜厚で除すれば得られる。抵抗率はJIS K 7194に準じた4探子法により測定した。また、基板には記録再生光案内用の溝が形成されている。なお、以下では記録再生光入射側から見て近い面を溝（グループ）、遠い面をランド（溝間）と呼ぶ。 ZnS-SiO_2 の屈折率は、波長630～660nmでは約2.1、波長400nm近傍では約2.3である。これ以外は、光学計算には後述する参考例に示した数値を用いた。

【0065】【実施例1；基板入射タイプ】

（光ディスクの作製）厚さ0.6mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、Ag半透明層（18nm）、 SiO_2 拡散防止層（5nm）、 ZnS-SiO_2 第1保護層（90nm）、 $\text{Ge}_5\text{In}_{93}\text{Sb}_{68}\text{Te}_{24}$ 記録層（15nm）、 ZnS-SiO_2 第2保護層（30nm）、 SiO_2 拡散防止層（5nm）、Ag反射層（120nm）をスパッタリング法によりこの順に成膜し、この上にさらに紫外線硬化樹脂からなる保護コート層を形成した。その後、これら層が形成された基板を、保護コート層を内側にして2枚貼り合わせて光ディスクを作製した。なお、基板には溝幅0.56 μm 、溝深さ67nm、溝ピッチ1.2 μm の溝が螺旋状に形成されていた。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を結晶化した。

【0066】（反射率の評価）この光ディスクに記録再

生光（波長635nm）を基板側から入射させて反射率を測定したところ、結晶状態（未記録状態）の反射率 R_c よりアモルファス状態（記録状態）の反射率 R_a の方が大きかった。すなわちlow-to-high媒体である。結晶状態反射率 R_c は溝内で約11%であった。 $P_w=11\text{mW}$ で記録した時の14Tマークにおける非晶質部反射率 R_a は約26%であった。 $R_a-R_c\approx 15\%$ であった。

【0067】（記録再生条件）波長635nm、NA0.6の光学系を有する光ディスク評価装置を用いて記録特性を測定した。記録再生光は基板側から入射させた。記録には図6に示すような分割パルス記録方式を用いた。記録条件は、線速度4m/s、消去パワー P_e と記録パワー P_w の比 $P_e/P_w=0.5$ 、バイアスパワー $P_b=0.8\text{mW}$ 、基準クロック周期 $T=38.2\text{ns}$ とし、DVD規格で使用される8-16変調ランダム信号（いわゆるEFM+変調信号）を記録した。本実施例では、分割数 $m=n-1$ とし、2番目以降の記録パルス区間（ P_w 照射区間）の長さ $\alpha_i T$ （ $2\leq i\leq m$ ）を i によらず一定とした。また、2番目から $m-1$ 番目のオフパルス区間（ P_b 照射区間）の長さ $\beta_i T$ （ $2\leq i\leq m-1$ ）を i によらず一定とした。再生は、線速度4m/s、再生パワー $P_r=0.8\text{mW}$ で行った。

【0068】（ジッタの記録パワー依存性評価）まず、オーバーライト（ダイレクトオーバーライト、DOW）を10回行い、その後再生して3Tスペースジッタ（3Tマーク間部ジッタ）を測定した。なお、マーク間部（スペース）は未記録部・消去部に対応し、マーク部は記録部に対応する。3Tスペースとは長さ3Tのマーク間部を指し、3Tスペースジッタとは記録された8-16変調信号を再生したときの、長さ3Tのマーク間部のジッタである。この測定を記録パワー P_w を1mWずつ変えて行い、3Tスペースジッタの記録パワー依存性を評価した。結果を図7（a）に示す。

【0069】（ジッタの繰返し記録回数（DOW cycle）依存性評価）次に、 $P_w=11\text{mW}$ 、 $P_e=5.5\text{mW}$ の条件で、所定回数オーバーライトを行うごとにジッタを測定し、3Tスペースジッタの繰返し記録回数（DOW cycle）依存性を評価した。結果を図7（b）に示す。図7（a）は、記録パワー（横軸；mW）に対する3Tスペースジッタ（縦軸；%）を示し、図7（b）は、繰返し記録（横軸）に対する3Tスペースジッタ（縦軸）を示す。ジッタは基準クロック周期 $T=38.2\text{ns}$ で規格化した値を用いた。なお、溝記録とランド記録の両方について評価をおこなった。実施例1の光ディスクは、ジッタの最低値が低く、ジッタの記録パワーマージンが大きく、繰返し記録後の特性劣化が小さく、優れた光ディスクである。

【0070】（耐環境試験）次に、この光ディスクを80℃、85%RHの環境に100時間保つ耐環境試験を

行った。これによる膜剥がれ等の異常は見られなかった。耐環境試験の前後で、前述の光ディスク評価装置を用いて記録特性を測定した。前述と同様の記録再生条件のもとで、 $P_w = 11 \text{ mW}$ 、 $P_e = 5.5 \text{ mW}$ とし、8-16変調ランダム信号を溝内に10回オーバーライトしたのち、再生してジッタの測定を行った。耐環境試験の前後で3Tスペースジッタはそれぞれ9.8%と9.6%であり、耐環境試験による劣化は小さかった。なお、3Tスペースジッタは基準クロック周期38.2nsで規格化した。以上の評価から、実施例1の光ディスクは繰り返し記録特性、記録パワーマージン、保存安定性の全てに優れている。

【0071】[比較例1；基板入射タイプ；半透明層なし]

(光ディスクの作製) 厚さ0.6mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、ZnS-SiO₂第1保護層(75nm)、Ge₅In₃Sb₆₈Te₂₄記録層(15nm)、ZnS-SiO₂第2保護層(20nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、Ag反射層(120nm)をスパッタリング法によりこの順に成膜し、この上にさらに紫外線硬化樹脂からなる保護コート層を形成した。その後、これら層が形成された基板を、保護コート層を内側にして2枚貼り合わせて光ディスクを作製した。なお、基板の溝形状は実施例1と同様であった。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を結晶化した。

【0072】(反射率の評価) この光ディスクはR_cよりR_aの方が小さかった。すなわちhigh-to-low媒体である。R_cは溝内で約14%であった。 $P_w = 11 \text{ mW}$ で記録した時の14TマークにおけるR_aは約3%であった。

(ジッタ評価) この光ディスクに実施例1と同様の評価をおこなった。結果を図8に示す。比較例1の光ディスクは、ジッタの最低値、ジッタの記録パワーマージン、繰り返し記録後の特性の全ての点で、実施例1の光ディスクよりも劣っていた。

(耐環境試験) 実施例1と同様の評価を行ったところ、耐環境試験の前後での、基準クロック周期で規格化した3Tスペースジッタはそれぞれ11.2%と11.5%であり、耐環境試験による劣化は小さかった。

【0073】[比較例2；基板入射タイプ；拡散防止層なし] Ag半透明層(18nm)と第1保護層のあいだに拡散防止層が無いこと以外は実施例1と同様に、光ディスクを作製した。基板の溝形状も実施例1と同様である。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を初期結晶化した。この光ディスクの反射率は、R_cよりR_aの方が約15%大きい。すなわちlow-to-high媒体である。この光ディスクに実施例1と同様の評価をおこなった。結果を図9に示す。比較例1の光ディスクは、ジッタの最低値、繰り返し記録後の特性の点で、実施例1の光ディスクよりも劣っていた。特に繰り返し記録による

特性劣化が著しかった。次に、この光ディスクを80℃、85%RHの環境に100時間保つ耐環境試験を行ったところ、反射層の変色が観察された。第1保護層からの硫黄の拡散によってAg反射層が変質したと思われる。

【0074】[実施例2；基板入射タイプ；多値記録] (光ディスクの作製) 厚さ0.6mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、Ag半透明層(15nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、ZnS-SiO₂第1保護層(25nm)、Ge₅In₃Sb₆₈Te₂₄記録層(14nm)、ZnS-SiO₂第2保護層(30nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、Ag反射層(100nm)をスパッタリング法によりこの順に成膜し、この上にさらに紫外線硬化樹脂からなる保護コート層を形成した。その後、これら層が形成された基板を、保護コート層を内側にして2枚貼り合わせて光ディスクを作製した。なお、基板には溝幅0.4μm、溝深さ45nm、溝ピッチ0.8μmの溝が螺旋状に形成されていた。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を結晶化した。

(反射率の評価) この光ディスクに記録再生光(波長402nm)を基板側から入射させると、R_cよりR_aの方が大きかった。すなわちlow-to-high媒体である。光学計算により反射率を求めたところ、R_cの計算値は14%、R_aの計算値は37%であった(波長は405nmと仮定)。

【0075】(多値記録での記録特性の評価) 本実施例の光ディスクについて、波長402nm、NA0.65の光学系を有する光ディスク評価装置を用いて以下の原理で多値記録を行い記録特性を測定した。記録再生光は基板側から入射させた。記録パワーP_w、バイアスパワーP_b、P_w照射区間t_w、P_b照射区間t_b、t_wとt_bの和をτ、記録線速度をvとする。τを一定としてt_wのτに対する比t_w/τを変化させることで、一定区間内(τとvの積vτに相当する区間)に形成される非晶質マークの面積を変化させることができる。その区間内における反射率は、区間内の非晶質マークの面積とバックグラウンドの結晶状態の面積との比に応じて決まる。従って、t_w/τを段階的に変化させることで反射率を段階的に変化させることができる。反射率の閾値を多段階に設定することにより、1区間に3値以上の情報が記録できる(K. Kiyono M. Horie, T. Ohno, T. Uematsu, T. Hashizume, M. P. O'Neill, K. Balasubramanian, R. Narayan, D. Warland, and T. Zhou, Japanese Journal of Applied Physics, 40(2001), 1855ページ)。なお、共晶系合金記録層は、記録層が再凝固するときの再結晶化が著しいので、t_b=0の場合にはほぼ完全に結晶化する。そして、t_bを増加させるにつれ冷却効果が大きくなり、再結晶化が抑制されて非晶質マークのサイズが大きくなる。t_b/τを単調に増加させる

と、 t_b/τ が0から70～80%程度に達するまでは非晶質マークサイズが大きくなり、その間は単調に反射率が増加する。なお、多値記録においては消去パワーという概念は存在しない。

【0076】記録条件は、線速度5m/s、記録パワー $P_w=5.5$ mW、バイアスパワー $P_b=0.5$ mWとし、 $\tau=50$ nsec、 $v\tau=0.25$ μ mとし、 t_w/τ を変化させて記録を行い、図10に示すように反射率を8段階に変化させ、8値記録を行った。図10において縦軸は再生信号の電圧値であり反射率に対応する。最も低反射率であるレベル8が完全に結晶化した状態であり、光学計算により求めた反射率 R_c にほぼ一致した。最も高反射率であるレベル1は光学計算により求めた反射率 R_a よりやや低めとなった。実測値での比較では R_c と R_a とで10%以上の反射率差が得られた。この光ディスクに繰り返しオーバーライトを行い各反射率レベルの変化を観察した。図10に示すように、繰返し記録1万回後も反射率はほとんど変化しなかった。次にこのディスクに、線速度5m/sで記録パワー $P_w=5.5$ mWのレーザ光を直流的に照射したのち、照射部の反射率を測定した。ディスクを初期化して約10回オーバーライトを行った後の結晶部の反射率を100%とすると、照射部の反射率は100%であった。

【0077】(2値記録での記録特性の評価)次に、この光ディスクについて通常の2値記録を行い記録特性を評価した。記録には図6に示すような分割パルス記録方式を用いた。記録条件は、線速度7m/s、記録パワー $P_w=5.1$ mW、消去パワー $P_e=2.2$ mW、バイアスパワー $P_b=0.5$ mW、2Tマーク長(最短マーク長)約0.23 μ mとし、(1, 7)RL方式によるマーク長変調記録を行った。本実施例では、分割数 $m=n-1$ とし、2番目以降の記録パルス区間(P_w 照射区間)の長さ $\alpha_i T$ ($2 \leq i \leq m$)を i によらず一定とした。また、2番目から $m-1$ 番目のオフパルス区間(P_b 照射区間)の長さ $\beta_i T$ ($2 \leq i \leq m-1$)を i によらず一定とした。再生は、線速度3.1m/s、再生パワー $P_r=0.5$ mWで行った。

【0078】以上の条件で、所定回数オーバーライトを行うごとにジッタを測定し、イコライザーを介して2値化した後のData to clockジッタについて繰返し記録回数(DOW cycle)依存性を評価した。その結果、繰返し記録1万回程度までジッタは増加せず、9%以下であった。なお、Data to clockジッタは、データに含まれる全ての長さのマーク及びマーク間のゆらぎを基準クロック周期を基準に評価した値である。次にこのディスクに、線速度7m/sで記録パワー $P_w=5.1$ mWのレーザ光を直流的に照射したのち、照射部の反射率を測定した。ディスクを初期化して約10回オーバーライトを行った後の結晶部の反射率を100%とすると、照射部の反射率は110～115%

であった。

【0079】[比較例3；基板入射タイプ；多値記録；半透明層なし]

(光ディスクの作製)厚さ0.6mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、ZnS-SiO₂第1保護層(40nm)、Ge₅In₃Sb₆₈Te₂₄記録層(13nm)、ZnS-SiO₂第2保護層(8nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、Ag反射層(100nm)をスパッタリング法によりこの順に成膜し、この上にさらに紫外線硬化樹脂からなる保護コート層を形成した。その後、これら層が形成された基板を、保護コート層を内側にして2枚貼り合わせて光ディスクを作製した。なお、基板には溝幅0.4 μ m、溝深さ50nm、溝ピッチ0.8 μ mの溝が螺旋状に形成されていた。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を結晶化した。

【0080】(反射率の評価)この光ディスクに記録再生光(波長402nm)を基板側から入射させると、 R_c より R_a の方が小さかった。すなわちhigh-to-low媒体である。光学計算により反射率を求めたところ、 R_c の計算値は31%、 R_a の計算値は6%であった(波長は405nmと仮定)。

(多値記録での記録特性の評価)この光ディスクに実施例2と同条件で多値記録を行い記録特性を評価した。図11に示すように反射率を8段階に変化させ、8値記録を行った。この例では、最低反射率と最高反射率は実施例2とほぼ同等であるが、最も高反射率であるレベル1が完全に結晶化した状態である。この光ディスクに繰り返しオーバーライトを行い各反射率レベルの変化を観察した。図11に示すように、繰返し記録100回以降、レベル1の反射率が大きく低下し8値多値記録には不適当な状態となった。

【0081】(2値記録での記録特性の評価)次に、この光ディスクに実施例2とほぼ同条件で通常の2値記録を行い記録特性を評価した。以上の条件で、所定回数オーバーライトを行うごとにジッタを測定し、Data to clockジッタの繰返し記録回数(DOW cycle)依存性を評価した。その結果、繰返し記録2000回程度までジッタはほとんど増加せず9%以下を維持したが、その後急激に悪化した。すなわち、通常の2値記録では反射率が多少低下してもすぐにはジッタが目立って悪化することはないので、この光ディスクでも1000回以上の繰返しオーバーライトが可能であった。しかし多値記録では反射率低下による劣化がほとんど許されず、1000回程度しか使用できなかった。従って、特に多値記録方式には本発明の媒体が有効である。

【0082】[実施例3；膜面入射タイプ；AlN保護層]厚さ1.1mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、Ag₉₈Cu₁Au₁合金反射層(80nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、ZnS-SiO₂第2保護層(30nm)、Ge₃In₅Sb₆₇Te₂₅記録層(12

nm)、AlN第1保護層(30nm)、Ag₉₈Cu₁Au₁半透明層(15nm)をスパッタリング法によりこの順に成膜した。AlNは、ZnS-SiO₂より熱伝導率が高い。この上にさらに、紫外線硬化樹脂からなる厚さ約100μmの透明被覆層(カバー層)を形成し、光ディスクを作製した。なお、基板には溝幅0.32μm、溝深さ40nm、溝ピッチ0.66μmの溝が螺旋状に形成されている。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を初期結晶化した。この光ディスクに記録再生光(波長402nm)を基板側から入射させると、R_cよりR_aの方が大きかった。すなわちlow-to-high媒体である。光学計算により反射率を求めたところ、R_cの計算値は12%、R_aの計算値は35%であった(波長は405nmと仮定)。

【0083】この光ディスクについて、波長402nm、NA0.85の光学系を有する光ディスク評価装置を用いて記録特性を測定した。記録再生光は膜面側から入射させた。記録には実施例1と同様の分割パルス記録方式を用いた。記録条件は、線速度5.7m/s、記録パワーP_w=3.7mW、消去パワーP_e=1.7mW、バイアスパワーP_b=0.3mW、2Tマーク長(最短マーク長)0.173μm、基準クロック周波数(1/T)=66MHzとし、(1,7)RL方式によるマーク長変調記録を行った。再生は、線速度5.7m/s、再生パワーP_r=0.3mWで行った。以上の条件で、所定回数オーバーライトを行うごとにジッタを測定し、イコライザーを介して2値化した後のData to clockジッタの繰返し記録回数(DOW cycle)依存性を評価した。その結果、繰返し記録5万回程度までジッタ増加は1%未満であり、10%を超えることはなかった。

【0084】[実施例4;膜面入射タイプ]厚さ1.1mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、Ag₉₈Cu₁Au₁合金反射層(80nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、ZnS-SiO₂第2保護層(30nm)、Ge₃In₅Sb₆₇Te₂₅記録層(12nm)、ZnS-SiO₂第1保護層(25nm)、SiO₂拡散防止層(5nm)、Ag₉₈Cu₁Au₁半透明層(15nm)をスパッタリング法によりこの順に成膜した。この上にさらに、紫外線硬化樹脂からなる厚さ約100μmの透明被覆層(カバー層)を形成し、光ディスクを作製した。なお、基板には溝幅0.32μm、溝深さ40nm、溝ピッチ0.66μmの溝が螺旋状に形成されている。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を初期結晶化した。この光ディスクに記録再生光(波長402nm)を基板側から入射させると、R_cよりR_aの方が大きかった。すなわちlow-to-high媒体である。光学計算により反射率を求めたところ、R_cの計算値は12%、R_aの計算値は36%であった(波長は405nmと仮定)。

【0085】この光ディスクについて、波長402nm、NA0.85の光学系を有する光ディスク評価装置を用いて記録特性を測定した。記録再生光は膜面側から入射させた。記録には実施例1と同様の分割パルス記録方式を用いた。記録条件は、線速度5.7m/s、2Tマーク長(最短マーク長)0.173μm、基準クロック周波数(1/T)=66MHzとし、(1,7)RL方式によるマーク長変調記録を行った。再生は、線速度5.7m/s、再生パワーP_r=0.3mWで行った。まず、オーバーライトを10回行い、その後再生してData to clockジッタを測定した。記録パワーP_wなどを変化させて測定を行ったところ、P_w=3.5mW、P_e=1.7mW、P_b=0.3mWにおいてジッタが約8%で最小となった。次にP_b、P_eを一定としてP_wを変化させたところ、P_w=3.4mW±0.4mWの範囲において、ジッタが約9%以下であった。

【0086】更に、記録パワーP_w=3.4mW、消去パワーP_e=1.7mW、バイアスパワーP_b=0.3mWの条件で記録再生を行ったところ、Data to clockジッタは9%以下と良好であった。同一条件で繰返しオーバーライトを行ったところ、繰返し記録5万回程度までジッタ増加は1%未満であった。次にこのディスクに、線速度5.7m/sで記録パワーP_w=3.4mWのレーザ光を直流的に照射したのち、照射部の反射率を測定した。ディスクを初期化して約10回オーバーライトを行った後の結晶部の反射率を100%とすると、照射部の反射率は114%であった。

【0087】[比較例4;膜面入射タイプ媒体;半透明層なし]厚さ1.1mmのポリカーボネートからなる透明基板上に、Ag₉₈Cu₁Au₁合金反射層(80nm)、SiO₂拡散防止層(3nm)、ZnS-SiO₂第2保護層(3nm)、Ge₃In₅Sb₆₇Te₂₅記録層(12nm)、ZnS-SiO₂第1保護層(35nm)をスパッタリング法によりこの順に成膜した。この上にさらに、紫外線硬化樹脂からなる厚さ約100μmの透明被覆層(カバー層)を形成し、光ディスクを作製した。なお、基板には溝幅0.32μm、溝深さ40nm、溝ピッチ0.66μmの溝が螺旋状に形成されている。この光ディスクに初期化操作を行って記録層を初期結晶化した。この光ディスクに記録再生光(波長402nm)を基板側から入射させると、R_cよりR_aの方が小さかった。すなわちhigh-to-low媒体である。光学計算により反射率を求めたところ、R_cの計算値は32%、R_aの計算値は7%であった(波長は405nmと仮定)。

【0088】この光ディスクについて、実施例4と同条件で評価を行った。再生は、線速度5.7m/s、再生パワーP_r=0.3mWで行った。まず、オーバーライトを10回行い、その後再生してData to cl

ockジッタを測定した。記録パワー P_w などを変化させて測定を行ったところ、 $P_w=3.8\text{mW}$ 、 $P_e=1.7\text{mW}$ 、 $P_b=0.3\text{mW}$ においてジッタが約9%で最小となった。次に P_b 、 P_e を一定として P_w を変化させたところ、 $P_w=3.8\text{mW}\pm 0.4\text{mW}$ の範囲において、ジッタが約10%以下であった。更に、記録パワー $P_w=3.4\text{mW}$ 、消去パワー $P_e=1.7\text{mW}$ 、バイアスパワー $P_b=0.3\text{mW}$ の条件で記録再生を行ったところ、Data to clockジッタは9%以下と良好であった。しかし同一条件で繰り返しオーバーライトを行ったところ、繰返し記録2000回程度でジッタが顕著に増加した。

【0089】[参考例] 以下に本発明の媒体及び従来の媒体の光学的・熱的特性について、計算例を示す。本発明においては、 $R_a-R_c\geq 15\%$ を高コントラストで好ましいとしているが、これは実測値によるものである。これは、計算値で概ね $R_a-R_c\geq 20\%$ に相当する。以下では、特定の層構成において特定の層の膜厚を変化させたときに、計算値で $R_a-R_c\geq 20\%$ なる光学特性が得られるかどうか（高コントラストか否か）を基準に、評価を行う。計算法は、例えば「光学薄膜」

(H.A.Macleod 著、日刊工業新聞社1989.11.30発行)に示されているような、光学的な多重干渉効果を考慮した一般的な手法である。記録再生光の波長は405nmと

した。いずれの媒体もlow-to-high媒体である。

【0090】記録層とそれぞれの複素屈折率（実測値）は以下の通りである。

記録層A： $\text{In}_3\text{Ge}_5\text{Sb}_{69}\text{Te}_{23}$

結晶状態の複素屈折率 1.35-3.34i

非晶質状態の複素屈折率 2.46-2.90i

記録層B： $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$

結晶状態の複素屈折率 2.2-3.3i

非晶質状態の複素屈折率 3.1-2.1i

第1及び第2保護層は誘電体からなり、屈折率は2.32で吸収は無いものとする。このような屈折率を示す保護層としては、ZnS、酸化タンタル、酸化ニオブ、酸硫化イットリウム、酸化チタン等を主成分とする保護層がある。拡散防止層に用いる SiO_2 の屈折率は1.6である（実測値）。

【0091】表-1にAg、Au、Cu、Alの波長ごとの複素屈折率(n-ik)の文献値を示す(Handbook of Optical Constants of Solids, Edited by Edward D. Palik, Academic Press, Inc., 1985, Orlando, Florida, USA)。示した波長には $\pm 10\text{nm}$ 程度の誤差がある。

【0092】

【表1】

表-1

波長	400nm		650nm	
	n	k	n	k
Ag	0.173	1.95	0.14	4.15
Au	1.66	1.96	0.166	3.15
Cu	1.18	2.21	0.21	3.67
Al	0.49	4.86	1.47	7.79

また、各種合金とそれぞれの複素屈折率（実測値）は以下の通りである。

Ag合金 0.089-2.03i

Au合金 1.66-1.96i

Cu合金 1.18-2.21i

Al合金 0.39-3.62i

【0093】反射層は透過光が無視できる程度に厚いものとする。膜厚100~200nmの範囲であれば光学的には大差ない。記録再生光の入射側には屈折率1.56の透明基板があるものとする。基板の厚みは入射レーザー光のコヒーレント長より十分大きく、基板内での多重干渉はないものとする。よって計算上は、屈折率1.56の媒質から多層膜に入射するものとする。

(1) 第1保護層/記録層/第2保護層/Ag合金反射層(第1保護層側から光を入射)

半透明層を有しないこの層構成は、書き換え型CD(CD-RW)等で広く用いられている。以下、単に4層構成と呼ぶこととする。まず、記録層として記録層Aを用いた。記録層の膜厚を変化させ、さらにそれぞれについ

て第1及び第2保護層の膜厚を変化させる場合の R_a-R_c を光学計算した。この結果を等高線図にして図12に示す。図において(a)、(b)、(c)、(d)はそれぞれ記録層の膜厚5, 10, 15, 20nmの場合である。各図において $R_a-R_c\geq 20\%$ となる領域、つまり高コントラスト領域は斜線で示してある。以下同様である。

【0094】次に記録層として記録層Bを用いた。記録層の膜厚を変化させ、さらにそれぞれについて第1及び第2保護層の膜厚を変化させた場合の R_a-R_c を光学計算した。この結果を等高線図にして図13に示す。図12に示すように記録層Aでは高コントラスト領域は極めて狭く、膜厚のマージンはほとんどなく実際上実現困難である。一方、図13に示すように記録層Bでは高コントラスト領域が第1保護層膜厚40nm近傍にいくらか存在する。次に図14に、記録層Aを用い記録層膜厚12nmとし、(a)反射層をAg合金とした場合、

(b)反射層をAl合金とした場合の結果を示す。いずれも等高線図はほとんど差がなく、高コントラストはほ

とんど得られない。すなわち、記録層Bでは半透明層の無い従来の4層構成によるlow-to-high媒体でも高コントラストを得られる領域があるのに対し、記録層Aでは同構成で高コントラストを得ることはほとんど不可能である。

【0095】(2) 半透明層／第1保護層／記録層A／第2保護層／Ag合金反射層（半透明層側から光を入射）

まず、半透明層を厚さ15nmのAg合金とした（本発明の態様に相当）。記録層の膜厚を12nmとし、第1及び第2保護層の膜厚を変化させる場合の $R_a - R_c$ を光学計算した。この結果を等高線図にして図15に示す。次に、半透明層を厚さ5nmのAl合金として同様に光学計算した結果を図16に示す。いずれも第2保護層膜厚40nm近傍で高コントラストが達成できる。すなわちAl合金半透明層でAg合金半透明層と同等の光学特性を得るには、膜厚をかなり薄くする必要がある。しかし、膜厚5nmのAl合金では放熱効果は殆どないと考えられる。さらに、半透明層としてAu合金を用いた。半透明層の膜厚を変化させ、さらにそれぞれについて第1及び第2保護層の膜厚を変化させる場合の $R_a - R_c$ を光学計算した。この結果を等高線図にして図17に示す。図において(a)、(b)、(c)、(d)はそれぞれ半透明層の膜厚5, 10, 15, 20nmの場合である。同様に半透明層としてCu合金を用いた場合の計算結果を図18に示す。すなわちAu合金半透明層、Cu合金半透明層では高コントラストを得ることは困難である。

【0096】(3) Ag合金半透明層／第1保護層／記録層A／第2保護層／Ag合金反射層（半透明層側から光を入射、本発明の態様に相当）

半透明層の膜厚を変化させ、さらにそれぞれについて第1及び第2保護層の膜厚を変化させる場合の $R_a - R_c$ 及び R_c を光学計算した。この結果を等高線図にして図19～図25に示す。それぞれ、半透明層の膜厚5, 10, 15, 20, 30, 40, 50nmの場合である。図において(a)、(b)はそれぞれ $R_a - R_c$ 、 R_c である。いずれも、高コントラスト領域は概ね第2保護層膜厚が30～50nmの範囲に存在する。 $R_a - R_c \geq 20\%$ となる領域は第1保護層膜厚0～40nmの範囲に存在する。また、 $5 \leq R_c \leq 15(\%)$ となる領域は概ね第1保護層膜厚25～45nmの範囲に広く存在する。半透明層膜厚が30nm以下であれば、両方を満たす領域が存在している。更に、半透明層が40nmを超えて厚くなると高コントラスト領域は急激に小さくなってしまふ。 $R_c \leq 15(\%)$ となる領域も殆どない。

【0097】(4) Ag合金半透明層／(SiO₂拡散防止層)／硫黄を含有する第1保護層／記録層A／第2保護層／Ag合金反射層（半透明層側から光を入射）半透明層膜厚15nm、拡散防止層膜厚0nm又は5nm

m、記録層膜厚12nmとして、それぞれについて第1及び第2保護層の膜厚を変化させる場合の $R_a - R_c$ を光学計算した。この結果を等高線図にして図26に示す。図26(a)は拡散防止層膜厚0nm、つまり拡散防止層が無い場合であり、図26(b)は拡散防止層膜厚5nmの場合である（本発明の態様に相当）。拡散防止層の追加による光学特性の変化はほとんど見られない。

【0098】

【発明の効果】相変化型光学的情報記録用媒体において本発明の層構成とすることにより、従来の層構成からなる記録の媒体と比較し、ジッタ、記録パワーマージン、繰り返し記録による特性劣化、保存安定性等を改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の光学的情報記録用媒体の層構成の一例である。

【図2】 本発明の光学的情報記録用媒体の層構成の他の一例である。

【図3】 本発明の光学的情報記録用媒体の層構成の他の一例である。

【図4】 本発明の光学的情報記録用媒体の層構成の他の一例である。

【図5】 記録パワーの印加状態とそれによる再生信号の変化を示す図である。

【図6】 分割パルス記録方式の一例の説明図である。

【図7】 実施例1の光ディスクにおける3Tスペースジッタと記録パワー(a)、及び繰り返し記録(b)との関係を示すグラフ。

【図8】 比較例1の光ディスクにおける3Tスペースジッタと記録パワー(a)、及び繰り返し記録(b)との関係を示すグラフ。

【図9】 比較例2の光ディスクにおける3Tスペースジッタと記録パワー(a)、及び繰り返し記録(b)との関係を示すグラフ。

【図10】 実施例2の光ディスクの反射率の繰り返し記録回数依存性を示すグラフ

【図11】 比較例3の光ディスクの反射率の繰り返し記録回数依存性を示すグラフ

【図12】 参考例(1)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図13】 参考例(1)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図14】 参考例(1)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図15】 参考例(2)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図16】 参考例(2)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図17】 参考例(2)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図18】 参考例(2)の $R_a - R_c$ の光学計算例

【図19】 参考例(3)の $R_a - R_c$ 、 R_c の光学計算例

【図20】 参考例(3)の $R_a - R_c$ 、 R_c の光学計算例

【図21】 参考例(3)の R_a-R_c 、 R_c の光学計算例

【図22】 参考例(3)の R_a-R_c 、 R_c の光学計算例

【図23】 参考例(3)の R_a-R_c 、 R_c の光学計算例

【図24】 参考例(3)の R_a-R_c 、 R_c の光学計算例

【図25】 参考例(3)の R_a-R_c 、 R_c の光学計算例

【図26】 参考例(4)の R_a-R_c の光学計算例

【符号の簡単な説明】

- 1 半透明層
- 2 第1保護層
- 3 相変化型記録層
- 4 第2保護層
- 5 金属反射層
- 6、8 基板
- 7 カバー層(透明被覆層)
- 9 保護コート層
- 11、12 拡散防止層

【図1】

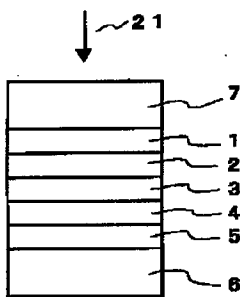


図 1

【図2】

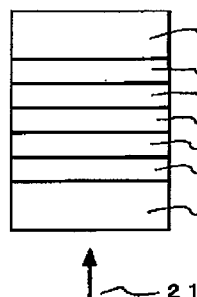


図 2

【図3】

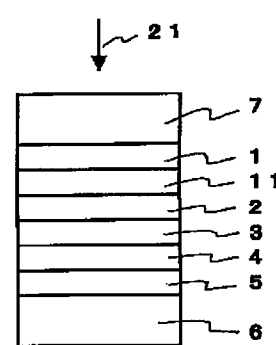


図 3

【図4】

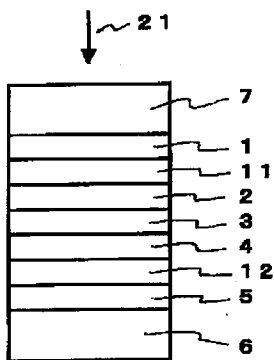
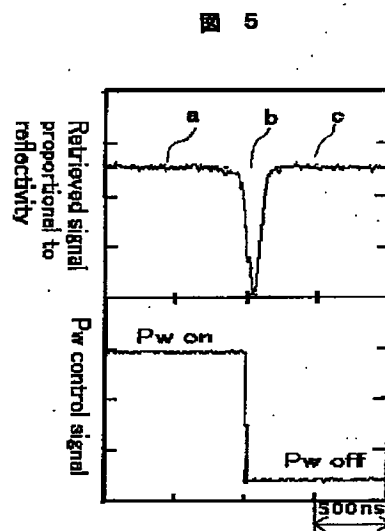


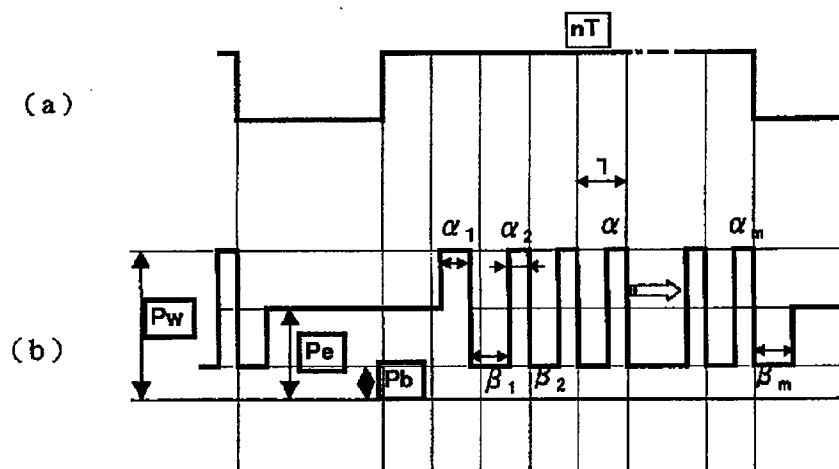
図 4

【図5】



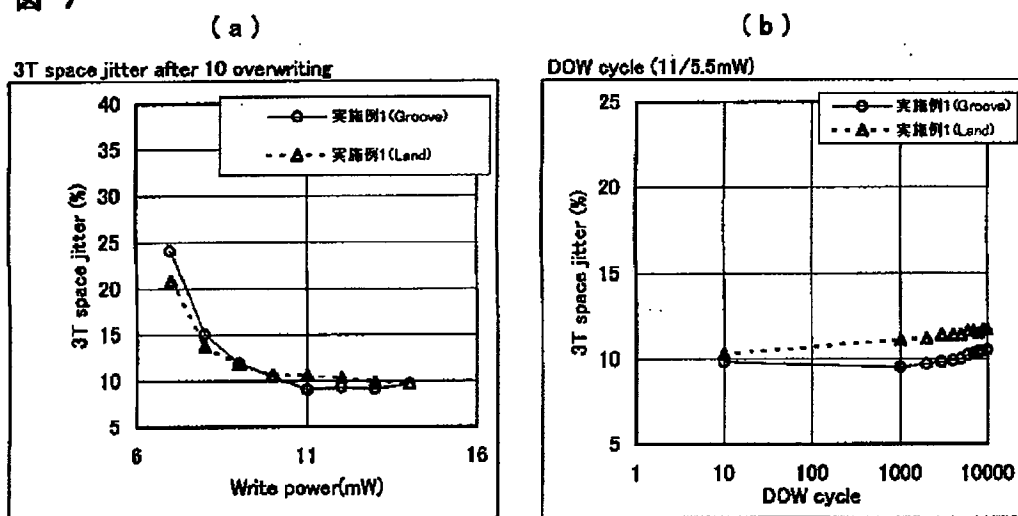
【図6】

図 6



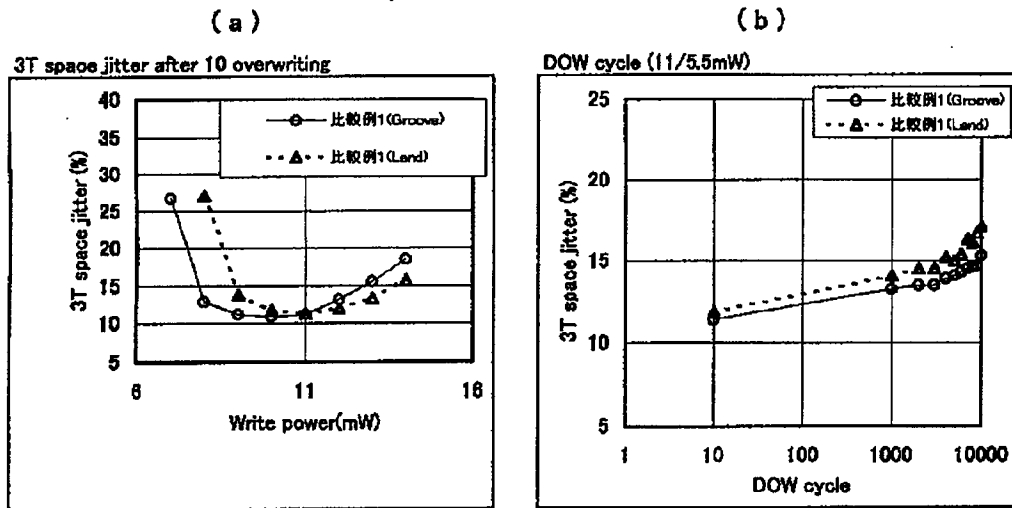
【図7】

図 7



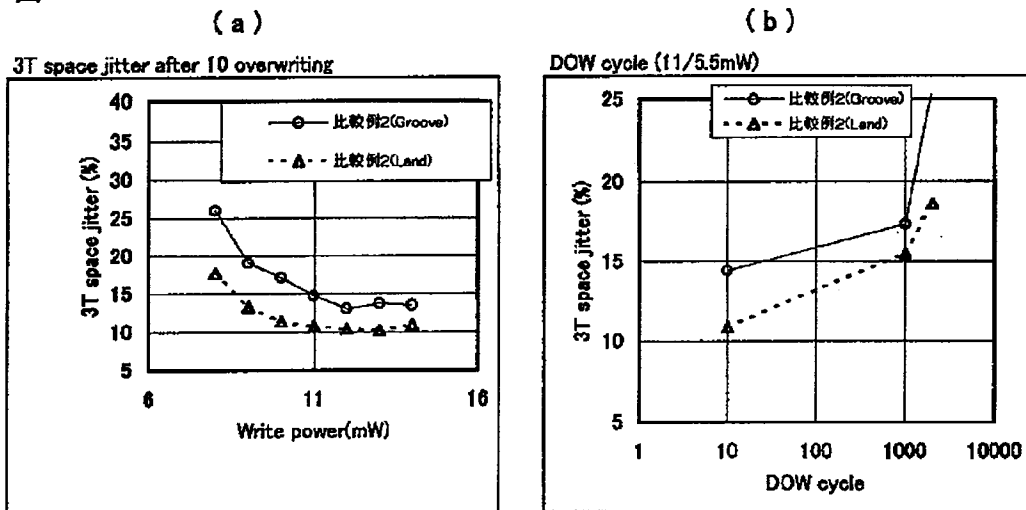
【図8】

図 8



【図9】

図 9



【図10】

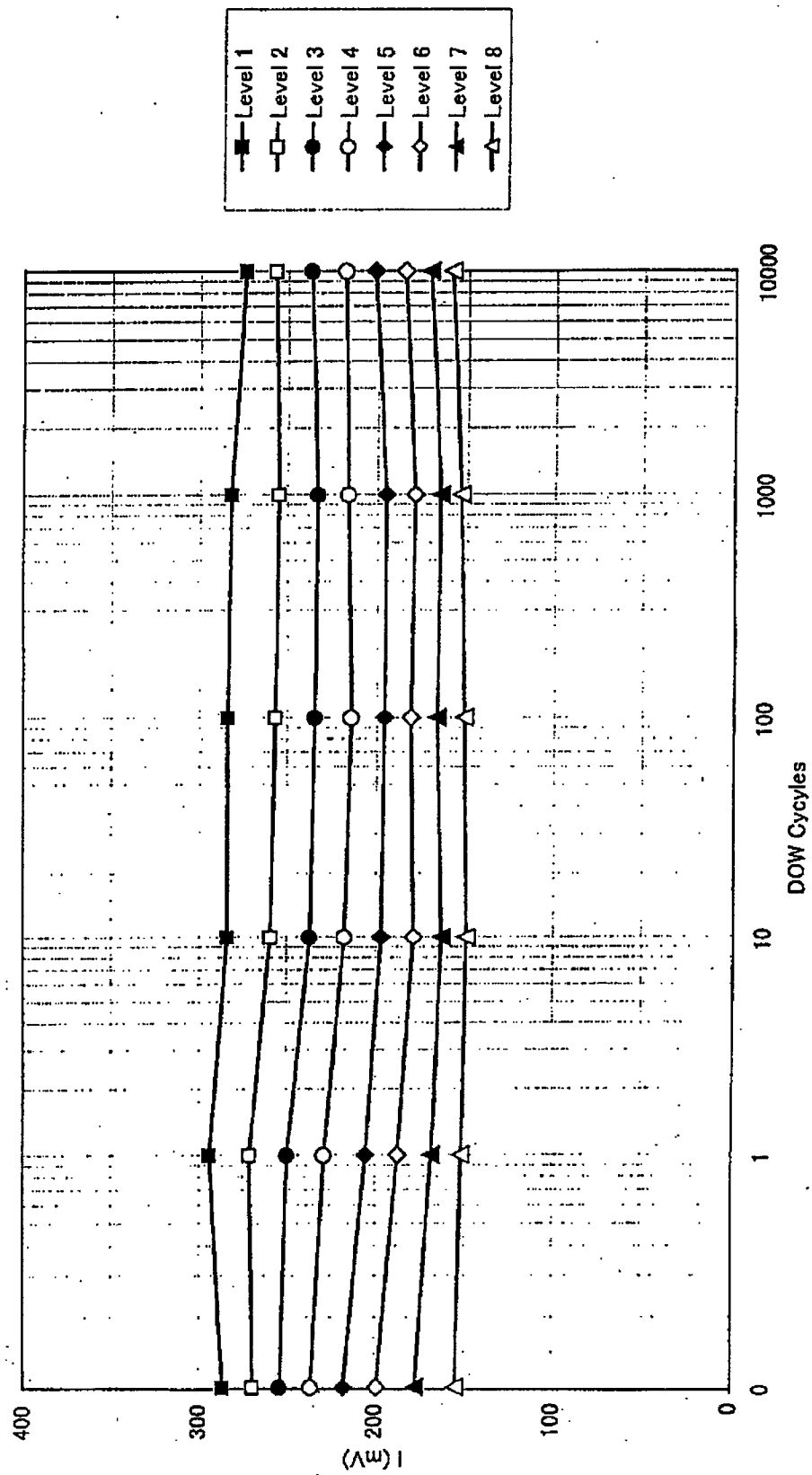
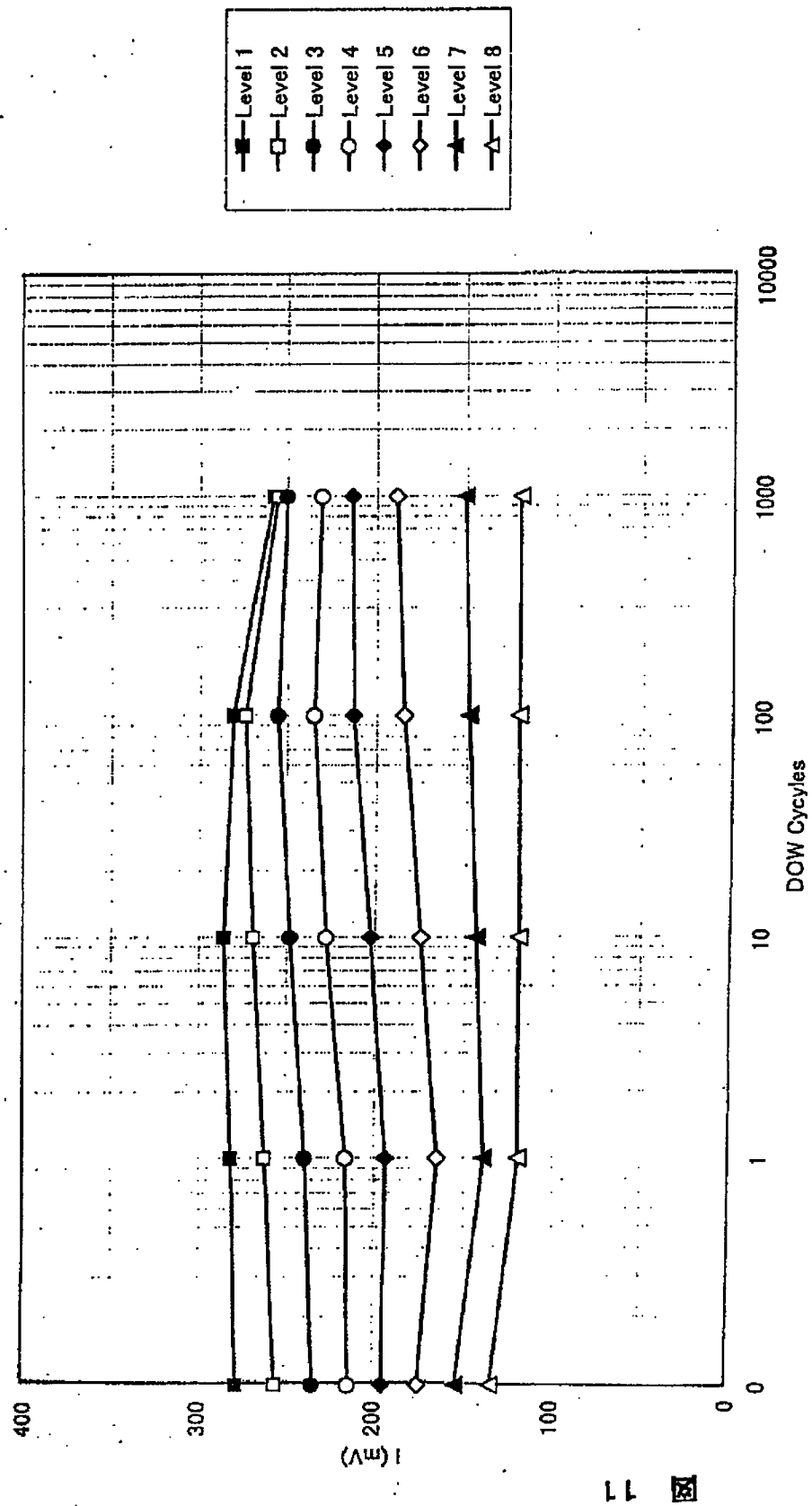


図 10

【図11】



【図12】

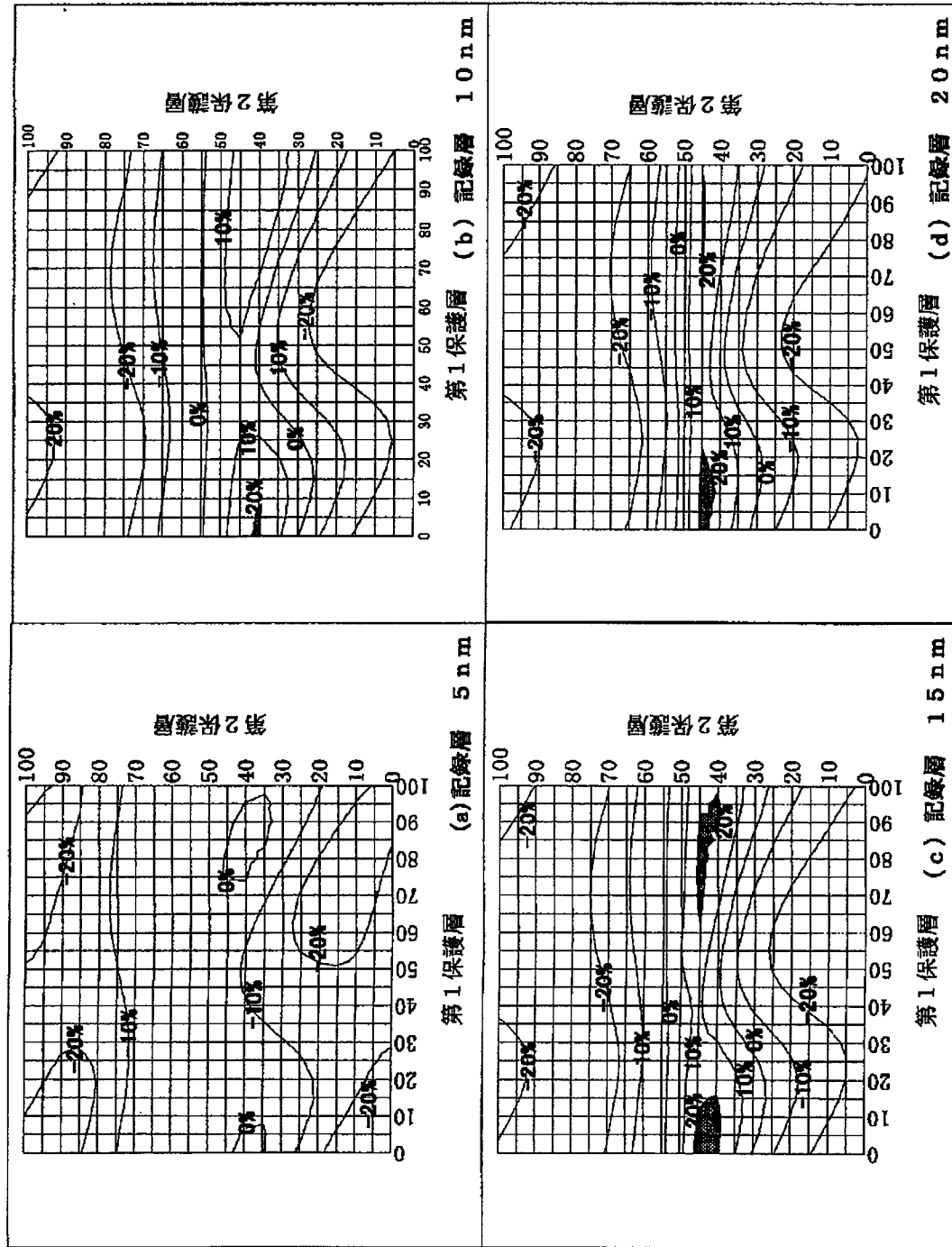


図 12

【図13】

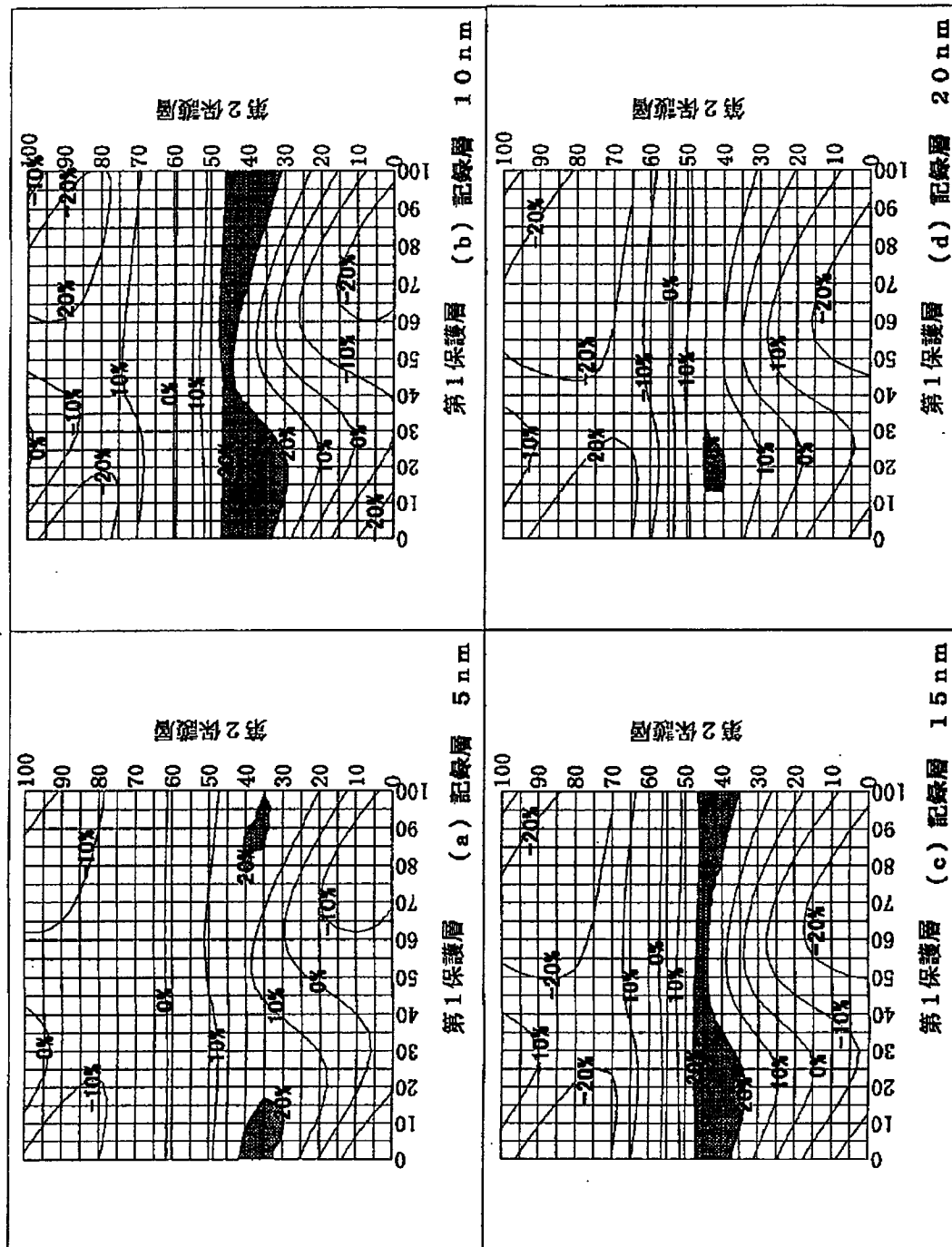


図 13

【図14】

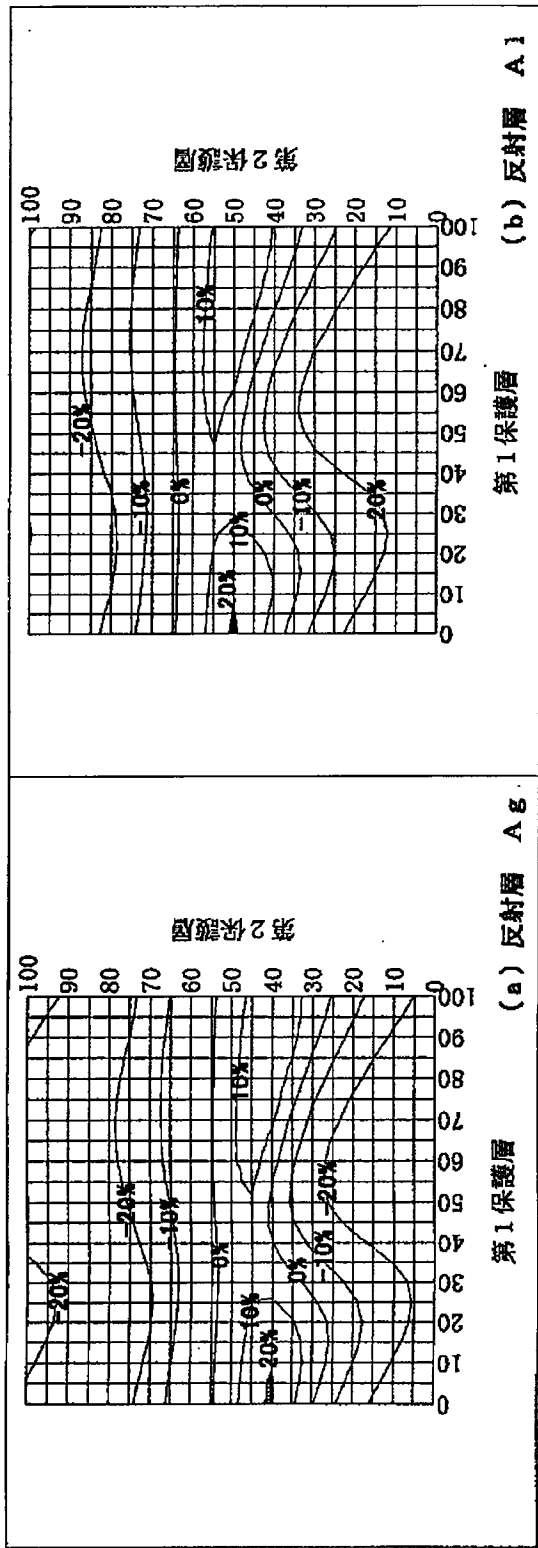


図 14

【図26】

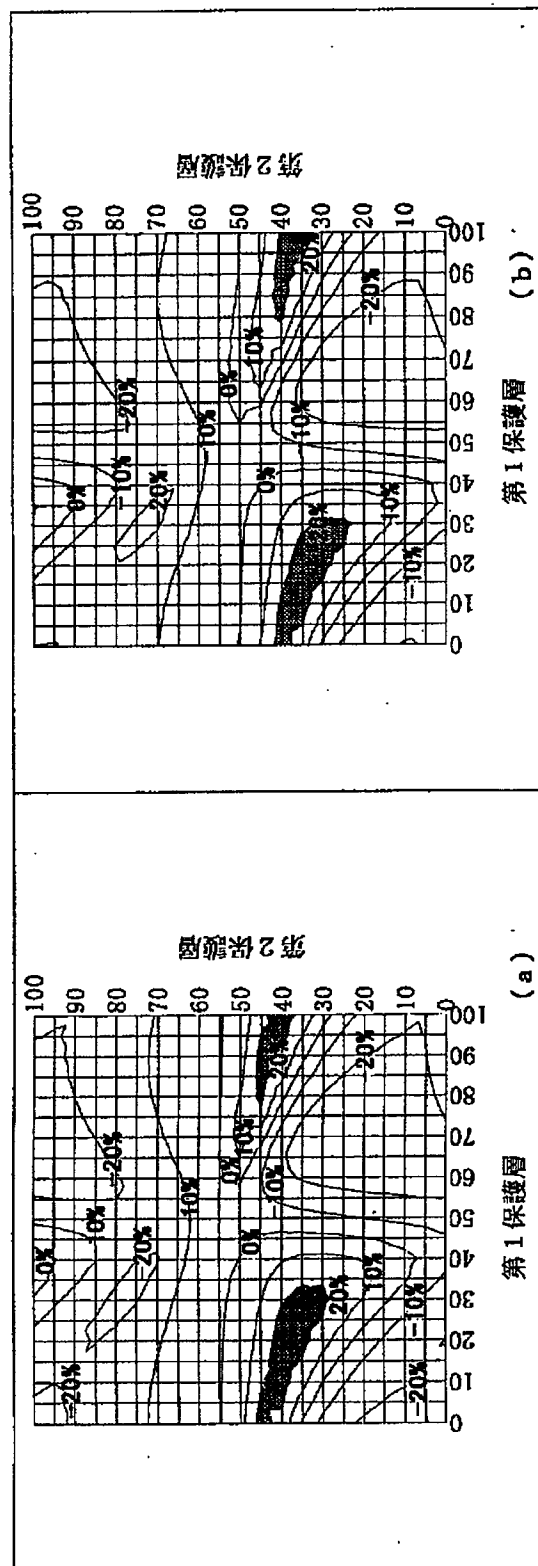


図 26

【図15】

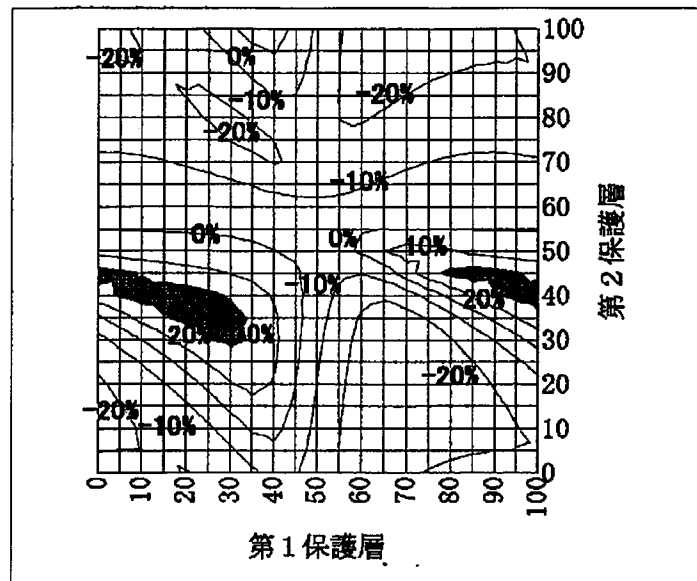


図 15

【図16】

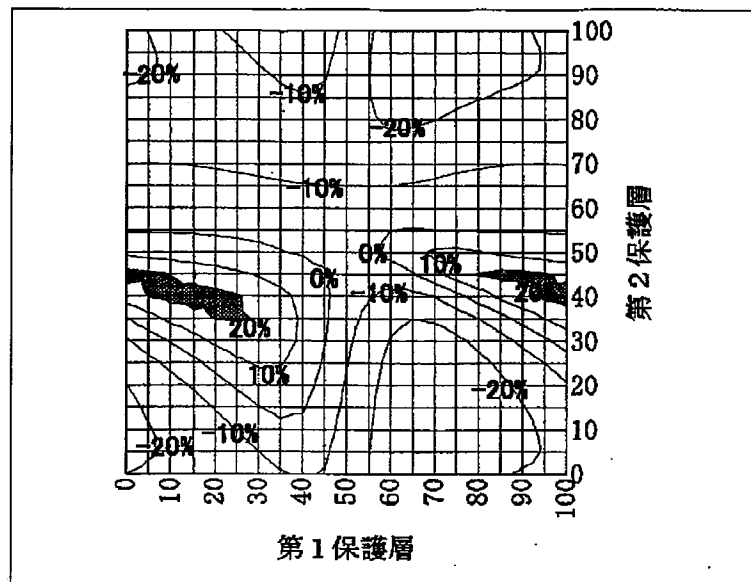


図 16

【図17】

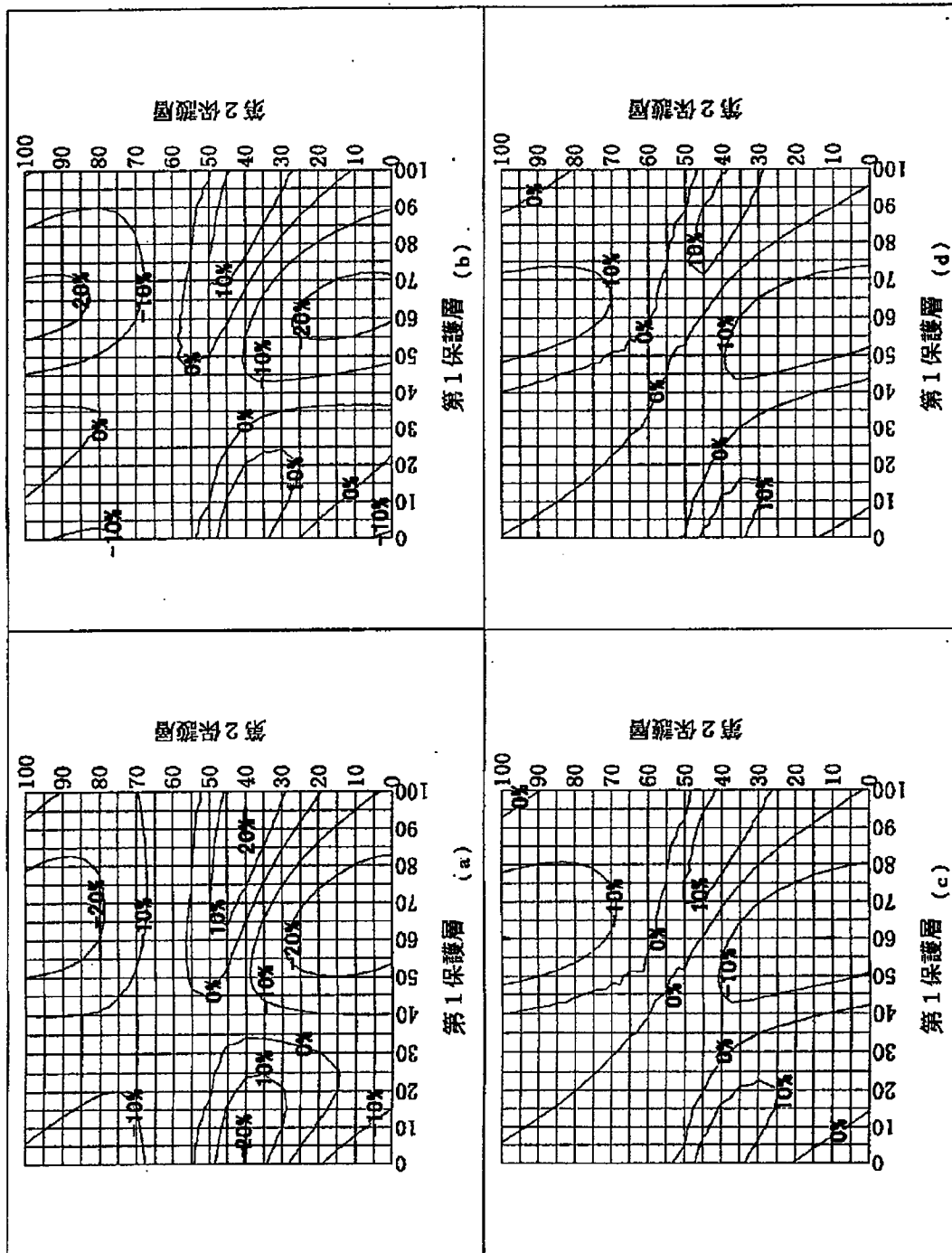


図 17

【図18】

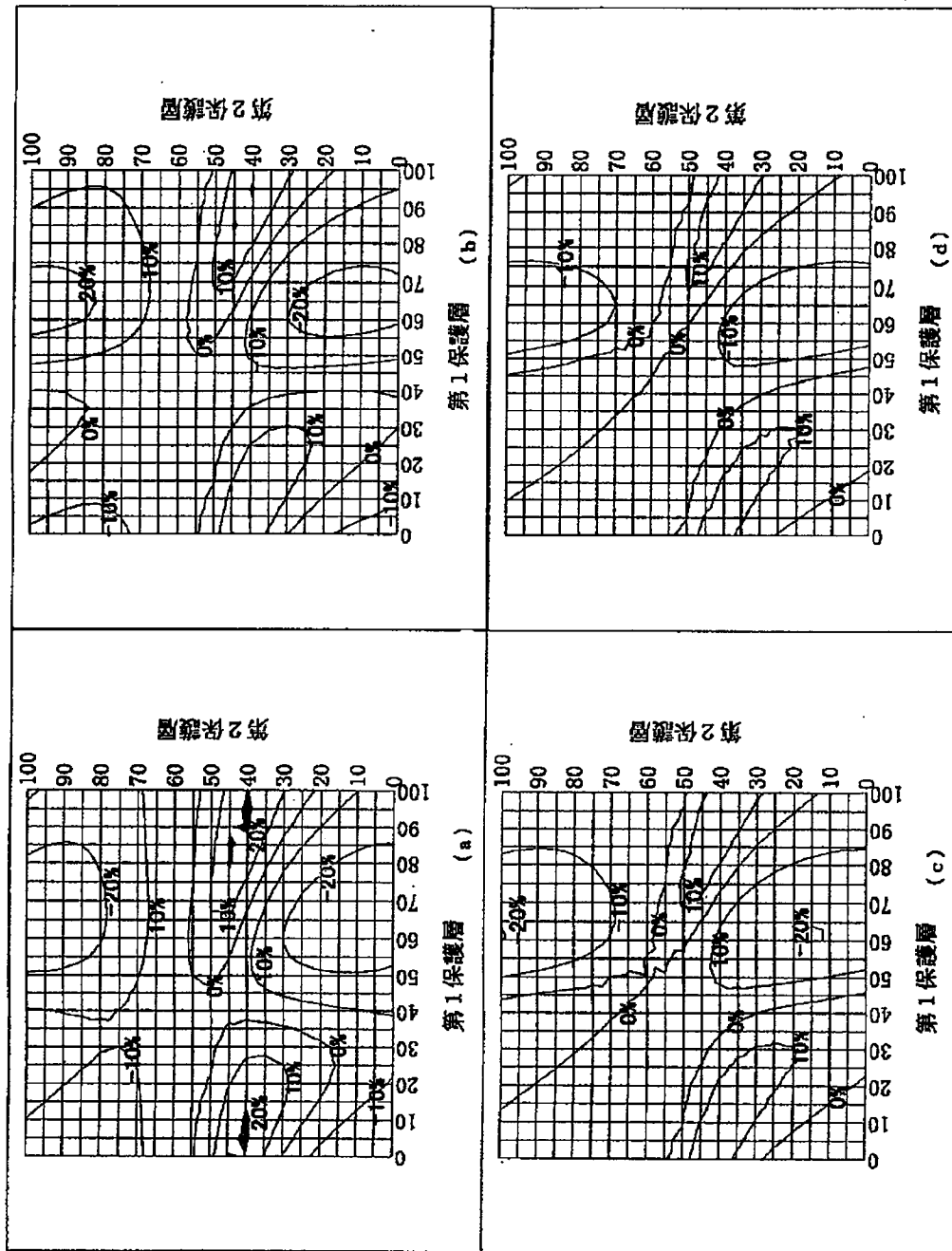
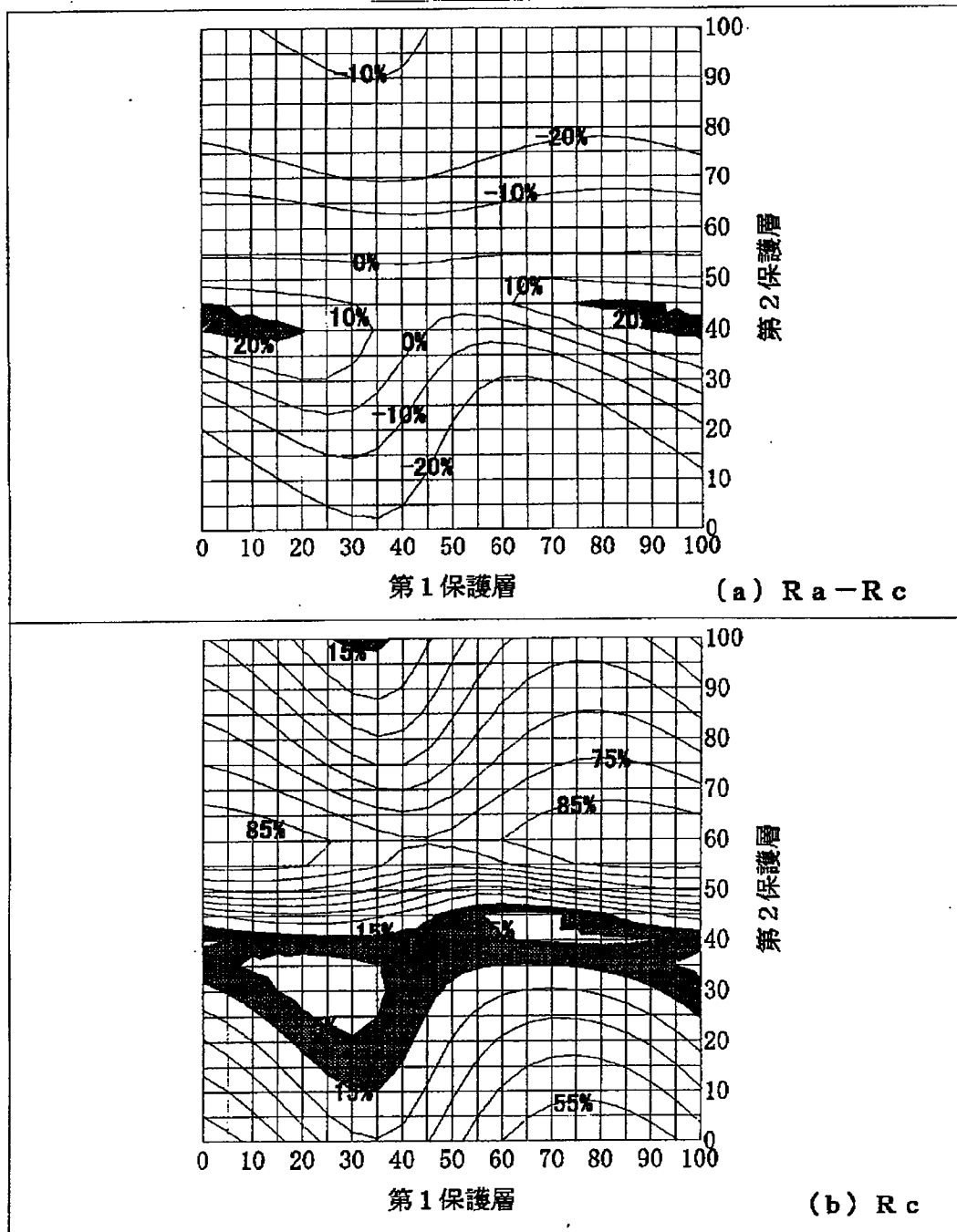


図 18

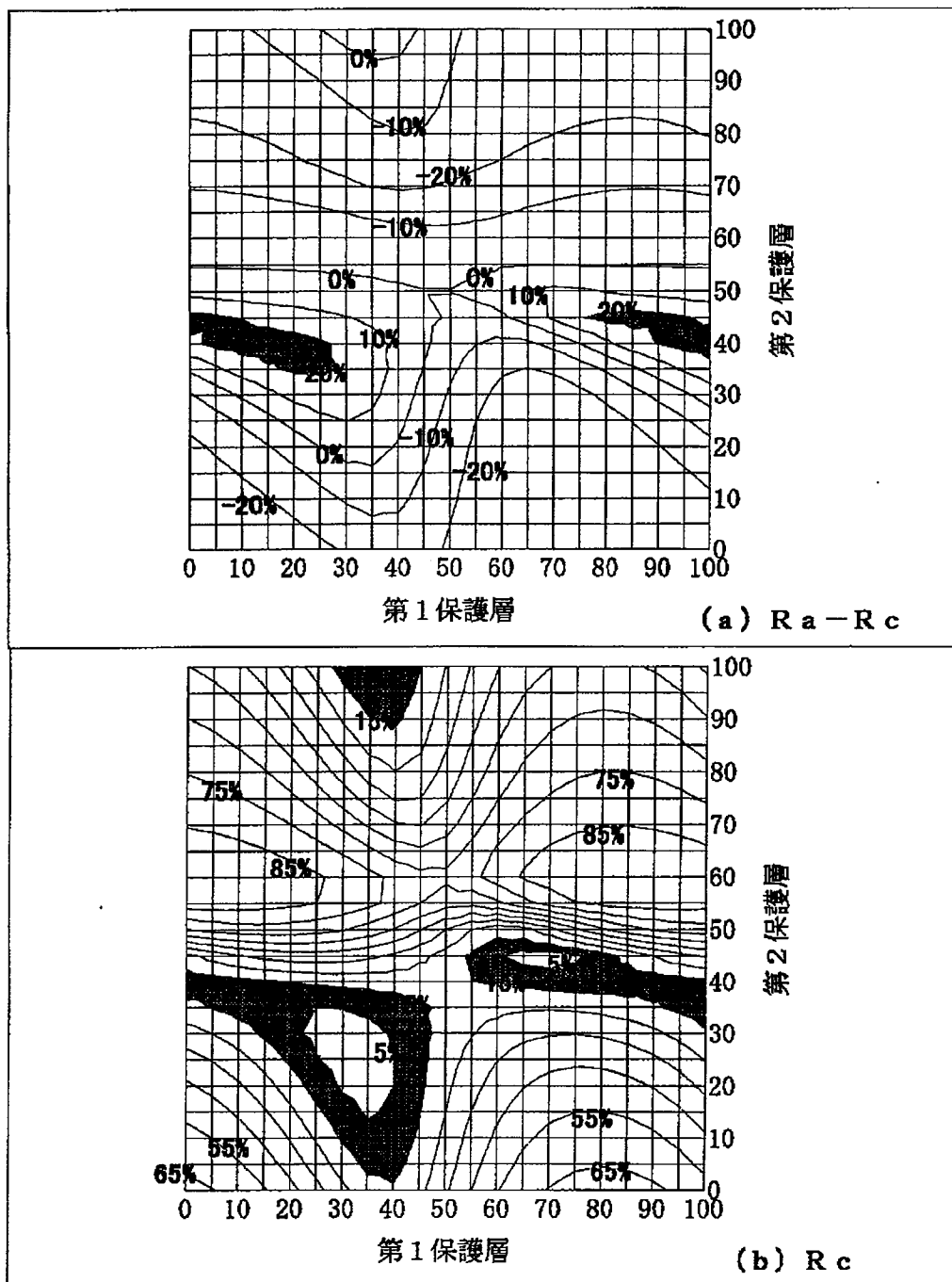
【図19】

図 19



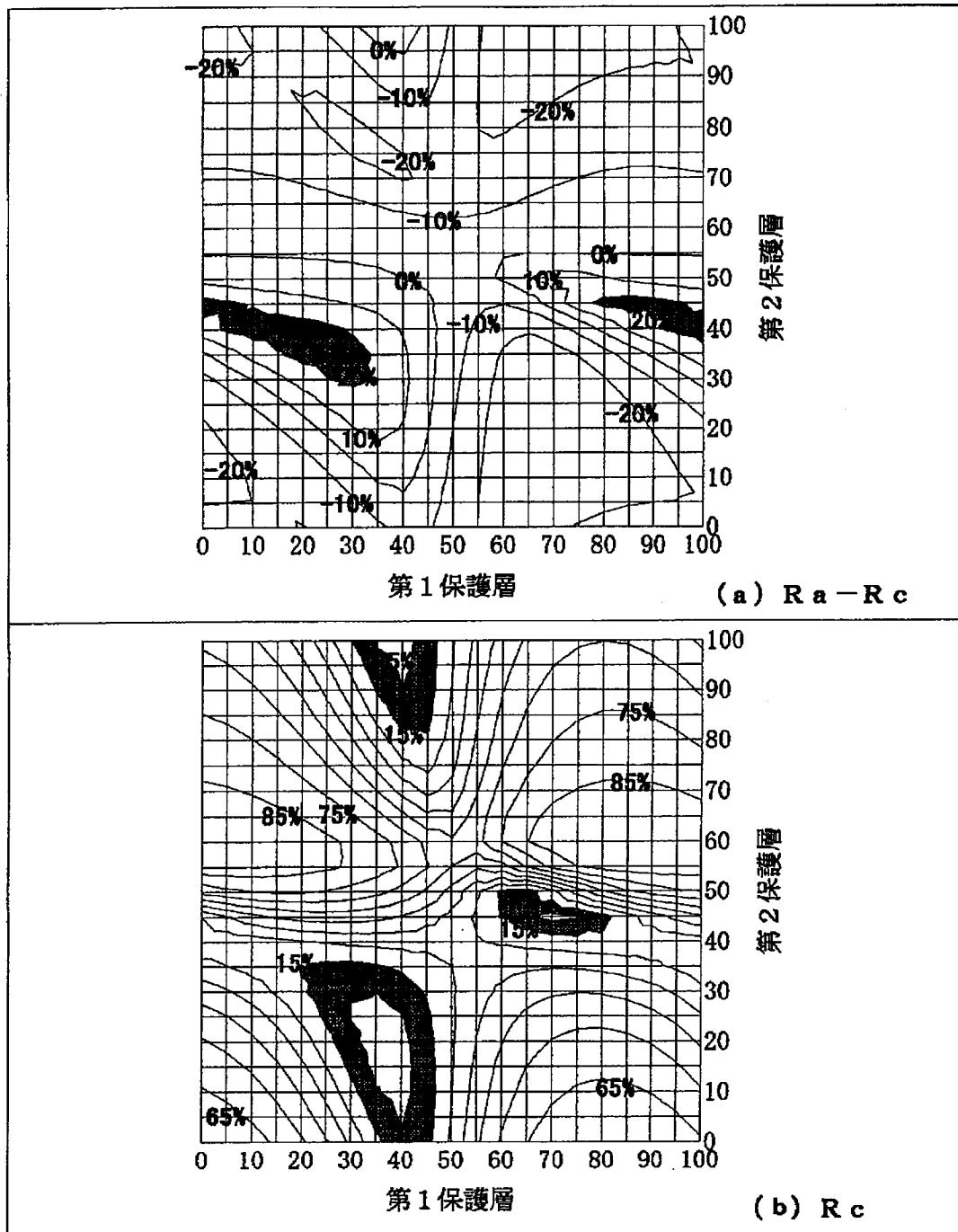
【図20】

図 20



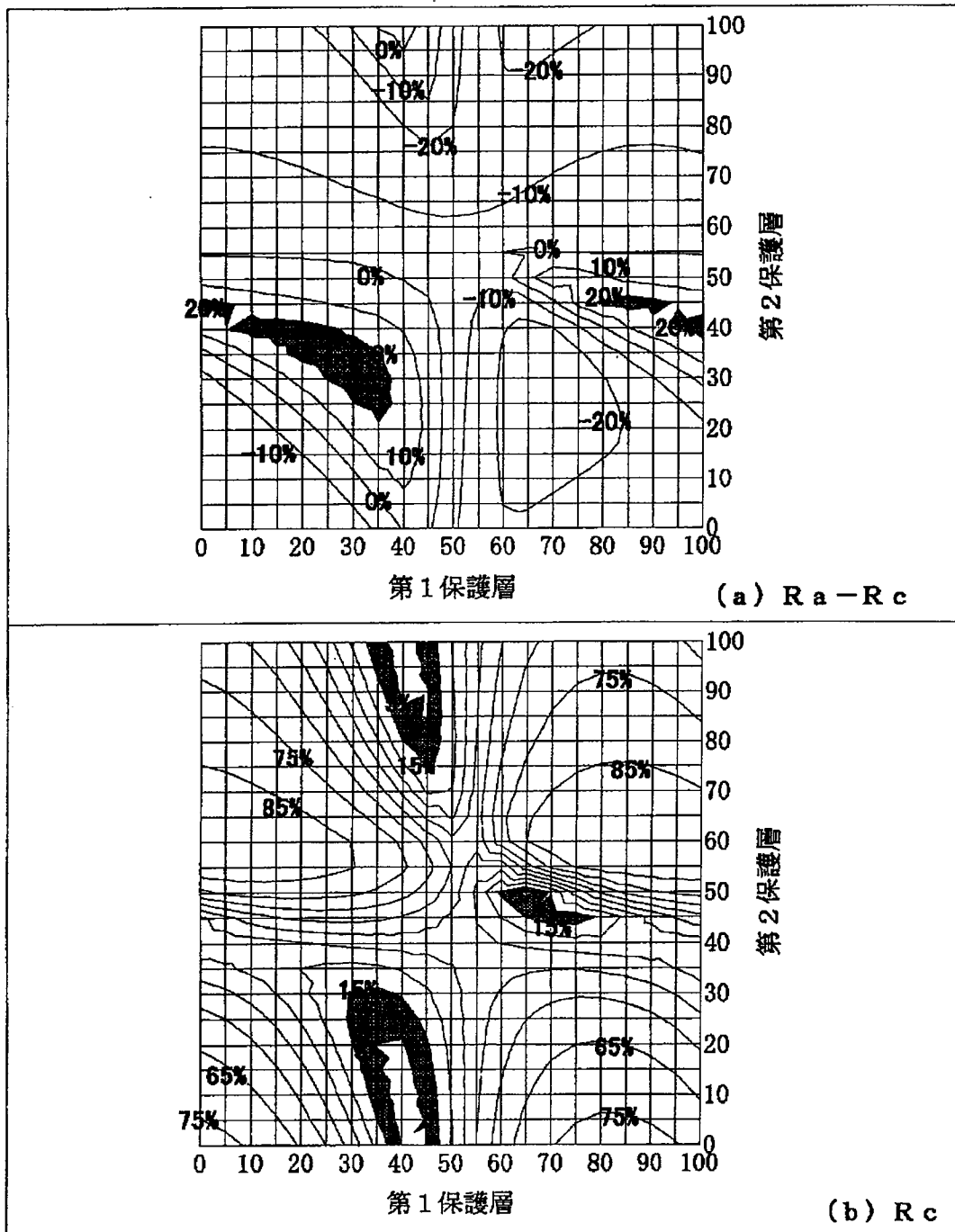
【図21】

図 21



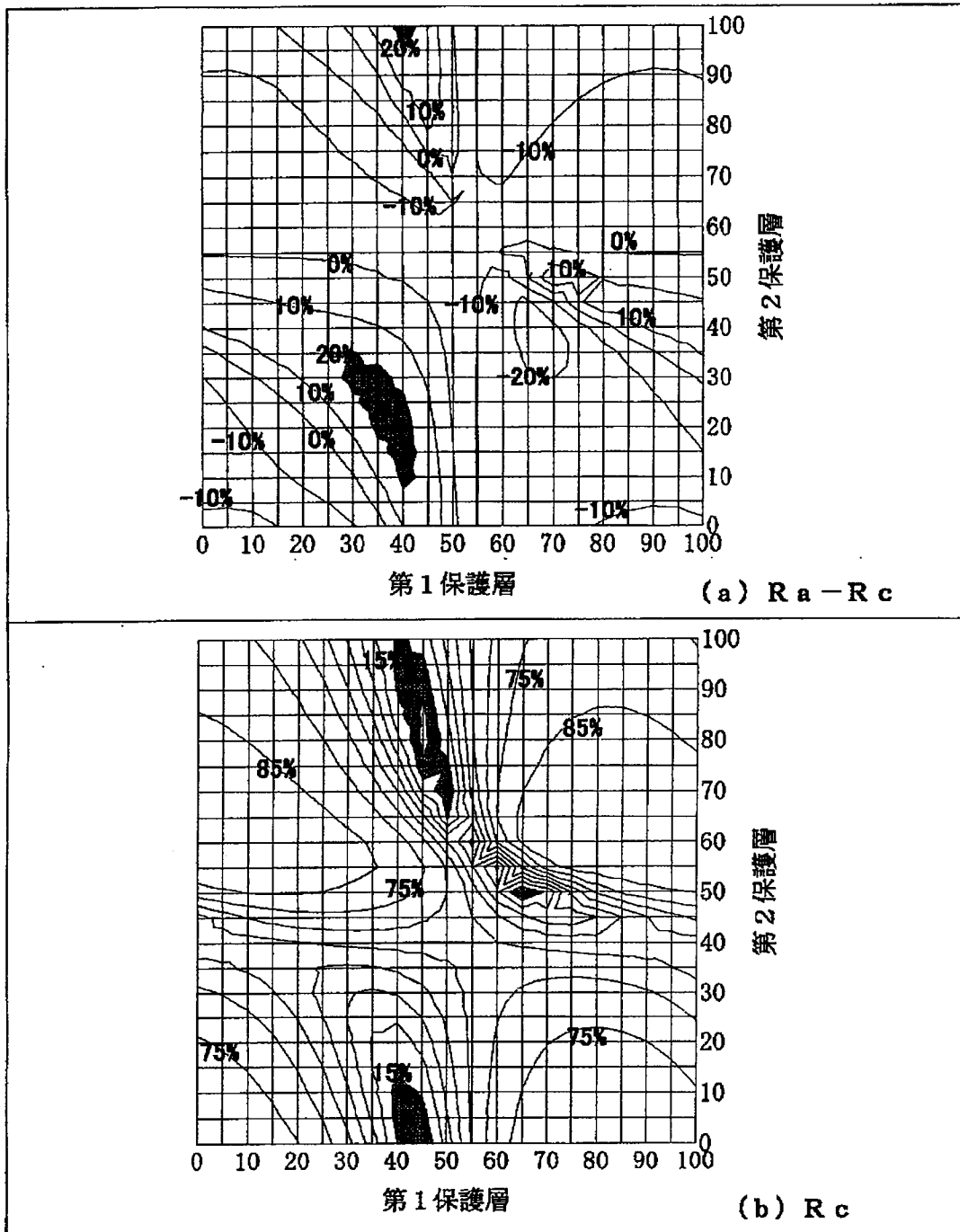
【図22】

図 22



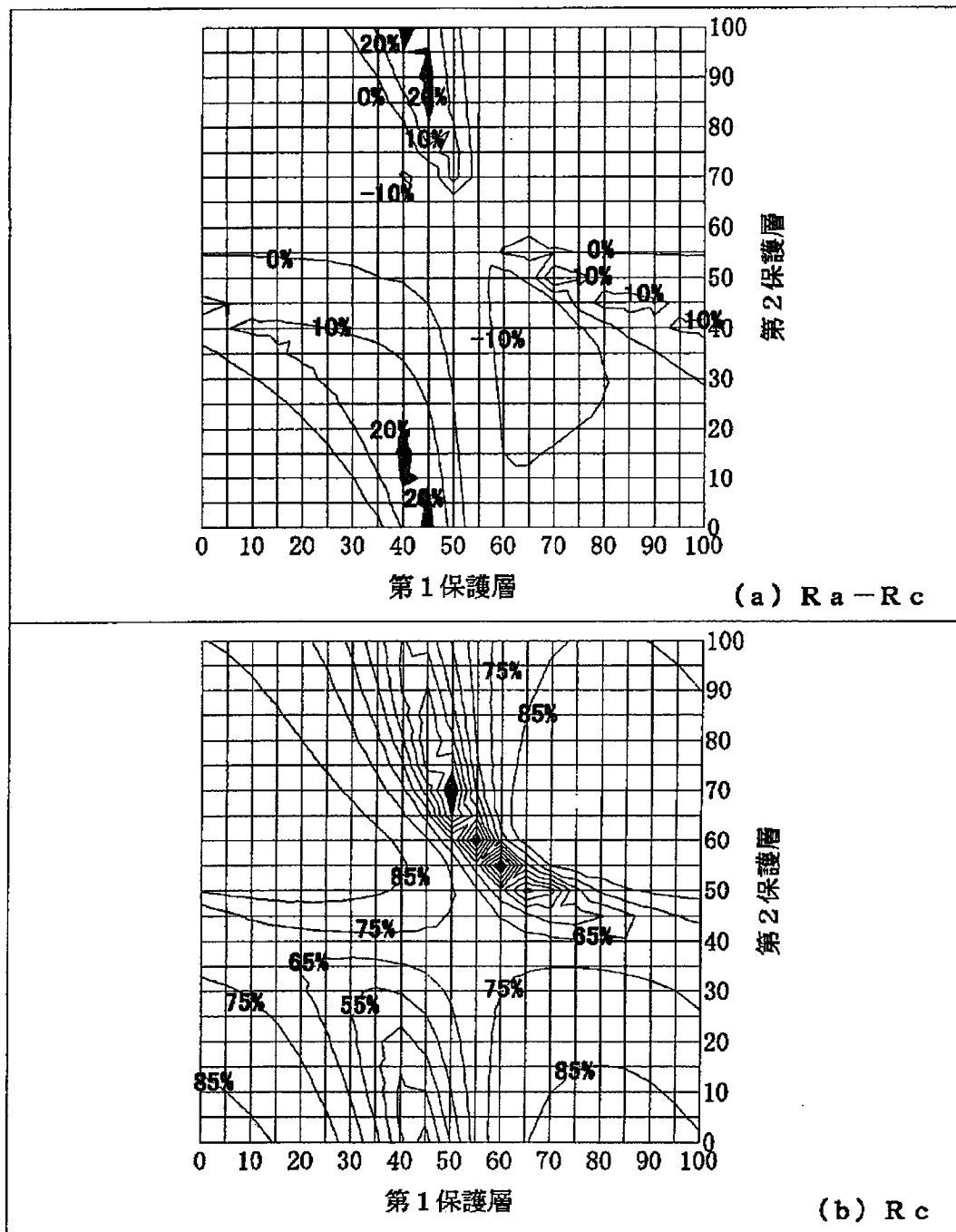
【図23】

図 23



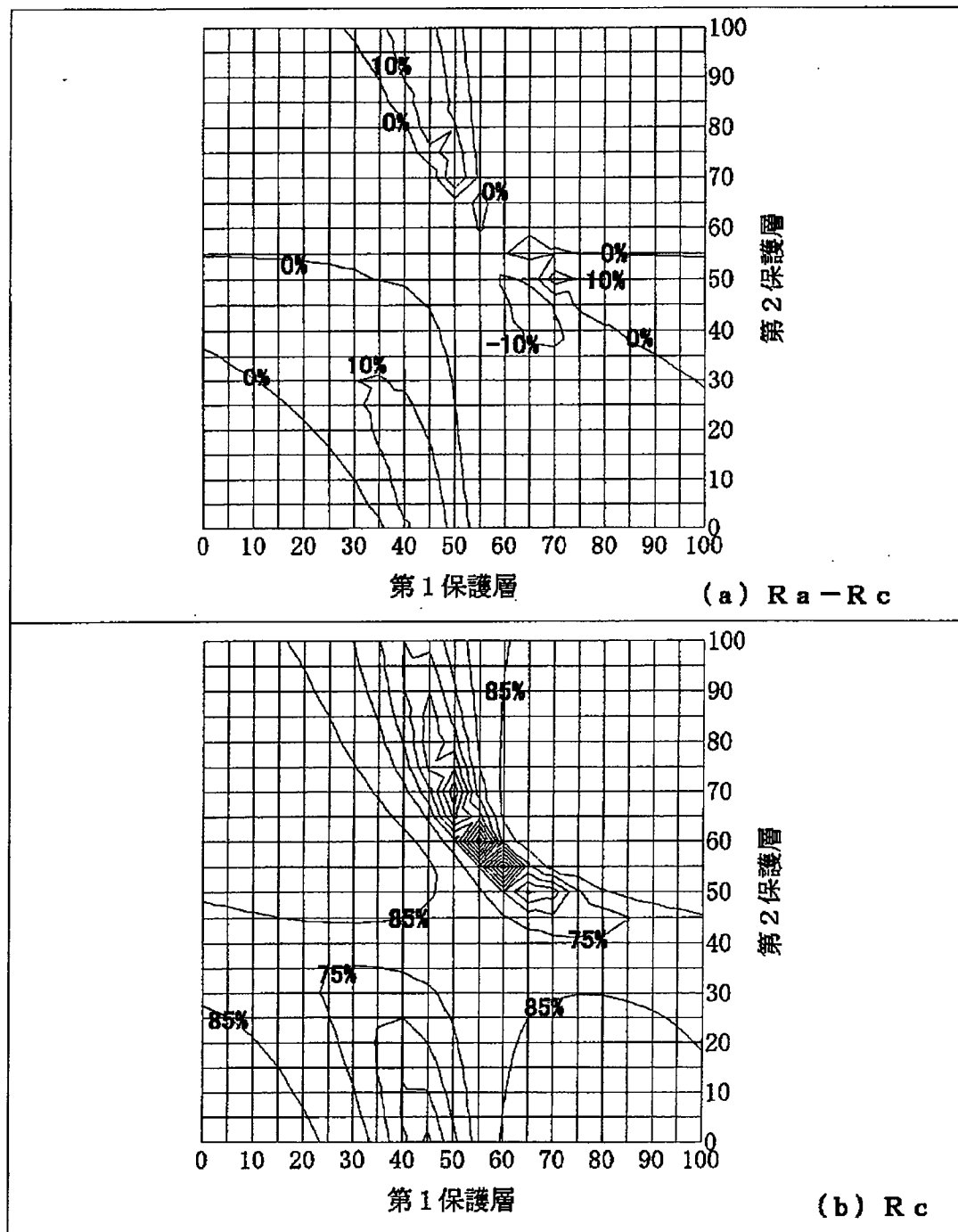
【図24】

図 24



【図25】

図 25



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

G 1 1 B 7/24

識別記号

5 3 4

5 3 5

5 3 8

F I

G 1 1 B 7/24

ターモート (参考)

5 3 4 L

5 3 5 G

5 3 8 C

5 3 8 E

5 3 8 F

B 4 1 M 5/26

B 4 1 M 5/26

X

(72)発明者 堀江 通和
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
三菱化学株式会社横浜総合研究所内

F ターム(参考) 2H111 EA03 EA04 EA12 EA23 EA31
EA40 FA11 FA12 FA14 FA21
FA23 FA27 FB05 FB09 FB12
FB30
5D029 JA01 JB35 JC02 LA15 LB07
MA13 MA17 NA07

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-074741

(43)Date of publication of application : 15.03.2002

(51)Int.Cl. G11B 7/24

B41M 5/26

(21)Application number : 2001-177162 (71)Applicant : MITSUBISHI
CHEMICALS CORP

(22)Date of filing : 12.06.2001 (72)Inventor : ONO TAKASHI
KIYONO KENJIRO

HORIE MICHIKAZU

(30)Priority

Priority number : 2000180701

Priority date : 16.06.2000

Priority country : JP

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical information recording medium having improved repetitive recording characteristics, recording power margin and shelf stability.

SOLUTION: The optical information recording medium has an Ag-base translucent layer, a dielectric-containing first protective layer, a phase-change type recording layer comprising an alloy based on SbxTe_{1-x} ($0.7 < x \leq 0.9$), a

dielectric-containing second protective layer and a metallic reflecting layer in this order. In the case where the first protective layer contains a sulfur- containing dielectric, the medium has a diffusion preventing layer between the translucent layer and the first protective layer. When light is made incident from the translucent layer the reflectance of the medium in the amorphous state of the recording layer is higher than that in the crystalline state of the recording layer.

LEGAL STATUS [Date of request for examination] 09.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The 1st protective layer containing the translucent layer which uses Ag as a principal component, and a dielectric, the phase change mold recording layer which consists of an alloy which uses $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 < x \leq 0.9$) as a principal component, It is the medium for optical information record which has the 2nd protective layer containing a dielectric, and a metallic reflective layer in this order. When this 1st protective layer contains the dielectric containing sulfur, it comes to have a diffusion prevention layer between this translucent layer and this 1st protective layer. The medium for optical information record characterized by the reflection factor of a medium in case a recording layer is an amorphous

state being higher than the reflection factor of a medium in case a recording layer is a crystallized state when incidence of the light is carried out from this translucent layer side.

[Claim 2] The medium for optical information record according to claim 1 by which a recording layer consists of an alloy which uses $1(\text{SbxTe } 1-x)\text{-yGey}$ ($0.7 < x \leq 0.9$, $0 < y \leq 0.1$) as a principal component.

[Claim 3] The 1st protective layer, phase change mold recording layer containing the translucent layer which uses Ag as a principal component, and a dielectric, Are the medium for optical information record which has the 2nd protective layer containing a dielectric, and a metallic reflective layer in this order, and it sets to this recording layer. Crystallization advances considering the crystal growth from the boundary of the amorphous section or a fusion zone, and the crystal section as a subject. When this 1st protective layer contains sulfur, it comes to have a diffusion prevention layer between this translucent layer and this 1st protective layer. The medium for optical information record characterized by the reflection factor of a medium in case a recording layer is an amorphous state being higher than the reflection factor of a medium in case a recording layer is a crystallized state when incidence of the light is carried out from this translucent layer side.

[Claim 4] The medium for optical information record according to claim 1 to 3 which is $R_a - R_c \geq 15(\%)$ when setting the reflection factor of a medium in case

(%), Ra, and this recording layer are crystallized states about the reflection factor of a medium in case this recording layer is an amorphous state to Rc (%).

[Claim 5] The medium for optical information record according to claim 1 to 4 whose thickness of this translucent layer is 1nm or more 40nm or less.

[Claim 6] The thickness of this 2nd protective layer is 30nm or more 50nm or less, and it is a medium for optical information record according to claim 1 to 5 with the 1st protective layer thinner than the 2nd protective layer.

[Claim 7] The medium for optical information record according to claim 1 to 6 by which this metallic reflective layer uses Ag as a principal component.

[Claim 8] The medium for optical information record according to claim 7 which comes to have a diffusion prevention layer between this metallic reflective layer and this 2nd protective layer when this 2nd protective layer contains sulfur.

[Claim 9] Are a medium for performing record playback with with a 350nm or more wavelength [450nm or less] light, and the 1st protective layer and the 2nd protective layer are substantially transparent on this wavelength. The refractive index in this wavelength is 2.4 or less [2.0 or more]. The thickness of a translucent layer And 5nm or more 30nm or less, The medium for optical information record according to claim 7 or 8 whose thickness of 30nm or more 50nm or less and a metallic reflective layer the thickness of the 5nm or more 20nm or less and the 2nd protective layer is [the thickness of the 1st protective

layer] 40nm or more 100nm or less for the thickness of 1nm or more 40nm or less and a recording layer.

[Claim 10] The medium for optical information record according to claim 1 to 9 whose Ag content of this translucent layer is more than 90 atom %.

[Claim 11] The medium for optical information record according to claim 10 whose volume resistivity of this translucent layer is below 100n ohm-m more than 20n ohm-m.

[Claim 12] The medium for optical information record according to claim 7 to 11 whose Ag content of this metallic reflective layer is more than 90 atom %.

[Claim 13] The medium for optical information record according to claim 12 whose volume resistivity of this metallic reflective layer is below 100n ohm-m more than 20n ohm-m.

[Claim 14] The medium for optical information record according to claim 1 to 13 which prepares a with a 10-micrometer or more thickness [200 micrometer or less] transparence enveloping layer in the opposite side with the 1st protective layer of this translucent layer, and comes to prepare a substrate in the opposite side with the 2nd protective layer of this metallic reflective layer.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the rewritable medium for optical information record of high recording density. It is related with the phase change mold record medium which was excellent in a record signal jitter, a record power margin, property degradation by repeat record, preservation stability, etc. especially.

[0002]

[Description of the Prior Art] Recently, the rewritable compact disk compatible medium of CD-RW etc. already spreads, and Kamiichi of the rewritable DVD compatible medium of DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, etc. is being carried out. These phase-change optical disks are the cheap mass record media excellent in portability, weatherability, shock resistance, etc. Record elimination is performed using the reflection factor change accompanying reversible change of a crystallized state in such a phase change mold optical recording medium. Generally, a crystallized state is made into un-recording / elimination condition, and a mark of being amorphous (amorphous) is formed and recorded here. Usually, it crystallizes by heating a recording layer and maintaining near

crystallization temperature fixed time, and to temperature higher than the melting point, a recording layer is heated, and is quenched and made amorphous. Generally the crystal phase is more more stable so that it may understand also from whenever [stoving temperature] differing.

[0003] Many chalcogen system alloys are used as an ingredient of a recording layer. For example, a GeSbTe system, an InSbTe system, a GeSnTe system, and an AgInSbTe system alloy are mentioned. These alloys are also the ingredients [over-write / ingredients]. The false system alloy (the false system alloy of 2 yuan is called hereafter) of 2 yuan which consists of Sb₂Te₃ and GeTe especially, or the alloy which makes it a principal component near the Sb₇₀Te₃₀ eutectic presentation is known. both -- a crystal and an amorphous substance (amorphous) -- any condition is stable and is the record ingredient between both conditions in which high-speed phase transition is comparatively possible. Moreover, when repetition over-writing is performed, there is also the advantage of being hard to produce a segregation, and it is put in practical use as a recording layer of a phase-change optical disk. In addition, in case over-writing (Direct Over Write) records on a medium [finishing / record / once] again, it is the technique of carrying out overwrite as it is, and technique to record, eliminating so to speak, without eliminating before record. Since record is usually performed by over-writing by the phase change mold medium,

over-writing may only be called record.

[0004] Also in the alloy which makes it a principal component near [above-mentioned] the Sb70Te30 eutectic presentation, the alloy (it is only hereafter called an eutectic system alloy) which contains Sb superfluously from a Sb70Te30 eutectic presentation especially attracts attention in recent years. Since the configuration of the edge (a mark edge, mark edge) of an amorphous mark is smooth, a jitter is stopped small, and since the crystal growth rate is very early, the recording layer using this alloy has the description that high-speed over-writing is possible. By the way, generally phase change mold record media are a medium with the reflection factor lower than record before after record, and the so-called high-to-low medium. Usually, since a crystallized state is made into un-recording / elimination condition and an amorphous state is made into a record condition, it means that the reflection factor of a medium in case a recording layer is an amorphous state is lower than the time of a recording layer being a crystallized state. A high-to-low medium usually has the lamination which consists of the 1st protective layer, a recording layer, the 2nd protective layer, and a reflecting layer.

[0005] On the other hand, with this, the medium with the reflection factor conversely higher than record before after record and the so-called low-to-high medium are also known. That is, the reflection factor of a medium in case a

recording layer is an amorphous state is higher than the time of a recording layer being a crystallized state. In the low-to-high medium, the lamination which has the 1st protective layer which has the translucent layer which uses a metal as a principal component, and a dielectric, a recording layer, the 2nd protective layer which has a dielectric, and a metallic reflective layer in this order is known. It is said that the low-to-high medium which consists of such lamination can generally reduce cross erasion rather than a high-to-low medium. The usefulness of a low-to-high medium is further known for the medium using the false system alloy recording layer of 2 yuan. For example, when an about five germanium₂Sb₂Te [which is the example of representation of the false system alloy of 2 yuan] alloy is used as a recording layer, the elimination nonuniformity produced from the difference in the rate of light absorption of the amorphous section and the crystal section is canceled, and it is supposed that high-speed over-writing is become possible.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, by the medium using an eutectic system alloy recording layer, the usefulness of the low-to-high medium which consists of the above lamination had not clarified. The data of having been effective in cross erasion reduction are not obtained by having considered as the low-to-high medium, and since high-speed over-writing is possible for an

eutectic system alloy recording layer from the first, contribution by having considered as the low-to-high medium in this point is not clear, either. The phenomenon in which preservation stability and a repeat recording characteristic fell remarkably conversely by considering as a low-to-high medium, not to mention it, was observed. Although a recording characteristic falls to some extent repeatedly, a low-to-high medium has [a high-to-low medium] the still larger fall of a property. That is, when an eutectic system alloy recording layer was used, the property excellent in the lamination of the conventional common low-to-high medium was not acquired.

[0007]

[Means for Solving the Problem] As a result of this invention persons' examining wholeheartedly the trouble of a low-to-high medium of having used the eutectic system alloy recording layer, by making the ingredient of lamination and each class into specific combination showed that the medium of the outstanding property was obtained for the first time. And this medium completed header this invention for it being the medium which excelled the usual high-to-low medium in the recording characteristic or the record power margin repeatedly. The 1st protective layer containing the translucent layer to which the summary of this invention uses Ag as a principal component, and a dielectric, The phase change mold recording layer which consists of an alloy which uses $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 <$

$x \leq 0.9$) as a principal component, It is the medium for optical information record which has the 2nd protective layer containing a dielectric, and a metallic reflective layer in this order. When this 1st protective layer contains the dielectric containing sulfur, it comes to have a diffusion prevention layer between this translucent layer and this 1st protective layer. When incidence of the light is carried out from this translucent layer side, it consists in the medium for optical information record characterized by the reflection factor of a medium in case a recording layer is an amorphous state being higher than the reflection factor of a medium in case a recording layer is a crystallized state.

[0008] The 1st protective layer containing the translucent layer to which another summary of this invention uses Ag as a principal component, and a dielectric, Are the medium for optical information record which has a phase change mold recording layer, the 2nd protective layer containing a dielectric, and a metallic reflective layer in this order, and it sets to this recording layer. Crystallization advances considering the crystal growth from the boundary of the amorphous section or a fusion zone, and the crystal section as a subject. When this 1st protective layer contains sulfur, it comes to have a diffusion prevention layer between this translucent layer and this 1st protective layer. When incidence of the light is carried out from this translucent layer side, it consists in the medium for optical information record characterized by the reflection factor of a medium

in case a recording layer is an amorphous state being higher than the reflection factor of a medium in case a recording layer is a crystallized state.

[0009]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, this invention is explained to a detail.

The 1st protective layer which contains first the translucent layer to which the lamination of the medium of this invention uses Ag as a principal component, and a dielectric, The phase change mold recording layer which consists of an alloy which uses $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 < x \leq 0.9$) as a principal component, It is the medium for optical information record which has the 2nd protective layer containing a dielectric, and a metallic reflective layer in this order, and in containing the dielectric with which this 1st protective layer contains sulfur, it comes to have a diffusion prevention layer between this translucent layer and this 1st protective layer. And it is the medium which carries out incidence of the light from a translucent layer side, and performs record playback, and is a low-to-high medium with the reflection factor of a medium in case a recording layer is an amorphous state higher than the reflection factor of a medium in case a recording layer is a crystallized state. The reflection factor said here is a reflection factor in the wavelength of the light used for record playback.

[0010] The example of the lamination of the medium concerning this invention is shown in drawing 1 and drawing 2 . Drawing 1 is the case where form a metallic

reflective layer 5, the 2nd protective layer 4, the phase change mold recording layer 3, the 1st protective layer 2, the translucent layer 1 that uses Ag as a principal component, and a cover layer (transparence enveloping layer) 7 on a substrate 6 at this order, and incidence of the record playback light is carried out from a cover layer side. A cover layer (transparence enveloping layer) 7 consists of ultraviolet curing mold resin, a dielectric, plastics, etc. Drawing 2 is the case where form the translucent layer 1 which uses Ag as a principal component, the 1st protective layer 2, the phase change mold recording layer 3, the 2nd protective layer 4, a metallic reflective layer 5, and the protection coat layer 9 on a substrate 8 at this order, and incidence of the record playback light is carried out from a substrate side. The protection coat layer 9 consists of ultraviolet curing mold resin, a dielectric, plastics, etc. Below, the case of a film surface incidence type and drawing 2 is called a substrate side incidence type for the case of drawing 1 .

[0011] Drawing 3 is a modification. When the 1st protective layer 2 contains the dielectric containing sulfur, the diffusion prevention layer 11 is formed between the translucent layer 1 and the 1st protective layer 2 which use Ag as a principal component. Drawing 4 is the further modification of the lamination of drawing 1 .

A metallic reflective layer 5 uses Ag as a principal component, and in containing the dielectric with which the 1st protective layer 2 and the 2nd protective layer 4

contain sulfur, the diffusion prevention layer 11 is formed between the translucent layer 1 and the 1st protective layer 2, and it comes to form the diffusion prevention layer 12 between the 2nd protective layer 4 and a metallic reflective layer 5.

[0012] The fundamental lamination of a low-to-high medium consists of the 1st protective layer which has the translucent layer which uses a metal as a principal component, and a dielectric, a recording layer, the 2nd protective layer which has a dielectric, and a metallic reflective layer. On the other hand, in this invention, a recording layer consists of an alloy which uses $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 < x \leq 0.9$) as a principal component, and it is characterized by a translucent layer using Ag as a principal component. Furthermore, when the 1st protective layer contains the dielectric containing sulfur, it is characterized by coming to have a diffusion prevention layer between this translucent layer and this 1st protective layer.

[0013] The alloy which uses $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 < x \leq 0.9$) as a principal component is an alloy which uses as a principal component the SbTe eutectic system presentation containing Sb more superfluous than $\text{Sb}_{70}\text{Te}_{30}$ which is the eutectic point in a Sb-Te binary-system-alloy phase diagram. It is that $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 < x \leq 0.9$) is specifically included more than 80 atom % as considering as a principal component. Hereafter, this is only called an eutectic system alloy.

Thereby, a repeat recording characteristic, a record power margin, preservation stability, etc. are improvable for the first time by the low-to-high medium using an eutectic system alloy recording layer. And this medium is a medium for optical information record which was [stability / a jitter, a record power margin, a repeat recording characteristic, / preservation] superior to other conventional media.

[0014] As above-mentioned, over-writing is technique recorded while eliminating, and performs crystallization and amorphous-ization to coincidence. Usually, since the way of crystallization has the slow rate, it leads to an over-write [promoting crystallization] at high speed. According to research of this invention persons, elimination of an amorphous mark, i.e., crystallization, advances according to two processes of crystal growth ** on the basis of the boundary of the crystal nucleation in (1) amorphous field, the (2) amorphous sections or a fusion zone (fused part which carried out the temperature up by optical exposure), and the crystal section. And in the false system alloy recording layer of 2 yuan, it goes on considering a process (2) as a subject in an eutectic system alloy recording layer to crystallization advancing considering a process (1) as a subject.

[0015] Therefore, what is necessary is just to promote crystal nucleation to enable high-speed over-writing of the false system alloy recording layer of 2 yuan. On the other hand, even if it promotes crystal nucleation in an eutectic

system alloy recording layer, effectiveness is small, and it is effective to make the rate of crystal growth increase. However, since it will be [amorphous] hard coming -izing [one side] if the rate of crystal growth is made to increase, it is necessary to devise lamination, to enlarge the cooling rate of a recording layer, in order not to drop the organization potency of an amorphous mark, and to carry out that it is easy to quench. Therefore, by the medium of this invention, since it is compatible with elimination by the high crystallization rate in formation of a good amorphous mark, it is required to promote the heat dissipation effectiveness combining the translucent layer of high temperature conductivity, and to secure a cooling rate especially. So, by the medium of this invention, the translucent layer which uses Ag as a principal component is used. Since high heat dissipation nature is obtained by this, this medium does not have the problem that a good amorphous mark is not formed, and is compatible in formation of elimination by the high crystallization rate, and a good amorphous mark.

[0016] Moreover, since the translucent layer which uses Ag as a principal component is equipped with a high optical property and the reflection factor difference of a crystallized state and an amorphous state can be enlarged, high contrast and big signal amplitude can also be obtained. Although Au, aluminum, Cu, etc. are generally known as a high reflection factor metal, especially Ag is

excellent in heat dissipation nature and an optical property. Especially in short wavelength with a wavelength of 650nm or less, it excels notably. This is considered to originate in there being [Ag] little absorption of short wave Nagamitsu, and thermal conductivity being high. In addition, it says that Ag is included more than 80 atom % as using Ag as a principal component. Furthermore, if Ag is used as a principal component for a metallic reflective layer, since higher heat dissipation nature and a high reflection factor will be obtained, it is desirable.

[0017] By the way, when the 1st protective layer is a protective layer (a sulfur-containing protective layer is only called hereafter) containing the dielectric containing sulfur, it is necessary to prepare a diffusion prevention layer between a translucent layer and the 1st protective layer. If the translucent layer which uses a sulfur-containing protective layer and Ag as a principal component has touched directly, in order to spread the sulfur contained in a protective layer in a translucent layer, to react with Ag and to spoil the function of a translucent layer, it is necessary to prepare a diffusion prevention layer among both layers, and to prevent this. The ingredient of a diffusion prevention layer is required to be hard to be spread to Ag which forms a translucent layer, i.e., to form neither Ag, a compound nor the solid solution. And it is required that reactivity with the sulfur contained in a protective layer should be low, or the sulfide should also be

chemically stable. In addition, when the 1st protective layer does not contain sulfur, it is not necessary to prepare a diffusion prevention layer, and a translucent layer and the 1st protective layer may be contacted directly. Moreover, a metallic reflective layer uses Ag as a principal component, and also when the 2nd protective layer is a sulfur-containing protective layer, it is necessary to prepare a diffusion prevention layer between a metallic reflective layer and the 2nd protective layer by the same reason.

[0018] The medium excellent in a repeat recording characteristic, a record power margin, preservation stability, etc. will not be able to be obtained without taking the above lamination by the low-to-high medium using an eutectic system alloy recording layer. And as compared with the conventional high-to-low medium, as for this medium, over-writing endurance is improved by leaps and bounds. If it puts in another way, an eutectic system alloy recording layer needs to make such lamination crystal growth from the boundary of the amorphous section or a fusion zone, and the crystal section, although crystallization from an amorphous state is the recording layer which advances as a subject therefore. Therefore, if it is the recording layer which takes the same crystallization process even if it is recording layers other than an eutectic system alloy, the above-mentioned property improvement can be made by making it the same lamination as this. That is, by taking the above-mentioned lamination, crystallization from an

amorphous state can obtain the medium which was excellent in a repeat recording characteristic, a record power margin, preservation stability, etc. in the low-to-high medium using the recording layer which advances as a subject in the crystal growth from the boundary of the amorphous section or a fusion zone, and the crystal section.

[0019] Even if it uses the medium of this invention for the usual binary recording method, it excels, but if it uses for the multiple-value recording method using multistage story change of a reflection factor which this invention persons have advocated by JP,2001-84591,A, over-writing endurance will be improved remarkably. Although degradation by repeat over-writing appears as change of a reflection factor, since change of a reflection factor causes the detection error of each reflection factor level immediately by the multiple-value recording method, a more stable over-writing property is searched for. If this invention record medium is used, it can be equal to the demand.

[0020] Below, it explains in more detail about this invention.

[1] In recording layer this invention, it is the phase change mold recording layer which consists of an alloy which uses $\text{Sb}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0.7 < x \leq 0.9$) as a principal component, i.e., an eutectic system alloy recording layer. Since Sb more superfluous than the $\text{Sb}_{70}\text{Te}_{30}$ eutectic point is not included as x is 0.7 or less, a crystallization rate is too slow. Moreover, if x is larger than 0.9, the

crystallization rate near the room temperature will become quick too much, an amorphous mark will become unstable, and the preservation stability of a medium will worsen. Preferably, it considers as the alloy which uses $1(\text{SbxTe}_{1-x})\text{-yGe}_y$ ($0.7 < x \leq 0.9$, $0 < y \leq 0.1$) as a principal component. By adding germanium, generation of a crystalline nucleus is suppressed and the preservation stability of an amorphous mark improves. It is said originally that a SbTe eutectic system recording layer has crystal growth more dominant than crystal nucleation in a crystallization process (G.F.Zhou, H.J.Borg, J.C.N.Rijpers, M.H.R.Lankhorst, and J.J.L.Horikx, Proceedings of SPIE, 4090 (2000) 108). If germanium is added here, it will be presumed that crystal nucleation is controlled further. Since it is comparatively easy to be generated at low temperature and the preservation stability of an amorphous mark is spoiled, a crystalline nucleus is considered that preservation stability is improvable by the thing of a crystallization process for which this is controlled. Moreover, when germanium is added, though it is an eutectic system, there is also an advantage of being hard to produce a segregation by over-writing repeatedly.

[0021] The element of further others may be added more than a kind to the above-mentioned presentation. However, an addition is made below into 10 atom % so that other properties may not be spoiled. It is 1 - 5% preferably. Especially desirable alloying elements are In and Ga. The configuration of the

boundary section with the crystal of an amorphous mark becomes very smooth by this, the jitter of a mark edge can be made low, and a noise is also reduced. Moreover, as being chosen out of Si, Sn, Pb, Au, Pd, Pt, Zn, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Co, Mo, Mn, Bi, O, N, S, Se, and rare earth, a kind may be added as it is few. For example, an optical property can be tuned finely or some stability with the passage of time can be improved.

[0022] In order to acquire sufficient optical contrast, and to make a crystallization rate quick and to attain record elimination in a short time, as for the thickness of a recording layer, it is desirable to be referred to as 5nm or more. However, in order to acquire sufficient optical contrast, it is [that it is hard to produce a crack] desirable [record layer membrane thickness] to be referred to as 100nm or less. It may be 30nm or less more preferably. Heat capacity can be made small by this and record sensibility can be raised. Moreover, the volume change accompanying a phase change can be made small, and effect of the repeat volume change by repeat over-writing can also be made small to the recording layer itself and an up-and-down protective layer. As a result, are recording of irreversible microscopic deformation is suppressed, a noise is reduced, and repeat over-writing endurance improves. Especially when using a purple-blue color laser beam [like / with a wavelength of 350-450nm] for record playback, as for a record bed depth, it is desirable to be referred to as 5nm or more 20nm

or less.

[0023] [2] In the crystallization process eutectic system recording layer of a recording layer, crystallization mainly advances with the crystal growth on the basis of the boundary of the amorphous section or a fusion zone (fused part which carried out the temperature up by optical exposure), and the crystal section. Therefore, an eutectic system recording layer has the advantage that there is no generating of the big and rough grain by crystalline-germ generation compared with the false 2 name-of-era alloy system recording layer (GeSb_2Te_4 , germanium₂Sb₂Te₅ grade) used widely conventionally, and a jitter becomes low. Moreover, since crystallization progresses by making crystal growth from the mark circumference into a subject, when the size (area) of an amorphous mark is large, crystallization (elimination) takes time amount, but there is an advantage that the time amount which crystallization (elimination) takes becomes short as size becomes small. It is in the inclination whose usefulness of an eutectic system recording layer increases, for example, mark size (mark width of face) is about 0.4 micrometers or less as mark size benefits the densification of record small. The wavelength of record playback light is short wavelength from about 650nm, and this corresponds, when the numerical aperture NA of the objective lens for focusing is larger than about 0.6.

[0024] The crystallization process of a recording layer is explained in detail

below. In an eutectic system alloy recording layer, crystallization (recrystallization) of an amorphous mark mainly advances with the crystal growth from the circumference crystal section of an amorphous mark. That is, in the case of recrystallization, a crystalline nucleus hardly occurs inside an amorphous mark, but the boundary point with the surrounding crystal section serves as a nucleus of crystal growth, and is considered to carry out crystal growth. It differs from recrystallization advancing by two steps, the generating process of the crystalline nucleus in which the false system alloy recording layer of 2 yuan carries out random generation into an amorphous mark, and the growth process of this crystalline nucleus, greatly. A recrystallization process is checked by observing the recording layer which irradiated uniformly (in direct current) the laser beam of the comparatively low elimination power P_e to the amorphous mark, and advanced crystallization imperfectly with a transmission electron microscope. By the eutectic system alloy recording layer, carrying out crystal growth from the amorphous mark periphery is observed to crystallizing the false system alloy recording layer of 2 yuan from the amorphous mark center section where temperature becomes high.

[0025] In addition, in an eutectic system alloy recording layer, crystal growth is carried out also from the boundary of the amorphous section, not only the boundary of the crystal section but a fusion zone, and the crystal section. That is,

when not reaching a critical cooling rate required to solidify [not to come out so much, although it may crystallize once a fusion zone forms the amorphous section, and] as for the cooling rate at the time of melting re-coagulation to be slow, and amorphous, the whole melting field will crystallize in an instant mostly (** which does not pass through an amorphous substance). Then, if it is the medium by which a reflection factor becomes almost equal to the reflection factor (namely, reflection factor of a crystallized state) of un-recording / elimination condition when the laser beam of the record power P_w is irradiated in direct current at a recording layer, it can be judged that it has the recording layer which takes the above-mentioned crystallization process. The reflection factor after a record power exposure makes 100% the reflection factor of un-recording / elimination condition, and, specifically, should just be the less than (70 - 130%) **30%. In addition, since a crystallization condition may change with initialization conditions, after performing initialization actuation to a medium and crystallizing to it, it is good to consider that the crystal section after an over-write about 10 times is "un-recording / elimination condition", and to make this reflection factor into 100%. Here, a reflection factor is a reflection factor of a medium.

[0026] Conversely, if it is the recording layer which does not pass through such a crystallization process, since the whole melting field will not recrystallize, the reflection factor after a record power exposure differs from the reflection factor of

an elimination condition. Usually, since the phase change mold recording layer is amorphous immediately after membrane formation, the initialization actuation which is made to crystallize the whole surface and is made into the condition of not recording is required. When it initializes by the melting recrystallizing method of this medium, a noise can be reduced and it is desirable. The crystallized state acquired by the initialization but without melting with almost same crystallized state (elimination condition) of the elimination field by over-writing and crystallized state by melting recrystallization is because reflection factors also differ unlike the crystallized state by melting recrystallization. Melting recrystallization performs a focusing light beam to a recording layer by irradiating in direct current.

[0027] Next, an experiment explains the mechanism of the recrystallization from a melting condition to a detail further. It scanned carrying out the tracking of the laser beam for record playback to the recording track in the condition of not recording, and after impressing the record power P_w which is sufficient for fusing a recording layer in direct current, the laser beam was intercepted at a certain time. The lower berth of drawing 5 is the control signal of P_w at that time. After cutoff is impressed in [the playback power P_r] direct current. When this truck was reproduced by the laser beam of the playback power P_r , a regenerative signal like the upper case of drawing 5 was acquired. This regenerative signal is

a value proportional to a reflection factor. It falls temporarily only at the time b of Pw cutoff, and its reflection factor is [regenerative-signal reinforcement] almost fixed in the other a and c. When this medium was observed by TEM, the amorphous mark is formed in the reflection factor fall section b, and it has checked that it was a crystallized state before and after [a and c] that. The crystallized state in a and c was almost the same, and was not able to be distinguished. That is, as long as Pw is being irradiated in direct current, it is shown that only the latest melting field which recrystallized, became the same crystal as the non-Records Department, and intercepted Pw makes a fusion zone amorphous.

[0028] This is because the cooling rate of a recording layer is controlled by the remaining-heat effectiveness from the consecutiveness section, it is intercepting Pw to a zero level mostly, the remaining heat from the consecutiveness section is intercepted to a critical cooling rate required for amorphous formation not being obtained and sufficient cooling rate for amorphous formation is obtained, when Pw is irradiated in direct current. When the record power Pw was changed, were experimented similarly and Pw was the power which is sufficient for fusing a recording layer, the partial decline in a reflection factor was observed by cutoff of Pw as well as b of drawing 5 . And the amorphous mark was formed in the reflection factor fall section. Conversely, if a reflection factor fall is observed near

the when saying and Pw is intercepted in this way, it turns out that the recording layer fused and the amorphous mark was formed of impression of the record power Pw.

[0029] In an eutectic system recording layer, crystallization (recrystallization) mainly advances with the crystal growth from the circumference crystal section of the amorphous section or a fusion zone. Since a crystallization rate tends to recrystallize such a recording layer quickly, the reflection factor after melting recrystallization becomes almost equal to the reflection factor in the condition of not recording. Of course, it may not become the same at all with the scan speed of the shape of beam or a beam. When the reflection factor in a of drawing 5 is specifically made into 100%, the reflection factor in c should just be the less than **30%. It was thought that the ingredient with remarkable recrystallization did not fit record conventionally. It is because most melting fields will recrystallize and only the part immediately after Pw cutoff will make it amorphous, if Pw is irradiated beyond a certain time amount in order to form a long mark. However, this invention persons found out that the recording layer which takes the above-mentioned crystallization process showed a rather good jitter in mark length modulation record of high density. It is effective if a division record pulse method is especially used together.

[0030] [3] When forming an amorphous mark with a long division pulse recording

method division pulse recording method, irradiate, combining a high-power laser pulse and the laser pulse of low power by turns. Hereafter, a high-power laser pulse is called a record pulse, and let power impressed at this time be the record power P_w . Moreover, the laser pulse of low power is called an off pulse, and let power impressed at this time be the bias power P_b . The exposure bias power P_b is low enough to extent which does not cause recrystallization by solid phase.

[0031] The field heated by the record pulse can be quenched relatively between off-pulses by this, and an amorphous substance is easy to be formed. Although it is desirable that it is recordable by the small record power P_w in order to make the start/fall of a pulse quick or to make cheap the laser light source used for record, that it is recordable by small power leads to it being easy to deteriorate with playback light. For this reason, as for a medium, it is desirable to design so that the record power P_w may be set to 8-25mW. It is 8-20mW more preferably, and is 8-17mW especially preferably. In addition, the bias power P_b has 0.5 or less ($P_b/P_w \leq 0.5$) desirable times of the record power P_w , and they are 0.3 or less ($P_b/P_w \leq 0.3$) times more preferably. When the tracking engine performance etc. is taken into consideration, the bias power P_b has a desirable value near the value of the power P_r of the playback light which irradiates at the time of playback. The playback power P_r is usually 0.5-1.0mW. It is good to make bias power P_b small and it is good also as 0 to speed up a cooling rate.

That is, it is not necessary to irradiate light.

[0032] It is desirable to irradiate the laser beam of the elimination power P_e at a recording layer at the time of crystal formation. The elimination power P_e is usually more greatly [than the bias power P_b] smaller than the record power P_w , although there will be especially no limit if it is the magnitude which can heat a recording layer so that a crystal can be eliminated in the case of over-writing. For example, it is referred to as $0.2 \leq P_e/P_w < 1.0$. The magnitude of the elimination power P_e is related also to the recrystallization field of the part fused by the exposure of the record power P_w . If continuous irradiation of the elimination power P_e is carried out, a recording layer can anneal the heated field relatively and can form a crystal while it is heated to near crystallization temperature. By combining the above, a crystal can be formed as it is amorphous, and it can divide, and over-writing record can be performed.

[0033] In case an amorphous substance is formed, the example which irradiates a record pulse and an off pulse by turns is shown below. In case the mark (amorphous substance) of the length nT (T is a reference clock period and n is the natural number) is formed, time amount nT is divided like the following formula (1).

[Equation 1]

$\alpha_1 T, \beta_1 T, \alpha_2 T, \beta_2 T, \dots, \alpha_{m-1} T, \beta_{m-1} T, \alpha_m T,$

$\beta_m T \dots (1)$

(However, $\alpha_1 + \beta_1 + \alpha_2 + \beta_2 + \dots$ [The zero or more real numbers and m of $\alpha_{m-1} + \beta_{m-1} + \alpha_m + \beta_m = n - j$ and j are one or more integers, and j and m are values decided with the combination of a medium and record conditions.])

the above-mentioned formula -- setting -- $\alpha_i T$ ($1 \leq i \leq m$) -- time amount -- a record pulse -- irradiating -- $\beta_i T$ ($1 \leq i \leq m$) -- an off-pulse is irradiated and recorded on time amount. And the light which has the elimination power P_e is irradiated in the field between marks (crystal phase). This can perform over-writing record.

[0034] An example of a division pulse recording method is shown in drawing 6 .

It is a laser wave for (a) corresponding to a record signal, and (b) corresponding to the record signal, and forming an amorphous substance and a crystal. In drawing 6 , the standup of a head pulse, the standup of the last off-pulse, etc. do not necessarily need to be in agreement with the starting position and termination location of the original record signal. Moreover, sum total pulse width $(n - j)$ may be finely tuned according to former mark length or the merit between marks. Furthermore, it is most effective to make only the top record pulse α_1 slightly longer than a consecutiveness pulse, and to set up only the OFF pulse width β_1 of a head and the last edge and β_m apart from other off-pulses in

order to maintain the property balance of a long mark and a short mark. It is because long duration is required a little for a temperature up since the head record pulse alpha 1 does not have the remaining-heat effectiveness. Or only the head record pulse alpha 1 of setting up record power more highly is also effective.

[0035] A good mark may be able to be formed by changing only betam according to the mark length nT . For example, since heat tends to collect so that it becomes long marks, such as 11T mark and 14T mark, in eight-to-fourteen modulation or an EFM+ modulation, it is good to lengthen betam and to lengthen a cooldown delay slightly. Conversely, in the short mark of 3T grade, it is good to shorten betam. betam can be set to 0. As for the adjustment width of face of betam, about 0.5T is desirable. Furthermore, a pulse control will become easy if the change of a pulse is synchronized with a clock period.

[0036] [4] the medium using the eutectic system alloy recording layer of high heat dissipation nature lamination this invention -- setting -- false -- duality -- it is more indispensable than a system alloy recording layer to raise cooling effectiveness further. Hereafter, in an eutectic system alloy recording layer, the need of using the lamination of high heat dissipation nature is explained. Although the recording layer of this invention is an eutectic system alloy with a Sb/Te ratio higher than 70/30 and being excelled in the point in which

high-speed elimination with 10 or more m/s of linear velocity is possible, since it is very easy to recrystallize, there is also an inclination with difficult formation of a conversely good amorphous mark. Since the time amount by which the elimination power P_e is irradiated by one field becomes short as linear velocity becomes quick, and the time amount by which a recording layer is maintained at the elevated temperature near the melting point becomes very short, crystal growth will become inadequate. In order to ensure elimination in such a short time, the rate of crystal growth near the melting point of a recording layer must be raised remarkably.

[0037] It is effective to increase the amount of Sb(s) of the SbTe alloy used as a parent to it, and to make [more] the superfluous amount of Sb(s) than Sb₇₀Te₃₀ (M. Horie, N.Nobukuni, KKiyono, and T.Ohno., Proceedings of SPIE, 4090 (2000), 135). However, increasing Sb addition also makes quick the rate of crystal growth at the time of melting re-coagulation while promoting the recrystallization from the circumference crystal section of an amorphous mark. If the recrystallization rate from the amorphous mark circumference is made quick to some extent above, when the field fused in order to record an amorphous mark re-solidifies, the recrystallization from a melting field periphery advances, and it will recrystallize, without making it amorphous. Especially this inclination becomes remarkable when an over-write [5-6 or more m/s of linear velocity]. In

order to prevent this, the cooling rate of a recording layer must be made very quick.

[0038] On the other hand, in the false system alloy recording layer of 2 yuan, crystal nucleation is important and the rate of crystal growth is slow rather. Crystallization is attained by filling the whole amorphous field surface with generating many crystalline nuclei with crystal grain, even if crystal growth is comparatively late. And high-speed elimination is attained by promoting crystal nucleation. Crystal nucleation usually serves as max from the melting point at quite low temperature compared with crystal growth. Therefore, in the temperature up process in which it results near the melting point, after carrying out crystal nucleation at low temperature comparatively, recrystallization progresses efficiently in the sequence of crystal growth near the melting point. Since crystal growth cannot progress easily on the other hand even if crystal nucleation occurs at low temperature comparatively by the process in which temperature falls, below in the melting point from a melting condition, even if the cooling rate of a recording layer is comparatively small, a good amorphous mark can be formed.

[0039] [5] Since it is compatible in formation of elimination by the high crystallization rate, and a good amorphous mark, it is necessary to promote the heat dissipation effectiveness combining the reflecting layer of high temperature

conductivity, and to secure the cooling rate of a recording layer in a metallic reflective layer, therefore this invention. In order to obtain sufficient reflection factor, as for a metallic reflective layer, it is desirable to consider as 40nm or more of thickness. However, in order to reduce membrane stress, and in order to shorten membrane formation time amount, to shorten production time and to reduce cost, it is desirable to consider as 400nm or less of thickness. It may be 200nm or less more preferably. Although it is better to thicken thickness for raising heat dissipation nature generally, membrane stress is high and a crack tends to enter, so that it is thick.

[0040] It is desirable to make thickness thinner by the film surface incidence type medium (for example, drawing 1). By this type, the surface smoothness of all the layers later formed by the surface smoothness of the reflecting layer formed first is governed, and if the surface smoothness of a reflecting layer is bad, record playback light will be scattered about and it will be easy to become a noise. Since the surface smoothness of the reflective film gets worse as thickness becomes thick, it is desirable to usually set thickness of a reflecting layer to 100nm or less. As for the surface smoothness of a reflecting layer, it is desirable that the granularity (roughness) when measuring the irregularity of the front face with an atomic force microscope (Atomic Force Microscopy, AFM) is less than 1nm. Roughness finds average height from the profile of surface

irregularity, and means the value which took the standard deviation of the difference of elevation to the level surface of each point by making this average height into the level surface.

[0041] The ingredient used for a metallic reflective layer has a desirable ingredient with the small rate of the record playback absorption of light, and since a role of a heat dissipation layer is also important, it is desirable that thermal conductivity is large. Therefore, it is desirable to use the alloy which makes a principal component metals of a high reflection factor, such as Ag, aluminum, Au, and Cu, or them as a reflecting layer. When an impurity is mixed, it has the fault to which thermal conductivity falls and the absorption of light becomes large, but since stability and film surface surface smoothness are improved with an alloying element on the other hand, these metals are good also as an alloy reflecting layer which contained the impurity element below 10 atom % in Ag, aluminum, Au, and Cu. As an impurity element, Cr, Mo, Mg, Zr, V, Nb, Hf, Ag, In, Ga, Zn, Sn, Si, Cu, Au, aluminum, Pd, Pt, Pb, Cr, Co, Ti, rare earth elements, O, N, etc. are mentioned. These element concentration carries out to below pentatomic % more preferably.

[0042] Since it is hard to absorb the light of short wavelength as compared with Au, Cu, and aluminum, Ag of Ag is desirable especially when using short wavelength laser with a wavelength of 650nm or less. Thermal conductivity of Ag

is large, and since a reflection factor will become large if there is thickness which is a certain extent, it can expect the increment in the signal amplitude using optical cross protection, and sufficient heat dissipation effectiveness. Furthermore, the price as a sputtering target is comparatively cheap, the discharge of Ag is stable, its membrane formation rate is quick, since it is stable in air, it is desirable in respect of productivity and economical efficiency, and it excels aluminum, Au, Cu, etc. also in these points. Therefore, it is advantageous to a reflecting layer to use the metal or alloy which uses Ag as a principal component.

[0043] By the way, the heat conductivity of a reflecting layer is considered to be in inverse proportion to the volume resistivity in general from Wiedemann Francis's (Wiedemann-Franz) principle. And since the heat dissipation effectiveness by the reflecting layer is proportional to thickness, it is in inverse proportion to sheet resistivity. Therefore, thermal conductivity and the heat dissipation effectiveness can be evaluated by measuring resistivity. Generally, although measurement of the thermal conductivity of a thin film is difficult, resistivity is comparatively easy to measure. In order to acquire sufficient heat dissipation effectiveness, as for the sheet resistivity of a reflecting layer, it is desirable to carry out to below 0.5ohms / **. It carries out to below 0.4ohms / ** more preferably. However, since record sensibility will get worse if the heat

dissipation nature of a reflecting layer is too high, it is desirable to carry out to more than $0.2 \text{ ohms} / \text{**}$. In order to attain the above-mentioned sheet resistivity by thin thickness, as for the volume resistivity of a reflecting layer, it is desirable to carry out to below 100 n ohm-m . Although the volume resistivity of a reflecting layer is so good that it is small, it is restricted as a matter of fact 20 nohm and more than m . In the state of the thin film whose thickness is about 100 nm , it is because a volume resistivity becomes large [a bulk condition] to about 10 times.

[0044] [6] In translucent layer this invention, it is characterized [one] by a translucent layer consisting of an alloy which uses Ag or Ag as a principal component. Since the heat of a recording layer can be missed in both a reflecting layer and a translucent layer by this, still higher heat dissipation nature is realizable. Moreover, the translucent layer which uses Ag as a principal component has little absorption of short wave Nagamitsu, and a refractive-index difference with a protective layer (usually refractive indexes 1.5-2.5) is large, and since the reflection factor difference of a crystallized state and an amorphous state can be enlarged, high contrast and big signal amplitude are obtained in a low-to-high medium. Furthermore, record sensibility is also improvable.

[0045] In addition, although the condition that the permeability of light is usually 10% or more as the film is "translucent" is shown, in this invention, 20% or more is 30% or more desirable especially preferably. The upper limit of permeability is

100%. It can ask for permeability by count from the complex index of refraction to light and thickness of the wavelength to be used. It is $R_a - R_c \geq 15(\%)$ when setting the reflection factor of a medium in case (%), R_a , and this recording layer are crystallized states about the reflection factor of a medium in case a recording layer is an amorphous state to R_c (%) preferably. Filling this means obtaining high contrast and large signal amplitude by the low-to-high medium.

[0046] Since an eutectic system alloy recording layer has the property of being hard to enlarge $R_a - R_c$ to short wave Nagamitsu, especially the usefulness that uses a translucent layer on the wavelength of 450nm or less is high. In addition, R_c and R_a can be roughly calculated by optical count. However, since the amorphous mark is formed all over the background of a crystallized state in fact and effect of reflective from the crystal section cannot be removed, R_a actual measurement consists lowness of R_a calculated value about 5 point. Calculated value and the actual measurement of R_c correspond mostly. In this invention, although $R_a - R_c \geq 15\%$ is made desirable, this is based on an actual measurement. Therefore, if calculated value compares, it corresponds to $R_a - R_c \geq 20\%$. Moreover, in order to attain high record sensibility, without exerting trouble on a focus servo or a tracking servo, considering as $0\% < R_c \leq 15\%$ is desirable. In order to maintain these servoes stably, being referred to as $5\% \leq R_c$ is more desirable.

[0047] The thickness of a translucent layer is decided by optical conditions and thermal conditions. In the case of the translucent layer which uses Ag as a principal component, in order to be translucent, 50nm or less of thickness is desirable. Moreover, in order to obtain high contrast and the high signal amplitude and to make it a low-to-high medium, 40nm or less is desirable. However, when achieving the function as a translucent layer, it is good to consider as 1nm or more of thickness. The optimal thickness changes also with the wavelength of the laser beam to be used. For example, when the wavelength of a laser beam is 350-450nm, 5-30nm of thickness is desirable. It is because the 1st protection layer membrane thickness dependency of R_c will become steep if it exceeds 30nm, and it is hard coming to carry out control of R_c by thickness. Also in order to make R_c into 5 - 15% of range, 30nm or less is desirable. Moreover, when it is made thinner than 5nm, it is because there is an inclination for the contrast of R_a - R_c to become small. Furthermore, in order to obtain high heat dissipation nature, 10nm or more of thickness is desirable.

[0048] A translucent layer consists of an alloy which uses Ag or Ag as a principal component in this invention. If an impurity is mixed, thermal conductivity will fall, the absorption of light will become large, but since stability and film surface surface smoothness are improved with an alloying element on the other hand, Ag is good also as an alloy containing the impurity element below 10 atom %. As

an impurity element, Cr, Mo, Mg, Zr, V, Nb, Hf, Ag, In, Ga, Zn, Sn, Si, Cu, Au, aluminum, Pd, Pt, Pb, Cr, Co, Ti, rare earth elements, O, N, etc. are mentioned. These element concentration carries out to below pentatomic % more preferably. In addition, the dielectric multilayers (dielectric mirror) which accumulated the dielectric layer from which a refractive index differs as a translucent layer are also known. However, dielectric multilayers tend to produce film exfoliation by the environmental condition, and a heat dissipation nature improvement effect like a metal is not acquired, either.

[0049] In order to acquire sufficient heat dissipation effectiveness, as for the sheet resistivity of a translucent layer, it is desirable to carry out to below $0.5 \text{ ohms} / \square$. It carries out to below $0.4 \text{ ohms} / \square$ more preferably. However, since record sensibility will get worse if the heat dissipation nature of a translucent layer is too high, it is desirable to carry out to more than $0.2 \text{ ohms} / \square$.

In order to attain the above-mentioned sheet resistivity by thin thickness, as for the volume resistivity of a translucent layer, it is desirable to carry out to below 100 n ohm-m . Although the volume resistivity of a translucent layer is so good that it is small, it is restricted as a matter of fact 20 n ohm and more than m . In the state of the thin film whose thickness is about 100 nm , it is because a volume resistivity becomes large [a bulk condition] to about 10 times. As mentioned above, with the combination of the translucent layer which uses the eutectic

system recording layer and Ag in this invention as a principal component, with constituting a low-to-high medium, the light energy absorption coefficient of heat dissipation nature and a crystallized state can be made high, and high record sensibility, high contrast, and the high signal amplitude can be attained.

[0050] [7] In protective layer this invention, the recording layer is covered with the protective layer in the upper and lower sides. What counters the 1st protective layer and a reflecting layer in what counters a translucent layer is called the 2nd protective layer. Therefore, by the medium of this invention, when incidence of the laser beam for record playback is carried out from a substrate side, it consists of a substrate, a translucent layer, the 1st protective layer, a recording layer, the 2nd protective layer, and a reflecting layer fundamentally, and a protection coat layer is prepared on it if needed (drawing 2). On the other hand, when incidence of the laser beam for record playback is carried out from a film surface, it becomes lamination contrary to this and consists of a transparence enveloping layer (cover layer) a substrate, a reflecting layer, the 2nd protective layer, a recording layer, the 1st protective layer, a translucent layer, and if needed (drawing 1). Moreover, even if a case constitutes these each class on both sides of a substrate, it is good also as a medium which ****s a film surface (protection coat layer) inside, and has each class on both sides.

[0051] The ingredient of a protective layer is determined with careful attention to

a refractive index, thermal conductivity, chemical stability, a mechanical strength, adhesion, etc. Generally, transparency contains the dielectric which is high-melting highly. Specifically, fluorides, such as an oxide of a metal or a semi-conductor, a sulfide, a nitride, and calcium, Mg, Li, can be used. As for these oxides, a sulfide, a nitride, and a fluoride, it is also effective for it not to be necessary to necessarily take stoichiometric composition, and to control a presentation, or to mix and to use for control, such as a refractive index. The mixture of heat-resistant compounds, such as ZnS, a rare earth sulfide, an oxide, a nitride, and carbide, is more specifically mentioned. As for the film consistency of these protective layers, it is desirable from the field of a mechanical strength that it is 80% or more of a bulk condition.

[0052] The dielectric which contains sulfur as a protective layer is used in many cases. For example, the mixture protective layer which mixed ZnS 80-mol% and mixed SiO₂ at an about [20mol%] rate is used widely. It is because it excels in adhesion with Sb and Te which are the principal component of a recording layer and the defective growth by the exfoliation at the time of repeat over-writing or prolonged preservation can be controlled. concrete -- zinc sulfide, a sulfuration tantalum, a sulfide like rare earth sulfides (Y, La, Ce, Nd, etc.), or oxysulfide like Y₂O₂S -- as independent or mixture -- less than [more than 20mol%90mol%] -- what is included is desirable. As for the remainder of mixture, it is desirable that

the melting point or decomposition temperature is a heat-resistant compound 1000 degrees C or more. As a heat-resistant compound 1000 degrees C or more, fluorides, such as oxides, such as Mg, calcium, Sr, Y, La, Ce, Ho, Er, Yb, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Zn, aluminum, Si, germanium, and Pb, a nitride, carbide, and calcium, Mg, Li, are mentioned for the melting point or decomposition temperature. The mixture of these thermal-resistance dielectric and ZnS and the mixture of a heat-resistant dielectric, Y₂O₂S, and ZnO are used most preferably. Of course, the protective layer which consists only of a dielectric which does not contain sulfur is also usable. As for especially the thermal conductivity of the 1st protective layer, it is more desirable than the 2nd protective layer to make it into height. Although there is a translucent layer which contains Ag near the 1st protective layer, since a translucent layer is not made thickly as a reflecting layer, in order to compensate heat dissipation nature, it is desirable [a layer] to raise the thermal conductivity of the 1st protective layer. For this reason, it is desirable to use an ingredient with the high thermal conductivity of the oxide which does not contain sulfur in the 1st protective layer, a nitride, etc.

[0053] As for a protective layer, it is desirable that it is the high refractive index [as / whose refractive indexes it is substantially transparent to record playback light, and are 2.0-2.4] in order to make optical cross protection into max. In addition, it says that the absolute value of the imaginary part of complex index of

refraction is 0.1 or less substantially as it is transparent. It is 0.05 or less preferably. Besides the limit from the field of the above-mentioned mechanical strength and dependability, the thickness of a recording layer and a protective layer also takes into consideration the cross protection accompanying a multilayer configuration, its absorption efficiency of a laser beam is good, and it is chosen so that the amplitude of a record signal, i.e., the contrast in a record condition and the condition of not recording, may become large. The thickness of a protective layer has desirable 1nm or more, in order to prevent deformation of a recording layer. It is desirable to, make small the difference of the internal stress of the dielectric itself which constitutes a protective layer, or elasticity with the film which has touched on the other hand, and to set thickness to 500nm or less, in order to make a crack hard to generate.

[0054] Generally, a membrane formation rate is small and the ingredient which constitutes a protective layer has long membrane formation time amount. In order to shorten membrane formation time amount, to shorten production time and to reduce cost, it is desirable to hold down protection layer membrane thickness to 200nm or less. Moreover, since the shape of the configuration of the slot formed in the substrate and a quirk on the front face of a recording layer will change a lot if not much thick, 200nm or less is desirable also at this point. It is 150nm or less more preferably. Since it needs to control deformation of the

substrate by heat and a transference enveloping layer, supposing especially the 1st protective layer (protective layer between a translucent layer and a recording layer) does not have a translucent layer, it is usually required 50nm or more. However, since the heat damage which the substrate which touches a translucent layer, and a cover layer receive because there is a translucent layer in this invention is mitigated, there should just be 1nm or more of thickness of the 1st protective layer. And in order to fully employ the heat dissipation nature of a translucent layer efficiently, it is desirable to make it thin with 100nm or less of thickness. Furthermore, in order to acquire high contrast on the wavelength of about 400nm, 40nm or less is desirable. It prevents accumulating heat into a protective layer with low thermal conductivity by this.

[0055] On the other hand, for deformation control of a recording layer, 10nm or more of thickness of the 2nd protective layer (protective layer between a metallic reflective layer and a recording layer) is desirable. Generally, microscopic plastic deformation is accumulated in the interior of the 2nd protective layer by repeat over-writing, as a result playback light is scattered, and a noise is made to increase. In order to control this, it is desirable to set protection layer membrane thickness to 60nm or less. Furthermore, in order to consider as a low-to-high medium using cross protection, it is desirable to thicken the 2nd protective layer with about 30-50nm on the wavelength of about 400nm. And in thickening the

2nd protective layer in this way, it makes a metallic reflective layer high [especially thermal conductivity]. If it is a medium for performing record playback, for example with with a 350nm or more wavelength [450nm or less] light putting the above together, it is desirable that the thickness of 30nm or more 50nm or less and a metallic reflective layer sets [the thickness of a translucent layer / the thickness of the 5nm or more 30nm or less and the 1st protective layer / the thickness of 1nm or more 40nm or less and a recording layer / the thickness of the 5nm or more 20nm or less and the 2nd protective layer] to 40nm or more 100nm or less. In addition, on record playback wavelength, the 1st protective layer and the 2nd protective layer are substantially transparent, and are premised on or more 2.0 being 2.4 or less by the refractive index.

[0056] [8] In diffusion prevention layer this invention, when the 1st protective layer contains the dielectric containing sulfur, it is characterized by preparing a diffusion prevention layer between a translucent layer and the 1st protective layer. Moreover, to contain the dielectric with which a metallic reflective layer uses Ag as a principal component, and the 2nd protective layer contains sulfur, it is necessary to prepare a diffusion prevention layer between a reflecting layer and the 2nd protective layer. If the translucent layer which uses a sulfur-containing protective layer and Ag as a principal component has touched directly, in order to spread the sulfur contained in a protective layer in a

translucent layer, to react with Ag and to spoil the function of a translucent layer, it is necessary to prepare a diffusion prevention layer among both layers, and to prevent this. As it is in the below-mentioned example, in the lamination which prepared Ag translucent layer, the 1st protective layer containing sulfur, a recording layer, the 2nd protective layer containing sulfur, and Ag reflecting layer in order, the property after repeat record etc. is not good.

[0057] The ingredient of a diffusion prevention layer is required to be hard to be spread to Ag which forms a translucent layer, i.e., to form neither Ag, a compound nor the solid solution. And it is required that reactivity with the sulfur contained in a protective layer should be low, or the sulfide should also be chemically stable. The ingredient which fulfills the conditions of being hard to diffuse a sulfur atom with adhesion sufficient [a diffusion prevention layer] with the protective layer in which adhesion with the translucent layer or reflecting layer which is hard to diffuse in a translucent layer or a reflecting layer contains good sulfur is used. For example, from a metal or an alloy, various compounds, or such mixture, the ingredient suitable for the above-mentioned conditions can be chosen suitably, and can be used.

[0058] As a metal or an alloy, silicon, nickel, a tantalum, cobalt, chromium, a tungsten, and vanadium are used preferably. A tantalum and nickel do not produce problems, such as exfoliation by the internal stress of a thin film,

especially, but since stability is good, desirable especially a desirable thing is a tantalum. On the other hand, it is chosen out of a metallic oxide, a metal nitride, metallic carbide, semi-conductor oxide, a semi-conductor nitride, semi-conductor carbide, amorphous carbon, etc. as a compound. It is desirable that the melting point is a heat-resistant compound 1000 degrees C or more with a stable compound. Specifically, silicon oxide, silicon nitride, silicon carbide, tantalum oxide, cerium oxide, a lanthanum trioxide, yttrium oxide, an aluminum oxide, a silver oxide, etc. are mentioned. Highly transparent amorphous hydrogenation carbon is mentioned as amorphous carbon. Desirable especially a desirable thing is silicon oxide at the point that a role of a dielectric protective layer can also be played at the same time silicon oxide and tantalum oxide form a diffusion prevention layer especially.

[0059] In addition, as a diffusion prevention layer, what has a small absorption coefficient in the wavelength of record playback light is desirable. Since it is desirable that permeability is optically high when preparing between a translucent layer and the 1st protective layer especially, it is desirable that it is the transparence dielectric which does not have absorption substantially. When preparing between a reflecting layer and the 2nd protective layer, there may be some light absorption nature and a metal and an alloy can also be used suitably.

In order to harness the optical physical properties and thermal physical

properties of a translucent layer or a reflecting layer, as for a diffusion prevention layer, preparing as thinly as possible is desirable. 10nm or less is specifically desirable, and 5nm or less is more desirable. However, since sufficient diffusion prevention effectiveness may become is hard to be acquired if too thin, for acquiring sufficient preservation stability, 0.5nm or more is desirable, and 1nm or more is more desirable. Since the transparence dielectric is amorphous, film surface surface smoothness etc. is not influenced by crystal grain like a metal and the thin uniform film can be produced, the comparatively thin film of the diffusion prevention layer which consists of a transparence dielectric is also usable.

[0060] in addition, the oxygen etc. and the reflecting layer which the translucent layer reacted with the oxygen in a membrane formation ambient atmosphere etc., or stuck to the protective layer when a translucent layer and the 1st protective layer were continued and prepared, or when the 2nd protective layer and a reflecting layer were continued and prepared -- reacting -- a part -- the layer which consists of a passive state of a metallic oxide may be formed in an interface, and a role like a diffusion prevention layer may be played substantially. However, since the diffusion prevention effectiveness of such a layer is not large, it is desirable to prepare a diffusion prevention layer positively to acquire sufficient preservation stability. An above recording layer, protective layer,

reflecting layer, translucent layer, and diffusion prevention layer is formed by the sputtering method etc. These layers are desirable at the point that performing film formation with the in-line equipment which installed the sputtering target of each class in the same vacuum chamber prevents the oxidation and contamination between each class. Moreover, it excels also from the field of productivity.

[0061] Now, the medium of this invention improves compared with the well-known high-to-low medium which consists of the 1st protective layer, a recording layer, the 2nd protective layer, a diffusion prevention layer, and a reflecting layer also in the minimum value and the record power margin of a jitter when changing record power. Although the reason for an improvement is not necessarily clear, that to which the following possibility influenced ** for each other, and has taken effect is conjectured. That is, it is thought that aggravation of the repeat recording characteristic of a phase change mold optical recording medium is the causes with main a recording layer moving by the repeat of record. Although the 1st protective layer and a recording layer are prepared on a translucent layer, since the front face of the substrate side incidence type medium of this invention of a translucent layer is moderately ruined, it can consider that the recording layer prepared after that is the situation which is hard to move by the repeat of record. Moreover, it is also guessed that it is the

situation that the heat distribution at the time of record makes migration of a recording layer small as compared with the usual high-to-low medium. Furthermore, it is also predicted by considering as the lamination containing the translucent layer to which the main causes of property degradation by repeat record of the usual high-to-low medium are in heat deformation of a substrate etc., and use Ag of this invention as a principal component that the damage to a substrate becomes small.

[0062] [9] Explain other layer structure parts which constitute the medium for optical information record of this invention below other lamination parts. In the medium for optical information record of this invention, a substrate is approached and formed in either a translucent layer or a reflecting layer. As a substrate, resin, such as a polycarbonate, polyacrylate, and polyolefine, or glass can be used. To carry out incidence of the record playback light from a substrate side, a substrate needs to presuppose that it is transparent to record playback light. In these, a polycarbonate also has a track record, it is cheap, and since it excels also in economical efficiency, it is desirable. The thickness of a substrate is usually 0.1-2mm preferably 0.05-5mm. If it is a substrate side incidence type medium, it will come to prepare a protection coat layer in the opposite side with the 2nd protective layer of a metallic reflective layer. A protection coat layer consists of for example, ultraviolet curing mold resin, a dielectric, plastics, etc.

The thickness of a protection coat layer is usually 1 micrometers or more 200 micrometers or less.

[0063] If it is a film surface incidence type medium, it will come to prepare a transparence enveloping layer (cover layer) in the opposite side with the 1st protective layer of a translucent layer. A transparence enveloping layer consists of for example, ultraviolet curing mold resin, a dielectric, plastics, etc. In order to protect a recording layer etc. from a head, 10 micrometers or more of thickness of a transparence enveloping layer are desirable. However, since the distance of an optical head and a recording layer will become long and it will be hard coming to carry out high density record if not much thick, 200 micrometers or less of thickness are desirable. Generally, from the substrate side incidence type medium, the way of a film surface incidence type medium can bring the distance of an optical head and a recording layer close, and is suitable for high density record. In addition, the medium of this invention is not limited to the above lamination, and other layers may be minded or you may make it constitute each class from two or more film between each class if needed. In this invention, a repeat recording characteristic, a record power margin, preservation stability, etc. will not be improvable without taking the above lamination by the low-to-high medium using an eutectic system alloy recording layer. Or crystallization from an amorphous state can obtain the medium which was excellent in a repeat

recording characteristic, a record power margin, preservation stability, etc. in the low-to-high medium using the recording layer which advances as a subject in the crystal growth from the boundary of the amorphous section or a fusion zone, and the crystal section again. And this medium is a medium for optical information record which was [stability / a jitter, a record power margin, a repeat recording characteristic, / preservation] superior to the medium known conventionally.

[0064]

[Example] Yes in what is restricted to these examples unless this invention exceeds the summary hereafter, although an example explains this invention to a detail further. Consisting of almost pure Ag, when calling it Ag translucent layer and Ag reflecting layer to below, the volume resistivities in the thin film condition are about 30 ohm-nm. When calling it Ag alloy translucent layer and Ag alloy reflecting layer, it is Ag₉₈Cu₁Au₁ alloy (atomic %), and the volume resistivities of the thin film condition are about 35 ohm-nm. Sheet resistivity will be obtained if a volume resistivity is ^{**}(ed) by thickness. Resistivity is JIS. It measured by the 4 ^{****} method according to K7194. Moreover, the slot for record playback light guidance is formed in the substrate. In addition, below, it sees from a record playback light incidence side, and a near field is called a slot (groove) and a distant field is called a land (between slots). The refractive index of ZnS-SiO₂ is about 2.3 in about 2.1 wavelength of about 400nm on the wavelength of

630-660nm. Except this, the numeric value shown in the example of reference mentioned later was used for optical count.

[0065] [Example 1; substrate incidence type]

(Production of an optical disk) On the transparency substrate which consists of a polycarbonate with a thickness of 0.6mm Ag translucent layer (18nm), a SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), the ZnS-SiO₂ 1st protective layer (90nm), germanium₅In₃Sb₆₈Te₂₄ recording layer (15nm), the ZnS-SiO₂ 2nd protective layer (30nm), The SiO₂ diffusion prevention layer (5nm) and Ag reflecting layer (120nm) were formed in this order by the sputtering method, and the protection coat layer which consists of ultraviolet-rays hardening resin further was formed on this. Then, the protection coat layer was carried out inside, two substrates with which these layers were formed were stuck, and the optical disk was produced. In addition, the flute width [of 0.56 micrometers], channel depth [of 67nm], and slot pitch 1.2micrometer slot was spirally formed in the substrate. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized.

[0066] (Evaluation of a reflection factor) When incidence of the record playback light (wavelength of 635nm) was carried out to this optical disk from the substrate side and the reflection factor was measured, the reflection factor Ra of an amorphous condition (record condition) was larger than the reflection factor

Rc of a crystallized state (condition of not recording). That is, it is a low-to-high medium. The crystallized state reflection factor Rc was about 11% in Mizouchi. The amorphous section reflection factor Ra in 14T mark when recording by $P_w=11\text{mW}$ was about 26%. R_a-R_c = it was about 15%.

[0067] (Record playback conditions) The recording characteristic was measured using the wavelength of 635nm, and the optical disk evaluation equipment which has the optical system of NA0.6. Incidence of the record playback light was carried out from the substrate side. The division pulse recording method as shown in drawing 6 was used for record. record conditions -- the ratio of linear-velocity 4 m/s, the elimination power P_e , and the record power P_w -- it considered as $P_e/P_w=0.5$, bias power $P_b=0.8\text{mW}$, and $T=38.2\text{ns}$ of reference clock periods, and the 8-16 modulation random signal (the so-called EFM+ modulating signal) used by DVD specification was recorded. In this example, it considered as number-of-partitions $m=n-1$, and die-length $\alpha_i T$ ($2 \leq i \leq m$) of the record pulse section (P_w exposure section) of the 2nd henceforth was not depended on i , but it was presupposed that it is fixed. Moreover, die-length $\beta_i T$ ($2 \leq i \leq m-1$) of the 2nd to the $m-1$ st off pulse sections (P_b exposure section) was not depended on i , but it was presupposed that it is fixed. Playback was performed by linear-velocity 4 m/s and playback power $P_r=0.8\text{mW}$.

[0068] (Record power dependency evaluation of a jitter) First, 10 times (Direct

Over Write, DOW), it reproduced after that, and 3T tooth-space jitter (3T mark Mabe jitter) was measured. In addition, mark Mabe (tooth space) corresponds to the non-Records Department and the elimination section, and the mark section corresponds to the Records Department. 3T tooth space is the jitter of mark Mabe of die-length 3T when reproducing 8 -16 modulating signal which pointed out mark Mabe of die-length 3T, and was recorded as 3T tooth-space jitter. It changed 1mW of record power P_w at a time, this measurement was performed, and the record power dependency of 3T tooth-space jitter was evaluated. A result is shown in drawing 7 (a).

[0069] (Repetition recording rate (DOW cycle) dependency evaluation of a jitter)

Next, whenever it performed count over-writing of predetermined, the jitter was measured, and conditions ($P_w=11\text{mW}$ and $P_e=5.5\text{mW}$) estimated the repetition recording rate (DOW cycle) dependency of 3T tooth-space jitter. A result is shown in drawing 7 (b). Drawing 7 (a) shows 3T tooth-space jitter (axis-of-ordinate;%) to record power (axis of abscissa; mW), and drawing 7 (b) shows 3T tooth-space jitter (axis of ordinate) to repeat record (axis of abscissa).

The jitter used the value standardized $T=38.2\text{ns}$ of reference clock periods. In addition, it evaluated about both slot record and land record. The optical disk of an example 1 has the low minimum value of a jitter, its record power margin of a jitter is large, and its property degradation after repeat record is small, and it is

an outstanding optical disk.

[0070] (Environmental test-proof) Next, the environmental test-proof which maintains this optical disk at 80 degrees C and the environment of 85%RH for 100 hours was performed. Abnormalities, such as film peeling by this, were not seen. Before and after the environmental test-proof, the recording characteristic was measured using the above-mentioned optical disk evaluation equipment. It reproduced and the jitter was measured, after the over-write [being referred to as $P_w=11\text{mW}$ and $P_e=5.5\text{mW}$ and / a 8-16 modulation random signal / Mizouchi] under the same record playback conditions as the above-mentioned 10 times. 3T tooth-space jitters were 9.8% and 9.6% before and behind the environmental test-proof, respectively, and degradation by the environmental test-proof was small. In addition, 3T tooth-space jitter is a reference clock period. It standardized in 38.2ns. From the above evaluation, the optical disk of an example 1 is excellent in repeat recording characteristics, record power margins, and all the preservation stability.

[0071] [-- example of comparison 1; substrate incidence type; -- translucent-layer-less]

(Production of an optical disk) On the transparence substrate which consists of a polycarbonate with a thickness of 0.6mm, the ZnS-SiO₂ 1st protective layer (75nm), germanium₅In₃Sb₆₈Te₂₄ recording layer (15nm), the ZnS-SiO₂ 2nd

protective layer (20nm), the SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), and Ag reflecting layer (120nm) were formed in this order by the sputtering method, and the protection coat layer which consists of ultraviolet-rays hardening resin further on this was formed. Then, the protection coat layer was carried out inside, two substrates with which these layers were formed were stuck, and the optical disk was produced. In addition, the shape of a quirk of a substrate was the same as an example 1. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized.

[0072] (Evaluation of a reflection factor) Ra of this optical disk was smaller than Rc. That is, it is a high-to-low medium. Rc was about 14% in Mizouchi. Ra in 14T mark when recording by Pw=11mW was about 3%.

(Jitter evaluation) The evaluation same to this optical disk as an example 1 was performed. A result is shown in drawing 8 . The optical disk of the example 1 of a comparison was inferior to the optical disk of an example 1 in respect of [all] the property after the minimum value of a jitter, the record power margin of a jitter, and repeat record.

(Environmental test-proof) When the same evaluation as an example 1 was performed, 3T tooth-space jitters standardized the reference clock period in environmental-test-proof order were 11.2% and 11.5%, respectively, and degradation by the environmental test-proof was small.

[0073] [-- example of comparison 2; substrate incidence type; -- diffusion-prevention-layer-less] -- the optical disk was produced like the example 1 except there being no diffusion prevention layer between Ag translucent layer (18nm) and the 1st protective layer. The shape of a quirk of a substrate is the same as an example 1. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized the first stage. Ra of the reflection factor of this optical disk is larger than Rc about 15%. That is, it is a low-to-high medium. The evaluation same to this optical disk as an example 1 was performed. A result is shown in drawing 9 . The optical disk of the example 1 of a comparison was inferior to the optical disk of an example 1 in respect of the minimum value of a jitter, and the property after repeat record. Property degradation especially by repeat record was remarkable. Next, when the environmental test-proof which maintains this optical disk at 80 degrees C and the environment of 85%RH for 100 hours was performed, discoloration of a reflecting layer was observed. It is thought that Ag reflecting layer deteriorated by diffusion of the sulfur from the 1st protective layer.

[0074] [-- example 2; substrate incidence type; -- multiple-value record]

(Production of an optical disk) On the transparence substrate which consists of a polycarbonate with a thickness of 0.6mm Ag translucent layer (15nm), a SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), the ZnS-SiO₂ 1st protective layer (25nm),

germanium₅In₃Sb₆₈Te₂₄ recording layer (14nm), the ZnS-SiO₂ 2nd protective layer (30nm), The SiO₂ diffusion prevention layer (5nm) and Ag reflecting layer (100nm) were formed in this order by the sputtering method, and the protection coat layer which consists of ultraviolet-rays hardening resin further was formed on this. Then, the protection coat layer was carried out inside, two substrates with which these layers were formed were stuck, and the optical disk was produced. In addition, the flute width [of 0.4 micrometers], channel depth [of 45nm], and slot pitch 0.8micrometer slot was spirally formed in the substrate. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized.

(Evaluation of a reflection factor) When incidence of the record playback light (wavelength of 402nm) was carried out to this optical disk from the substrate side, Ra was larger than Rc. That is, it is a low-to-high medium. When asked for the reflection factor by optical count, the calculated value of Ra of the calculated value of Rc was 37% 14% (wavelength is assumed to be 405nm).

[0075] (Evaluation of the recording characteristic in multiple-value record) About the optical disk of this example, multiple-value record was performed by the following principles using the wavelength of 402nm, and the optical disk evaluation equipment which has the optical system of NA0.65, and the recording characteristic was measured. Incidence of the record playback light was carried

out from the substrate side. The sum of the record power P_w , the bias power P_b , P_w exposure section t_w , and P_b exposure sections t_b , t_w , and t_b is set to τ , and record linear velocity is set to v . a ratio [as opposed to / set τ constant and / τ of t_w] -- by changing t_w/τ , the area of the amorphous mark formed within the fixed section (section equivalent to product $v\tau$ of τ and v) can be changed. The reflection factor within the section is decided according to the ratio of the area of the amorphous mark within the section, and the area of the crystallized state of the background. Therefore, a reflection factor can be gradually changed by changing t_w/τ gradually. By setting the threshold of a reflection factor as a multistage story The information on three or more values is recordable on the one section (). [K.] Kiyono M.Horie and T. Ohno, T.Uematsu, and T. Hashizume and M.P.O'Neill, K.Balasubramanian, R.Narayan, D.Warland, and T.Zhou, Japanese Journal of Applied Physics, 40 (2001), 1855 pages. In addition, since recrystallization in case a recording layer re-solidifies is remarkable, in the case of $t_b=0$, an eutectic system alloy recording layer is crystallized nearly completely. And the cooling effect becomes large as t_b is made to increase, recrystallization is controlled and the size of an amorphous mark becomes large. If t_b/τ is made to increase in monotone, amorphous mark size will become large until t_b/τ reaches to about 70 - 80 [0 to]%, and a reflection factor will increase in monotone in the meantime. In addition, the

concept of elimination power does not exist in multiple-value record.

[0076] Record conditions were set to linear-velocity 5 m/s, record power $P_w=5.5\text{mW}$, and bias power $P_b=0.5\text{mW}$, were set to $v \tau = 0.25$ micrometers for $\tau = 50\text{ns}$, changed t_w/τ , recorded, as shown in drawing 10, they changed the reflection factor to eight steps, and they performed octal record. In drawing 10, an axis of ordinate is the electrical-potential-difference value of a regenerative signal, and corresponds to a reflection factor. The level 8 which is a low reflection factor most is in the condition crystallized completely, and it was mostly in agreement with the reflection factor R_c for which it asked by optical count. The level 1 which is a high reflection factor most became a little lower than the reflection factor R_a for which it asked by optical count. By the comparison with an actual measurement, 10% or more of reflection factor difference was acquired by R_c and R_a . Repeatedly and change of each reflection factor level was observed. [optical disk / this] As shown in drawing 10, as for the reflection factor, after 10,000 repetition records hardly changed. Next, on this disk, after irradiating a record power $P_w=5.5\text{mW}$ laser beam in direct current by linear-velocity 5 m/s, the reflection factor of the exposure section was measured. When the reflection factor of the crystal section after initializing a disk and performing over-writing about 10 times was made into 100%, the reflection factor of the exposure section was 100%.

[0077] (Evaluation of the recording characteristic in binary record) Next, the usual binary record was performed about this optical disk, and the recording characteristic was evaluated. The division pulse recording method as shown in drawing 6 was used for record. Record conditions were made into linear-velocity 7 m/s, record power $P_w=5.1\text{mW}$, elimination power $P_e=2.2\text{mW}$, bias power $P_b=0.5\text{mW}$, and about 0.23 micrometers (the shortest mark length) of 2T mark length, and mark length modulation record by the RLL (1 7) method was performed. In this example, it considered as number-of-partitions $m=n-1$, and die-length $\alpha_i T$ ($2 \leq i \leq m$) of the record pulse section (P_w exposure section) of the 2nd henceforth was not depended on i , but it was presupposed that it is fixed. Moreover, die-length $\beta_i T$ ($2 \leq i \leq m-1$) of the 2nd to the $m-1$ st off pulse sections (P_b exposure section) was not depended on i , but it was presupposed that it is fixed. Playback was performed by linear-velocity 3.1 m/s and playback power $P_r=0.5\text{mW}$.

[0078] Data after measuring a jitter the above condition whenever it performs count over-writing of predetermined, and making it binary through an equalizer to The recording rate (DOW cycle) dependency was repeatedly evaluated about the clock jitter. Consequently, the jitter did not increase to about 10,000 repetition records, but it was 9% or less. In addition, Data to A clock jitter is the value which evaluated fluctuation between the marks of all the die length

contained in data on the basis of the reference clock period. Next, on this disk, after irradiating a record power $P_w=5.1\text{mW}$ laser beam in direct current by linear-velocity 7 m/s, the reflection factor of the exposure section was measured. When the reflection factor of the crystal section after initializing a disk and performing over-writing about 10 times was made into 100%, the reflection factor of the exposure section was 110 - 115%.

[0079] [-- example of comparison 3; substrate incidence type; -- multiple-value record; -- translucent-layer-less]

(Production of an optical disk) On the transparence substrate which consists of a polycarbonate with a thickness of 0.6mm, the ZnS-SiO₂ 1st protective layer (40nm), germanium₅In₃Sb₆₈Te₂₄ recording layer (13nm), the ZnS-SiO₂ 2nd protective layer (8nm), the SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), and Ag reflecting layer (100nm) were formed in this order by the sputtering method, and the protection coat layer which consists of ultraviolet-rays hardening resin further on this was formed. Then, the protection coat layer was carried out inside, two substrates with which these layers were formed were stuck, and the optical disk was produced. In addition, the flute width [of 0.4 micrometers], channel depth [of 50nm], and slot pitch 0.8micrometer slot was spirally formed in the substrate. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized.

[0080] (Evaluation of a reflection factor) When incidence of the record playback light (wavelength of 402nm) was carried out to this optical disk from the substrate side, R_a was smaller than R_c . That is, it is a high-to-low medium. When asked for the reflection factor by optical count, the calculated value of R_a of the calculated value of R_c was 6% 31% (wavelength is assumed to be 405nm). (Evaluation of the recording characteristic in multiple-value record) Multiple-value record was performed to this optical disk on an example 2 and these conditions, and the recording characteristic was evaluated. As shown in drawing 11 , the reflection factor was changed to eight steps, and octal record was performed. In this example, although the minimum reflection factor and the highest reflection factor are almost equivalent to an example 2, the level 1 which is a high reflection factor most is in the condition crystallized completely. Repeatedly and change of each reflection factor level was observed. [optical disk / this] As shown in drawing 11 , after 100 repetition records, the reflection factor of level 1 fell greatly and became octal multiple-value record with unsuitable conditions.

[0081] (Evaluation of the recording characteristic in binary record) Next, the binary record usual on these conditions was mostly performed to this optical disk with the example 2, and the recording characteristic was evaluated. The above condition, whenever it performs count over-writing of predetermined, a jitter is

measured, and it is Data. to The repetition recording rate (DOW cycle) dependency of a clock jitter was evaluated. Consequently, although a jitter hardly increased to about 2000 repetition records but 9% or less was maintained, it got worse rapidly after that. Namely, since a jitter was conspicuous and did not immediately get worse even if the reflection factor fell somewhat in the usual binary record, 1000 repeat over-writing or more was possible also for this optical disk. However, in multiple-value record, degradation by reflection factor fall was hardly allowed, but has used it only about 100 times. Therefore, the medium of this invention is effective in especially a multiple-value recording method.

[0082] [-- example 3; film surface incidence type; -- on the transparence substrate which consists of a polycarbonate with an AlN protective layer] thickness of 1.1mm An Ag98Cu1Au1 alloy reflecting layer (80nm), a SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), The ZnS-SiO₂ 2nd protective layer (30nm), germanium3In5Sb67Te25 recording layer (12nm), the 1st protective layer (30nm) of AlN, and an Ag98Cu1Au1 translucent layer (15nm) were formed in this order by the sputtering method. Thermal conductivity of AlN is higher than ZnS-SiO₂. Besides, the transparence enveloping layer (cover layer) with a thickness of about 100 micrometers it is thin from ultraviolet-rays hardening resin was formed further, and the optical disk was produced. In addition, the flute width [of 0.32 micrometers], channel depth [of 40nm], and slot pitch

0.66micrometer slot is spirally formed in the substrate. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized the first stage. When incidence of the record playback light (wavelength of 402nm) was carried out to this optical disk from the substrate side, R_a was larger than R_c . That is, it is a low-to-high medium. When asked for the reflection factor by optical count, the calculated value of R_a of the calculated value of R_c was 35% 12% (wavelength is assumed to be 405nm).

[0083] About this optical disk, the recording characteristic was measured using the wavelength of 402nm, and the optical disk evaluation equipment which has the optical system of NA0.85. Incidence of the record playback light was carried out from the film surface side. The same division pulse recording method as an example 1 was used for record. Record conditions were set to linear-velocity 5.7 m/s, record power $P_w=3.7\text{mW}$, elimination power $P_e=1.7\text{mW}$, bias power $P_b=0.3\text{mW}$, 0.173 micrometers (the shortest mark length) of 2T mark length, and reference clock frequency $(1/T) = 66\text{MHz}$, and mark length modulation record by the RLL (1 7) method was performed. Playback was performed by linear-velocity 5.7 m/s and playback power $P_r=0.3\text{mW}$. Data after measuring a jitter the above condition whenever it performs count over-writing of predetermined, and making it binary through an equalizer to The repetition recording rate (DOW cycle) dependency of a clock jitter was evaluated.

Consequently, the increment in a jitter is less than 1% to about 50,000 repetition records, and it did not exceed 10%.

[0084] On the transparence substrate which consists of a polycarbonate with a [example 4; film surface incidence type] thickness of 1.1mm An Ag₉₈Cu₁Au₁ alloy reflecting layer (80nm), a SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), The ZnS-SiO₂ 2nd protective layer (30nm), germanium₃In₅Sb₆₇Te₂₅ recording layer (12nm), the ZnS-SiO₂ 1st protective layer (25nm), the SiO₂ diffusion prevention layer (5nm), and the Ag₉₈Cu₁Au₁ translucent layer (15nm) were formed in this order by the sputtering method. Besides, the transparence enveloping layer (cover layer) with a thickness of about 100 micrometers it is thin from ultraviolet-rays hardening resin was formed further, and the optical disk was produced. In addition, the flute width [of 0.32 micrometers], channel depth [of 40nm], and slot pitch 0.66micrometer slot is spirally formed in the substrate. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized the first stage. When incidence of the record playback light (wavelength of 402nm) was carried out to this optical disk from the substrate side, Ra was larger than Rc. That is, it is a low-to-high medium. When asked for the reflection factor by optical count, the calculated value of Ra of the calculated value of Rc was 36% 12% (wavelength is assumed to be 405nm).

[0085] About this optical disk, the recording characteristic was measured using

the wavelength of 402nm, and the optical disk evaluation equipment which has the optical system of NA0.85. Incidence of the record playback light was carried out from the film surface side. The same division pulse recording method as an example 1 was used for record. Record conditions were set to linear-velocity 5.7 m/s, 0.173 micrometers (the shortest mark length) of 2T mark length, and reference clock frequency ($1/T$) =66MHz, and mark length modulation record by the RLL (1 7) method was performed. Playback was performed by linear-velocity 5.7 m/s and playback power $P_r=0.3\text{mW}$. First, 10 times, and it reproduces after that, and is Data. to The clock jitter was measured. When measured by changing the record power P_w etc., in $P_w=3.5\text{mW}$, $P_e=1.7\text{mW}$, and $P_b=0.3\text{mW}$, the jitter became min at about 8%. Next, when P_b and P_e were set constant and P_w was changed, in the range of $P_w=3.4\text{mW}^{**}0.4\text{mW}$, the jitter was about 9% or less.

[0086] Furthermore, it is Data when record playback was performed on conditions (record power $P_w=3.4\text{mW}$, elimination power $P_e=1.7\text{mW}$, and bias power $P_b=0.3\text{mW}$). to The clock jitter was as good as 9% or less. When an over-write [the same conditions] repeatedly, the increment in a jitter was less than 1% to about 50,000 repetition records. Next, on this disk, after irradiating a record power $P_w=3.4\text{mW}$ laser beam in direct current by linear-velocity 5.7 m/s, the reflection factor of the exposure section was measured. When the reflection factor of the crystal section after initializing a disk and performing over-writing

about 10 times was made into 100%, the reflection factor of the exposure section was 114%.

[0087] [-- example of comparison 4; film surface incidence type medium; -- with no translucent layer -- an Ag₉₈Cu₁Au₁ alloy reflecting layer (80nm), a SiO₂ diffusion prevention layer (3nm), the ZnS-SiO₂ 2nd protective layer (3nm), germanium₃In₅Sb₆₇Te₂₅ recording layer (12nm), and the ZnS-SiO₂ 1st protective layer (35nm) were formed by the sputtering method at this order on the transparence substrate which consists of a polycarbonate with a] thickness of 1.1mm. Besides, the transparence enveloping layer (cover layer) with a thickness of about 100 micrometers it is thin from ultraviolet-rays hardening resin was formed further, and the optical disk was produced. In addition, the flute width [of 0.32 micrometers], channel depth [of 40nm], and slot pitch 0.66micrometer slot is spirally formed in the substrate. Initialization actuation was performed to this optical disk, and the recording layer was crystallized the first stage. When incidence of the record playback light (wavelength of 402nm) was carried out to this optical disk from the substrate side, Ra was smaller than Rc. That is, it is a high-to-low medium. When asked for the reflection factor by optical count, the calculated value of Ra of the calculated value of Rc was 7% 32% (wavelength is assumed to be 405nm).

[0088] An example 4 and these conditions estimated this optical disk. Playback

was performed by linear-velocity 5.7 m/s and playback power $P_r=0.3\text{mW}$. First, 10 times, and it reproduces after that, and is Data. to The clock jitter was measured. When measured by changing the record power P_w etc., in $P_w=3.8\text{mW}$, $P_e=1.7\text{mW}$, and $P_b=0.3\text{mW}$, the jitter became min at about 9%. Next, when P_b and P_e were set constant and P_w was changed, in the range of $P_w=3.8\text{mW}^{**}0.4\text{mW}$, the jitter was about 10% or less. Furthermore, it is Data when record playback was performed on conditions (record power $P_w=3.4\text{mW}$, elimination power $P_e=1.7\text{mW}$, and bias power $P_b=0.3\text{mW}$). to The clock jitter was as good as 9% or less. However, when an over-write [the same conditions] repeatedly, the jitter increased notably by about 2000 repetition records.

[0089] [Related Example(s)] -- the example of count is shown below about optical / thermal property of the medium of this invention, and the conventional medium. In this invention, although $R_a-R_c \geq 15\%$ is made desirable by high contrast, this is based on an actual measurement. This corresponds to $R_a-R_c \geq 20\%$ in general with calculated value. the time of below changing the thickness of a specific layer in specific lamination -- calculated value -- $R_a-R_c \geq 20\%$ -- it evaluates on the basis of whether an optical property is obtained (high -- do contrast or not?). Calculus is the general technique in consideration of optical multiplex cross protection as shown in the "optical thin film" (H. A.Macleod work, 1989.11.Nikkan Kogyo Shimbun 30 issue).

Wavelength of record playback light was set to 405nm. Any medium is a low-to-high medium.

[0090] A recording layer and each complex index of refraction (actual measurement) are as follows.

Complex index of refraction of recording layer A: $\text{In}_3\text{germanium}_5\text{Sb}_6\text{Te}_{23}$
crystallized state Complex index of refraction of a 1.35-3.34i amorphous state
Complex index of refraction of 2.46-2.90i recording layer B: $\text{germanium}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$
crystallized state Complex index of refraction of a 2.2-3.3i amorphous state The
3.1-2.1i 1st and 2nd protective layers shall consist of a dielectric, and absorption
shall not have a refractive index 2.32. As a protective layer which shows such a
refractive index, there is a protective layer which uses ZnS, tantalum oxide,
niobium oxide, an acid sulfuration yttrium, titanium oxide, etc. as a principal
component. The refractive index of SiO_2 used for a diffusion prevention layer is
1.6 (actual measurement).

[0091] The reference value of the complex index of refraction (n-ik) for every
wavelength of Ag, Au, Cu, and aluminum is shown in Table -1 (Handbook of
Optical Constants of Solids, Edited by Edward D. Palik, Academic Press, Inc.,
1985, Orlando, Florida, USA). There is an about $\pm 10\text{nm}$ error in the shown
wavelength.

[0092]

[Table 1]

表— 1

波長	400nm		650nm	
	n	k	n	k
Ag	0.173	1.95	0.14	4.15
Au	1.66	1.96	0.166	3.15
Cu	1.18	2.21	0.21	3.67
Al	0.49	4.86	1.47	7.79

Moreover, various alloys and each complex index of refraction (actual measurement) are as follows.

Ag alloy 0.089-2.03iAu alloy 1.66-1.96iCu alloy 1.18-2.21iAl alloy 0.39-3.62i

[0093] A reflecting layer is taken as a thing thick to extent which can disregard the transmitted light. If it is the range of 100-200nm of thickness, it is optically practically equal. There shall be a transparence substrate of a refractive index 1.56 in the incidence side of record playback light. The thickness of a substrate shall be larger than the coherent length of an incidence laser beam enough, and there shall be no multiplex interference within a substrate. Therefore, incidence of the count top shall be carried out to multilayers from the medium of a refractive index 1.56.

(1) The 1st protective layer / recording layer / the 2nd protective layer / Ag alloy reflecting layer (it is incidence about the 1st protective layer side to light)

This lamination that does not have a translucent layer is widely used with erasable CD (CD-RW) etc. Hereafter, suppose that it is only called 4 lamination. First, the recording layer A was used as a recording layer. Optical count of R_a - R_c in the case of changing the thickness of a recording layer and changing the thickness of the 1st and 2nd protective layers about each further was carried out. This result is used as a contour map and it is shown in drawing 12 . In drawing, (a), (b), (c), and (d) are the thickness 5 and 10 of a recording layer, and the case of 15 or 20nm, respectively. The slash has shown the field which becomes $R_a - R_c \geq 20\%$ in each drawing, i.e., a high contrast field. It is the same as that of the following.

[0094] Next, the recording layer B was used as a recording layer. Optical count of R_a - R_c at the time of changing the thickness of a recording layer and changing the thickness of the 1st and 2nd protective layers about each further was carried out. This result is used as a contour map and it is shown in drawing 13 . As shown in drawing 12 , in a recording layer A, a high contrast field is very narrow, and there is almost no margin of thickness and it is difficult to realize in practice. On the other hand, as shown in drawing 13 , in a recording layer B, a high contrast field exists in the about 40nm of the 1st protection layer membrane thickness partly. Next, when a recording layer A is used for drawing 14 , it considers as 12nm of record layer membrane thickness and the (a) reflecting

layer is used as Ag alloy, the result at the time of using the (b) reflecting layer as aluminum alloy is shown. As for all, a contour map does not almost have a difference, and most high contrast is not acquired. That is, it is almost impossible to acquire high contrast with this configuration by the recording layer A to there being a field which can acquire high contrast also by the low-to-high medium by 4 conventional lamination without a translucent layer by the recording layer B.

[0095] (2) translucent -- a layer / the 1st protective layer / recording layer A / the 2nd protective layer / Ag alloy reflecting layer (it is incidence about a translucent layer side to light)

First, the translucent layer was used as Ag alloy with a thickness of 15nm (voice of this invention like fairly). Thickness of a recording layer was set to 12nm, and optical count of Ra-Rc in the case of changing the thickness of the 1st and 2nd protective layers was carried out. This result is used as a contour map and it is shown in drawing 15 . Next, the result of having carried out optical count of the translucent layer similarly as an aluminum alloy with a thickness of 5nm is shown in drawing 16 . All can attain high contrast by the about 40nm of the 2nd protection layer membrane thickness. That is, in order to obtain an optical property equivalent to Ag alloy translucent layer in aluminum alloy translucent layer, it is necessary to make thickness quite thin. However, with aluminum alloy of 5nm of thickness, it is thought that there is almost no heat dissipation

effectiveness. Furthermore, Au alloy was used as a translucent layer. Optical count of Ra-Rc in the case of changing the thickness of a translucent layer and changing the thickness of the 1st and 2nd protective layers about each further was carried out. This result is used as a contour map and it is shown in drawing 17 . In drawing, (a), (b), (c), and (d) are the thickness 5 and 10 of a translucent layer, and the case of 15 or 20nm, respectively. The count result at the time of using Cu alloy as a translucent layer similarly is shown in drawing 18 . That is, it is difficult to acquire high contrast in Au alloy translucent layer and Cu alloy translucent layer.

[0096] (3) Ag alloy -- translucent -- a layer / the 1st protective layer / recording layer A / the 2nd protective layer / Ag alloy reflecting layer (a translucent layer side to light -- the voice of incidence and this invention -- considerable [like])

Optical count of Ra-Rc in the case of changing the thickness of a translucent layer and changing the thickness of the 1st and 2nd protective layers about each further and the Rc was carried out. This result is used as a contour map and it is shown in drawing 19 - drawing 25 . Respectively, they are the thickness 5, 10, 15, 20, and 30 of a translucent layer, and the case of 40 or 50nm. In drawing, (a) and (b) are Ra-Rc and Rc, respectively. As for a high contrast field, as for all, the 2nd protection layer membrane thickness exists in the range which is 30-50nm in general. The field used as $Ra-Rc \geq 20\%$ exists in the range of the 0-40nm of

the 1st protection layer membrane thickness. Moreover, the field used as $5 \leq R_c \leq 15(\%)$ exists in the range of the 25-45nm of the 1st protection layer membrane thickness widely in general. If translucent layer membrane thickness is 30nm or less, the field which fills both exists. Furthermore, if a translucent layer becomes thick exceeding 40nm, a high contrast field will become small rapidly. There is also almost no field used as $R_c \leq 15(\%)$.

[0097] (4) The 1st protective layer / recording layer A / the 2nd protective layer / Ag alloy reflecting layer containing Ag alloy translucent layer/(SiO₂ diffusion prevention layer) / sulfur (it is incidence about a translucent layer side to light)

Optical count of R_a - R_c in the case of changing the thickness of the 1st and 2nd protective layers about each was carried out as 15nm of translucent layer membrane thickness, 0nm of diffusion prevention layer membrane thickness, 5nm, and 12nm of record layer membrane thickness. This result is used as a contour map and it is shown in drawing 26 . Drawing 26 (a) is the case where there is 0nm of no diffusion prevention layer membrane thickness, i.e., a diffusion prevention layer, and drawing 26 (b) is the case of 5nm of diffusion prevention layer membrane thickness (voice of this invention like fairly). Most change of the optical property by the addition of a diffusion prevention layer is not seen.

[0098]

[Effect of the Invention] By considering as the lamination of this invention in the medium for phase change mold optical information record, a jitter, a record power margin, property degradation by repeat record, preservation stability, etc. are improvable as compared with the medium of the record which consists of the conventional lamination.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is an example of the lamination of the medium for optical information record of this invention.

[Drawing 2] They are other examples of the lamination of the medium for optical information record of this invention.

[Drawing 3] They are other examples of the lamination of the medium for optical information record of this invention.

[Drawing 4] They are other examples of the lamination of the medium for optical information record of this invention.

[Drawing 5] It is drawing showing change of the impression condition of record power, and the regenerative signal by it.

[Drawing 6] It is the explanatory view of an example of a division pulse recording method.

[Drawing 7] 3T tooth-space jitter in the optical disk of an example 1, record power (a), and the graph that shows relation with repeat record (b).

[Drawing 8] 3T tooth-space jitter in the optical disk of the example 1 of a comparison, record power (a), and the graph that shows relation with repeat record (b).

[Drawing 9] 3T tooth-space jitter in the optical disk of the example 2 of a comparison, record power (a), and the graph that shows relation with repeat record (b).

[Drawing 10] The graph which shows the repeat recording rate dependency of the reflection factor of the optical disk of an example 2

[Drawing 11] The graph which shows the repeat recording rate dependency of the reflection factor of the optical disk of the example 3 of a comparison

[Drawing 12] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference
(1)

[Drawing 13] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference
(1)

[Drawing 14] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference
(1)

[Drawing 15] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(2)

[Drawing 16] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(2)

[Drawing 17] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(2)

[Drawing 18] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(2)

[Drawing 19] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 20] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 21] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 22] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 23] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 24] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 25] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(3), and Rc

[Drawing 26] The example of optical count of Ra-Rc of the example of reference

(4)

[Brief Description of Notations]

1 Translucent Layer

2 1st Protective Layer

3 Phase Change Mold Recording Layer

4 2nd Protective Layer

5 Metallic Reflective Layer

6 Eight Substrate

7 Cover Layer (Transparence Enveloping Layer)

9 Protection Coat Layer

11 12 Diffusion prevention layer